

ORIGAMI PROJECT

OrigamiSat-1 報告書

ver 1.0 : 2019 年 10 月 13 日

目 次

第1章 背景および衛星の概要	1
第2章 ミッション定義	2
2.1 開発の目的・ミッションステートメント/サクセスクライテリア/ミッション シークエンス	2
2.2 システム要求(ミッション系(坂本)/バス系/インターフェース/安全(中西))	2
2.3 システム設計	2
第3章 サブシステム開発の経緯(設計・試験)	3
3.1 電源系(概要/EPS/インヒビット設計(二重絶縁)/電源系統図/電池/SAP)(池 谷・中塚)	3
3.1.1 概要	3
3.1.2 SAP	5
3.1.3 バッテリ	5
3.1.4 インヒビット回路	5
3.1.5 放出検知スイッチ・ライトピン	9
3.1.6 CIB 内電源回路	11
3.1.7 EPS	11
3.1.8 ミッション部電源系	16
3.1.9 電源系コメント	16
3.2 通信系(衛星)(大本)	17
3.2.1 通信機, アンテナ概要	17
3.2.2 VHF 系	18
3.2.3 UHF 系	20
3.2.4 5.8GHz 系	20
3.3 地上局(加藤・飯島)	21
3.4 C&DH 系(OBC 岩崎・小出・林・井手, COBC 黒崎・中塚・大本, Rpi 飯島)	21
3.4.1 CIB	21
3.4.2 OBC	31
3.4.3 初期運用	34
3.5 姿勢制御系(恒光・中西)	42
3.6 構体系(奥山・大野) 重量管理も含む	42
3.6.1 3DCAD 設計	42
3.6.2 図面作成	43
3.6.3 発注	44
3.6.4 組み立て	44
3.7 熱系(中村)	45
3.8 VHF/UHF 展開アンテナ(仁尾・坂本)	45
3.9 ミッション系	45
3.9.1 5.8GHz 通信ミッション(井手)	45
3.9.2 伸展カメラ	46

3.9.3 膜展開部	51
第4章 統合試験	57
4.1 放射線試験（寺田（報告書）・池谷・黒崎）	57
4.1.1 目的	57
4.1.2 試験概要	57
4.1.3 第1回放射線試験	58
4.1.4 第2回放射線試験	60
4.2 形状計測試験（大野・奥山）	62
4.2.1 外形寸法に関する要求	63
4.2.2 レールに関する要求	65
4.2.3 エンベロープに関する要求	65
4.2.4 質量特性に関する要求	66
4.2.5 セパレーションスプリング/ディプロイメントスイッチに関する要求	66
4.2.6 強度要求	66
4.2.7 アクセス窓	66
4.3 振動試験（加藤・飯島）	67
4.3.1 振動試験とは	67
4.3.2 試験内容	69
4.3.3 各試験の概要	73
4.3.4 振動試験実施の流れ	74
4.3.5 OrigamiSat-1 の振動試験において発生した不具合及びトラブル	75
4.4 衝撃試験（大野）	76
4.4.1 使用装置	77
4.4.2 準備（私がやったこと）	77
4.4.3 試験	79
4.4.4 キャリーケースの損傷	80
4.4.5 付録：全体スケジュール	80
4.5 連続動作試験 EMver（？）	80
4.6 姿勢制御試験（恒光）	80
4.7 通信系機能試験（大本）	80
4.7.1 通信系設計、機能試験を行うにあたって	81
4.7.2 モノポールアンテナ	81
4.7.3 パッチアンテナ	81
4.7.4 モノポールアンテナ インピーダンスマッチング試験	82
4.7.5 モノポールアンテナ 放射特性試験	85
4.7.6 パッチアンテナ 利得・放射特性試験	86
4.7.7 長距離通信模擬試験	88
4.7.8 反省点	88
4.8 熱真空試験（中村）：ベーキングについても言及	89
4.9 表面あらさ計測（大野・奥山）	89
4.9.1 計測の目的	89
4.9.2 計測機器	89
4.9.3 1回目の計測	89

4.9.4 レール傷の処理	90
4.9.5 2回目の計測	90
4.10 放出試験（大野・奥山）	91
4.10.1 計測の目的	91
4.10.2 水平引き出し試験	92
4.10.3 垂直引き出し試験	93
第 5 章 安全審査（中西・坂本）	95
5.1 Phase 0/1	95
5.2 Phase 2	95
5.3 Phase 3	95
第 6 章 引き渡し	96
6.1 コンプライアンスマトリクス（大野・中西）	96
6.2 内之浦での引き渡し（中西・坂本）	96
第 7 章 運用と不具合解析（加藤？）	97
7.1 運用（坂本・加藤・井手）	97
7.2 軌道上データ（坂本・井手・岩崎）	97
7.3 不具合解析（岩崎・大本）	97
7.3.1 衛星動作モード切替に関する不具合	97
7.3.2 I2C 信号衝突による不具合	97
第 8 章 革新的衛星技術実証プログラムへの参加（坂本）	98
第 9 章 国際周波数調整（中西）	99
第 10 章 内閣府宇宙活動法（坂本）	100
第 11 章 物体登録（中西）	101
第 12 章 プロジェクトマネジメント（池谷・岩崎・大野）	102
12.1 開発日程	102
12.1.1 BBM 開発	102
12.1.2 EM 開発	102
12.1.3 FM 開発	103
12.2 人員配置・引継ぎ	103
第 13 章 付録	104
13.1 システム設計	104
13.2 5.8	104
13.3 構体系	104
13.4 VHF/UHF 展開アンテナ	104
13.5 通信系	104
13.6 C&DH 系	104
13.7 電源系	104

13.7.1 バッテリ充放電特性計測	104
13.8 振動試験	104
13.9 熱真空試験	104
13.10 連続動作試験	104
13.11 引渡し	104
13.12 プロジェクトマネジメント	104
13.13 展開膜	104
13.14 MDC	104
13.15 伸展カメラ部	104
13.16 運用	104
参考文献	105
謝辞	106

第1章 背景および衛星の概要

本文aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

第2章 ミッション定義

2.1 開発の目的・ミッションステートメント / サクセスクラティア / ミッションシークエンス

test

2.2 システム要求 (ミッション系 (坂本) / バス系 / インターフェース / 安全 (中西))

test

2.3 システム設計

test

第3章 サブシステム開発の経緯（設計・試験）

3.1 電源系（概要/EPS/インヒビット設計（二重絶縁）/電源系統図/電池/SAP）（池谷・中塚）

3.1.1 概要

本節では本衛星の電源系について述べる。本衛星の電源系の概要を図 3.1 に示す。本衛星の電源系は主に以下のコンポーネントから構成されている。

- 太陽電池パネル (Solar Array Panel, SAP)
- バッテリ
- インヒビット回路
- 放出検知スイッチ・ライトピン
- CIB 内電源回路
- 電源基板 (Electrical Power System, EPS)
- 伸展カメラ部電源系

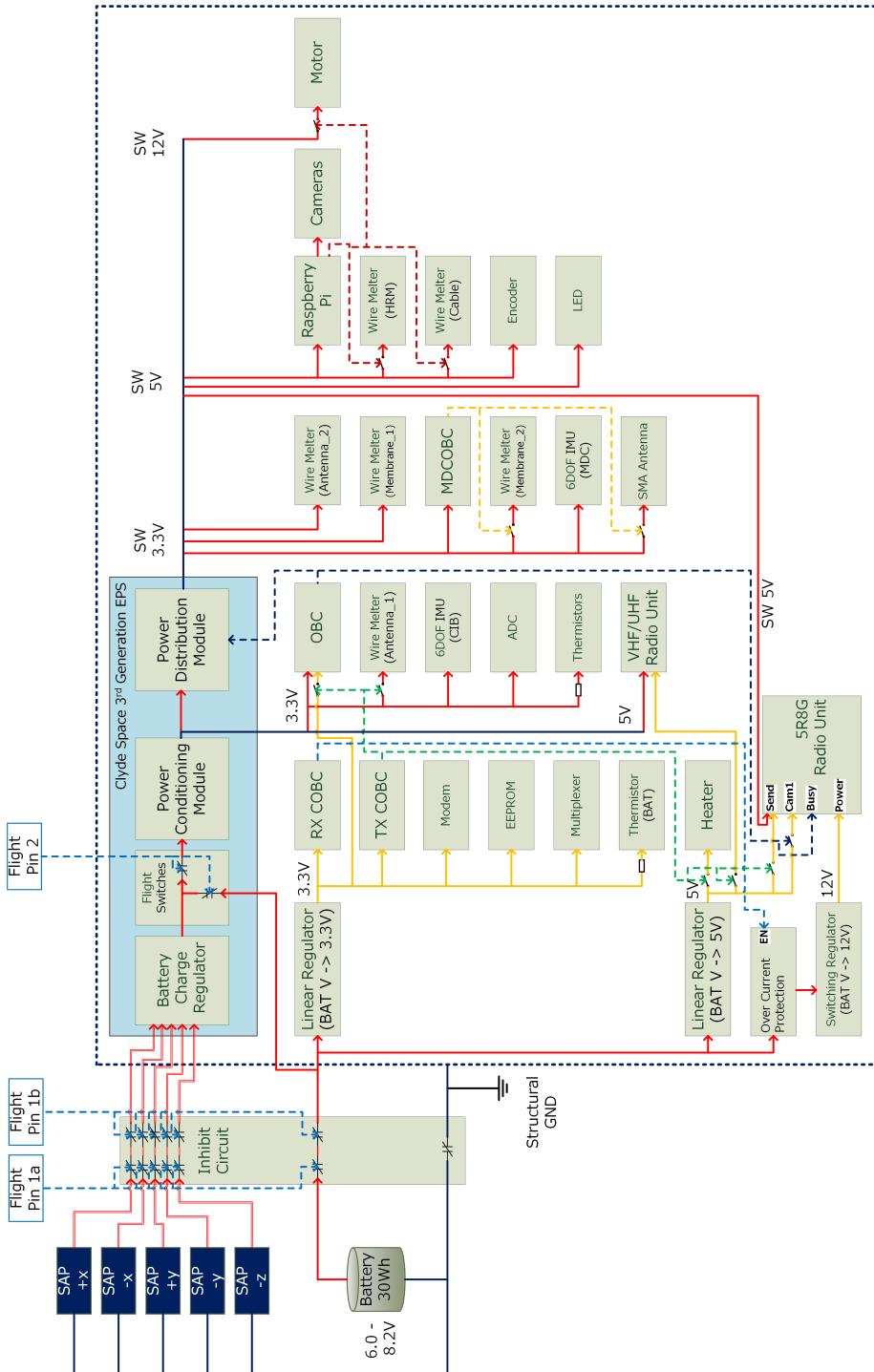


図 3.1: Example of a figure caption.

3.1.2 SAP

(1) SAP 製作

OrigamiSat-1 では AZUL 社の太陽電池セルを購入し、アレイ化、土台への接着を開発メンバーで行った。アレイ化は、太陽電池セル同士や感光基板をはんだで繋げて、設計どおりの直列数及び形状の太陽電池アレイを作る作業である。アレイ化の詳細手順は「太陽電池セル簡易アレイ化手順書.docx」を参照。土台への接着は、上記太陽電池アレイを接着剤を用いて、カプトンテープを貼った土台上に接着する作業である。土台への接着の詳細手順は、「Solar_Cell_Lay_Down.pdf」及び「20180607_OrigamiSat-1_EM_SAP 接着.docx」を参照。

(2) SAP 試験

太陽電池の出力特性試験は、太陽シミュレーターを用いて軌道上と同等の照射強度の光を照射し、太陽電池の電圧-電流特性を測定することで、太陽電池が正常に機能しているかを確認するための試験である。試験により測定した出力特性と、太陽電池セルのデータシート記載の出力特性を比較し確認を行った。出力特性試験は太陽電池セル単体、セルのアレイ化後、アレイの土台への接着後、機体組立後に行った。ただし機体組立後については、正しい測定位置に太陽電池面を持ってくることができなかつたため簡易的に行い、データシートの出力値と大きく変化がないことのみ確認した。組立後に正確に測定をするためには別途専用の治具を製作する必要があると思われる。詳細な試験手順については「ソーラーシミュレーター実験計画書.docx」を参照。また上記の太陽電池出力特性試験とは別に、アレイ化後以降はアレイの一部セルを覆って光が当たらないようにした上で出力を測定し、バイパス機能の確認も行った。

3.1.3 バッテリ

バッテリは公称電圧 7.6V、放電容量 3900mAh の Clyde Space 社の 30Wh Standalone CubeSat Battery を購入した（図 3.2）。バッテリの電気・構造的特性を表 3.1 に、絶対最大定格を表 3.2 に示す。このバッテリパックは 2 直 3 並列のリチウムポリマー電池であり、UN 勧告適合品、NASA 標準 EP-Wi-032 適合品である。

本バッテリにはセルレベルの過電流、過充電、過放電保護回路（図 3.3），および 1 並列ごとの過電流保護回路が組み込まれている（図 3.4）。これらの保護機能については、Clyde Space 社から試験報告書を入手し、さらに本衛星開発チームで環境試験（振動、衝撃）前後の充放電特性を測定した（13.7.1 参照）。

また 0°C 以下で自動で動作するヒータが組み込まれており、さらに温度関係なく制御可能な自作ヒータを貼り付けた（図 3.5）。

FM および EMにおいてはバッテリの I²C ラインの故障が生じたために、組み込まれていたテレメトリ取得機能が使用不可能となった。バッテリの電圧、温度等の情報は別系統で取得可能にしていた。

3.1.4 インヒビット回路

射場作業から衛星分離までの期間における意図しない電波放射を防ぐ、あるいは放出ポッド搭載から放出までの太陽電池からの電源供給を遮断する等の目的のために、文献 [?] を参

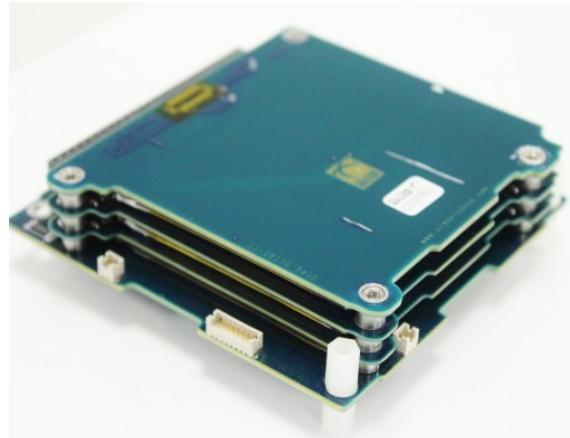


図 3.2: 30Wh Standalone CubeSat Battery (c)Clyde Space

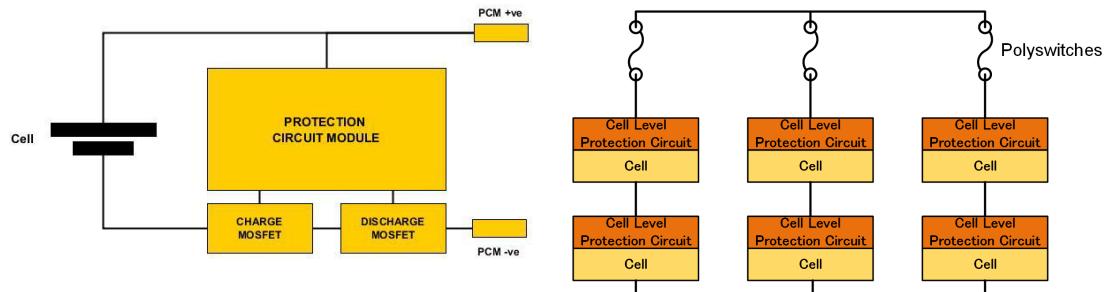


図 3.3: Cell Level Protection Circuit Schematic [?]

図 3.4: Battery Protection Architecture

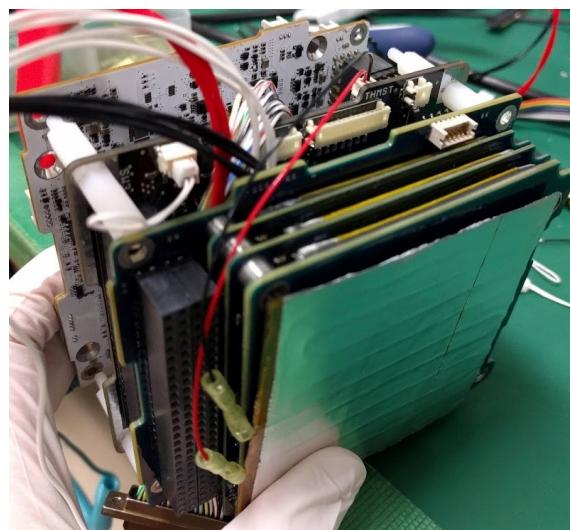


図 3.5: Image of Heater on Battery

Description	Notes	Min	Typical	Max	Unit
Charge Conditions					
EoC Voltage		8.22	8.26	8.3	V
Charge Current	Recommended maximum C/2	--	1.95	--	A
Discharge Conditions					
Full Discharge Voltage		6.16	6.2	6.24	V
Discharge Current	Recommended maximum C/2	--	1.95	--	A
Depth of Discharge	Recommended	--	20%	--	Capacity
Capacity					
Discharge rate C/15	-20°C	--	3.64	--	Ah
	0°C	--	3.92	--	Ah
	20°C	--	4.04	--	Ah
	40°C	--	4.02	--	Ah
Discharge rate C/10	-20°C	--	3.57	--	Ah
	0°C	--	3.88	--	Ah
	20°C	--	4.03	--	Ah
	40°C	--	4.15	--	Ah
Discharge rate C/5	-20°C	--	3.4	--	Ah
	0°C	--	3.87	--	Ah
	20°C	--	4.01	--	Ah
	40°C	--	4.02	--	Ah
Discharge rate C/2	-20°C	--	2.49	--	Ah
	0°C	--	3.59	--	Ah
	20°C	--	3.78	--	Ah
	40°C	--	3.89	--	Ah
Operating Conditions					
Quiescent Power Consumption	Draw from 3V3 (and negligible power from 5V)	--	--	< 0.1	W
Heater					
Power Draw	Heater active (3V3 powered heater)	--	0.60	--	W
Temperature	Enable heater	--	1	--	°C
	Disable heater	--	6.5	--	°C
Physical					
Dimensions	Height from top PCB to lowest component	21.55			mm
Weight		254	268	281	g

表 3.1: Electrical and Physical Characteristics of Battery [?]

表 3.2: Maximum Ratings of Battery [?]

Max Ratings Over Operating Temperature Range (Unless Otherwise Stated)				
	BCR	Value	Unit	
Charge Limits	Voltage	max	8.4	V
	Current	max	6	A
	Current Rate	max	1.53C	Fraction of Capacity
Discharge Limits	Voltage	max	6.2	V
	Current	max	6	A
	Current Rate	max	1.53C	Fraction of Capacity
Operating Temperature		-10 to 50		°C
		1 Year: -20 to +20		
Storage Temperature		3 Months: -20 to +45		°C
		1 Month: -20 to +60		
Vacuum		10 ⁻⁵		torr
Vibration		To [RD-3]		

考に 3 インヒビット回路を本衛星に設けた。購入品の機能ではこの要求を満たせなかつたため、Battery-EPS 間に新たに通信・インヒビット基板 (Communication & Inhibit circuit Board, CIB) を設けた (図 3.6, ??)。

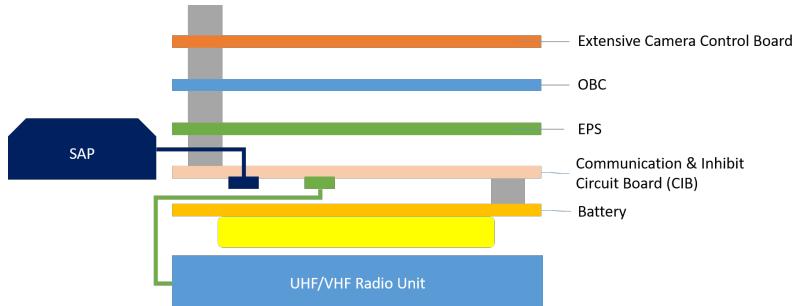


図 3.6: Overview of Satellite Bus Components

インヒビット回路の回路図は図 3.8 のようになっている。購入した EPS の仕様上 Battery-EPS 間のみならず、SAP-EPS 間も遮断し、SAP に光が当たっていても EPS が動作しないようにした (図 3.13 参照)。

COLD 側の MOSFET は ON Semiconductor 社の NTMFS5C404N を Back to Back で接続した。これは電流を双方向に流すことが目的であったが実際には EPS 側からバッテリ側にのみ流れるため、MOSFET 内のドレイン・ソース間オン抵抗、および基板実装を考慮し、片方のみが好ましい。

HOT 側のソリッドステートリレーは Battery-EPS 間にオムロン株式会社の G3VM-31HR を、SAP-EPS 間にはパナソニック株式会社 AQY211G2 を選定した。これは低オン抵抗であることを重要視して選定した。HOT 側のインヒビットは P-channel MOSFET と N-channel MOSFET を組み合わせても (充放電ともにできるよう設計しなければならないが) 実現可能である。本衛星では回路の簡易化のためにソリッドステートリレーを選択したものの、MOSFET のほうが概して内部抵抗が小さいため基板の面積との兼ね合いでは MOSFET に

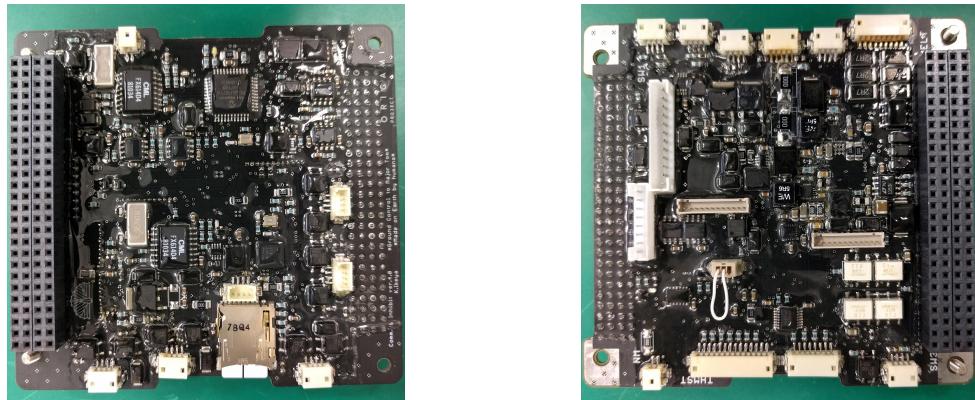


図 3.7: Image of CIB

による遮断も検討する必要がある。

これらのIC動作の不具合は衛星にとって致命的であるため実証実績の少ないソリッドステートリレーは並列に接続し冗長系を組んだ。また放射線試験によって放射線耐性を入念に確認した。

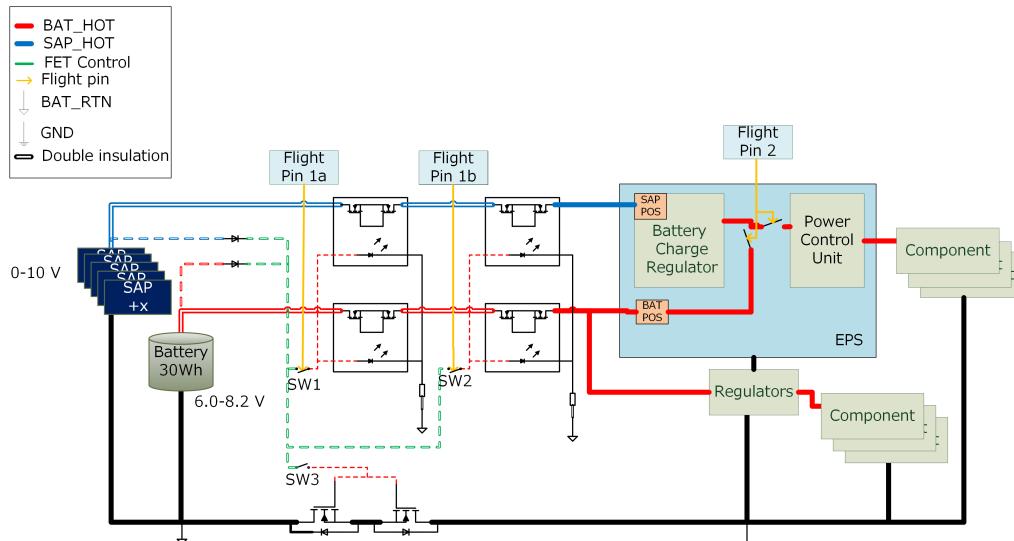


図 3.8: Inhibit Circuit Diagram

3.1.5 放出検知スイッチ・フライトピン

図3.8中のSW1, SW2, SW3は放出検知スイッチであり、放出検知ピンにより開放・短絡が制御される(図3.9)。

放出ポッド搭載までの意図せぬ電源投入を防ぐためにフライトピンを設けた。本衛星には放出検知ピンを機械的にロックするフライトピン(1a, 1b, 図3.10)と電気的にEPS以降の起動を阻止するフライトピン2がある。

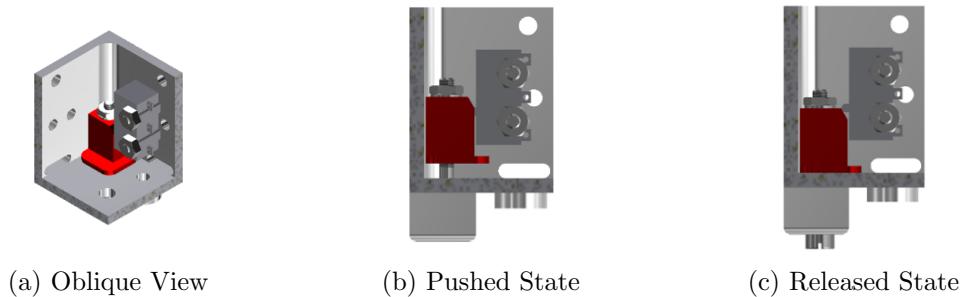


図 3.9: Release Detection Pin

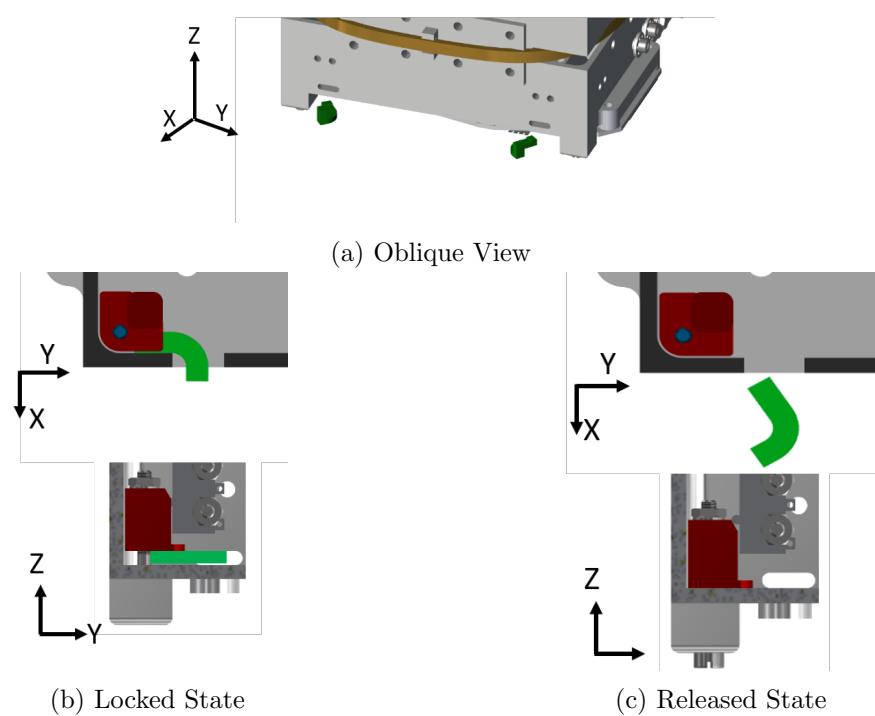


図 3.10: Flight Pin 1

フライトピン 2 は EPS の組み込み機能である Separation Switch 端子と RBF(Remove Before Flight) Switch 端子を GND に導通させることで EPS の起動を防ぐ。

3.1.6 CIB 内電源回路

通信用マイコンである RXCOBC, TXCOBC はミッション開始から終了まで非常時を除きすべての期間で起動している必要がある。EPS から電源供給されるコンポーネントの一括 ON/OFF を可能にするためにこれらの電源系は EPS 基板とは別に新たに設け、EPS 電源が入っていない状態においても衛星として最低限の役割が機能するように設計した。RXCOBC, TXCOBC の電源である CIB 内の 3.3 V 系には一般的に効率の良いスイッチングレギュレータではなく信頼性の高いリニアレギュレータを使用した。さらにレギュレータが 1 つ動作しなかった場合に備えて二つのレギュレータを並列で繋いだ（図 3.11）。一般にリニアレギュレータの並列は OR ダイオードを用いて行われる [?].

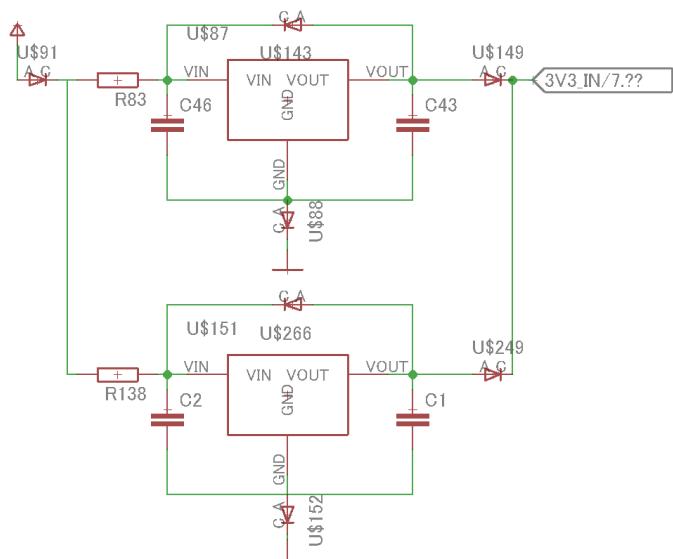


図 3.11: Paralleling Linear Regulators Schematic

UHF/VHF 無線機は EPS からの供給をメインとし、EPS 非起動時にも通信が行えるように 5V を CIB 内でリニアレギュレータを用いて生成できるようにした。

さらに 5.8GHz 送信を行う際の突入電流により EPS の過電流保護機能が働き、他の機器への影響がでてしまうため昇圧スイッチング・レギュレータを用いて 12V 系も新たに CIB 上に設計した。さらにレギュレータの故障による過電流防止のために、IC を設けた。また放射線試験による IC の放射線耐性を入念に確認した。

3.1.7 EPS

EPS は Clyde Space 社の 3rd Generation 3U EPS を購入した。EPS の電気・構造的特性を表 3.3 に、絶対最大定格を表 3.4 に示す。

EPS ユーザーマニュアル記載の EPS および SAP, Battery を含めた機能図を図 3.13 に示す。なお本衛星では Battery-EPS 間、SAP-EPS 間にインヒビット回路が組み込まれている

表 3.3: Electrical and Physical Characteristics of EPS [?]

Description	Conditions	Min	Typical	Max	Unit
BCRs 1&2					
Input Voltage		7.4	--	30	V
Output Voltage		6.144	--	8.26	V
Output Current		0	--	1.5	A
Switching Frequency		245	250	255	kHz
Efficiency	@16.5V input, Full Load	85%	90%	92%	
BCR 3					
Input Voltage		3.5	--	9.2	V
Output Voltage		6.144	--	8.26	V
Output Current		0	--	0.5	A
Operating Frequency		160	170	180	kHz
Efficiency	@6V input, Full Load	77%	79%	80%	
Unregulated Battery Bus					
Output Voltage		6.144	--	8.26	V
Output Current		--	4	4.5	A
Operating Frequency		--	--	--	
Efficiency	@8.26V input, Full Load	98.5%	99%	99.5%	
5V Bus					
Output Voltage		4.95	5	5.05	V
Output Current		--	4	4.5	A
Operating Frequency		470	480	490	kHz
Efficiency	@5V input, Full Load	95%	96%	98%	
3.3V Bus					
Output Voltage		3.267	3.3	3.333	V
Output Current		--	4	4.5	A
Operating Frequency		470	480	490	kHz
Efficiency	@3.3V input, Full Load	94%	95%	97%	
12V Bus					
Output Voltage		11.88	12	12.12	V
Output Current		--	1.2	1.5	A
Operating Frequency		750	800	850	kHz
Efficiency	@3.3V input, Full Load	90%	94%	96%	
Communications					
Protocol		--	I ² C	--	
Transmission speed		--	100	--	Kbits ⁻¹
Bus voltage		3.26V	3.3V	3.33V	
Node address		--	0x2B	--	Hex
Address scheme		--	7bit	--	
Node operating frequency		--	27MHz	--	
Quiescent Operation					
Power Draw	Flight Configuration of Activation Switches	--	--	<0.2	W
Physical					
Dimensions	Height from top of PCB to bottom of next PCB in stack	95	90	15.24	mm
Weight		84	86	88	g



図 3.12: EPS

表 3.4: Maximum Ratings of EPS [?]

OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (UNLESS OTHERWISE STATED)				
	BCR	Value	Unit	
Input Voltage ⁽²⁾	SA1A, SA1B (pin 1s)	BCR1	25	V
	SA2A, SA2B (pin 1s)	BCR2	25	V
	SA3A, SA3B (pin 1s)	BCR3	10	V
Battery		8.3	V	
5V Bus		5.05	V	
3.3V Bus		3.33	V	
12V		12.12	V	
Input Current	BCR1	@16V	750	mA
	BCR2	@16V	750	mA
	BCR3	@6V	750	mA
Output Current	Battery Bus	@8.26V	4.5	A
	5V Bus	@5V	4.5	A
	3.3V Bus	@3.3V	4.5	A
	12V Bus	@12V	1.5	A
Operating Temperature		-40 to 85	°C	
Storage Temperature		-50 to 100	°C	
Vacuum		10 ⁻⁵	torr	
Radiation Tolerance		10	kRad	
Vibration		To [RD-3]		

ため実際のコンフィグレーションとは異なる。EPS の各スイッチの ON/OFF は OBC からの I²C によって制御された。

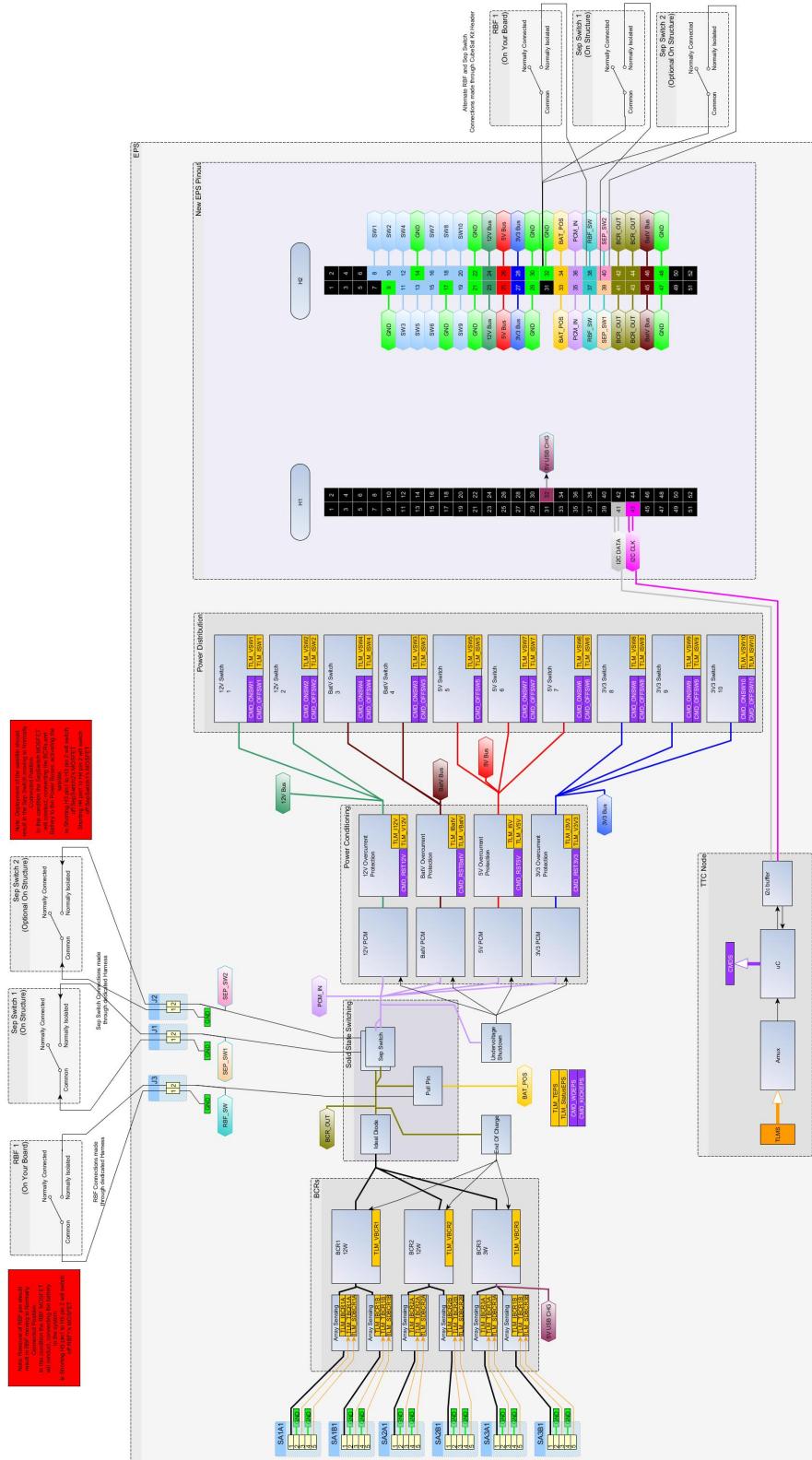


図 3.13: Functional Diagram of EPS [?]

3.1.8 ミッション部電源系

ミッション部電源系は OBC が送信した UART 信号により Raspberry Pi がスイッチの ON/OFF を切り替えることで操作される。詳細は \ref{text} で述べる。

3.1.9 電源系コメント

(1) SAP

SAP 製作

- SAP 製作及び SAP 試験は作業量的には 1 人いれば十分可能だが、精神衛生上 2 人以上の作業を勧める。特に SAP 出力特性試験では連日 3 号館 101 室を真っ暗にして何時間も 1 人での作業が続き、思っていた以上に負担が大きかった。
- SAP 製作は非常に時間がかかる上に少しのミスで大きな出戻りが発生する作業である。購入するセル枚数、製作時間には大きくマージンをとっておくことを推奨する。OrigamiSat-1 では最終的に FM 機体用のセルの予備がなくなり、一部表面にひびが入っているセルを使用することになった。なお、OrigamiSat-1 の試験においては、多少表面にひびが入っていても太陽電池の出力に変化はみられなかった。しかし軌道上で耐久性等に影響が出ることも考えられる。製作時間に関しては、アレイ化の作業時間に加えて、接着剤の乾燥時間も必要であるため、1 回出戻りが発生すると 2 週間弱追加でかかった。
- 土台への接着後、アレイのうち 1 つでもセルが破損した場合、基本的にはアレイ全て取り換える必要がある。なお、一部のみの取り換えは不可能ではない。実際 OrigamiSat-1 では予備のセルがなかったこともあり、開発過程で 4 直のアレイのうち 1 枚だけを取り除いて他のセルを再利用したこともある。しかし取り換え作業は非常に困難な上、正常な他のセルも傷つける可能性が高い。
- OrigamiSat-1 では太陽電池セルの総枚数が 18 枚であったため SAP 製作が可能であったが、今後の衛星開発でもし太陽電池の枚数を増やすことがあれば、予算との兼ね合いもあるが、SAP 製作の外注も検討するべきだと思う。SAP の設計次第ではあるが、太陽電池のセル単位の購入ではなくアレイ化までしてもらった状態での購入も選択肢として存在する。BBM から FM まで合計何枚の太陽電池セルを発注するか、SAP の製作精度、開発時間等を含め SAP 製作のどこを自分達で行うか今後の衛星開発では検討することを勧める。
- 内之浦での OrigamiSat-1 の E-SSOD への挿入時、IA の点検担当の方から感光基板の端のわずかな浮きを指摘された。この浮きは接着作業が完璧でなかったことが原因で生じたものであり、衛星引き渡し時は、振動等によってこれ以上浮きが進展しないことを説明し理解が得られた。このような浮きが生じないようにするために、接着作業だけでなく乾燥期間の重し等の状態にも注意が必要である。

SAP 試験

- 出力特性試験では、あらかじめ大きなブレッドボード上に試験に使う抵抗を一式用意しておき、ハーネスの接続先を変えるだけの状態で試験をした方がよかつた。FM 用 SAP 試験では、残り作業量がわずかだと思っていたため毎回抵抗を付け替えて行って

いたが、1回の試験での付け替えには時間がかかる上に、最終的には何かと追加試験をやる機会が増えたため、改善しておけばよかった。

- 太陽シミュレーター及びサーモパイアル(太陽シミュレーター用放射強度計)は非常に高価な機器であるため、取り扱いには特に注意する。また、サーモパイアルの管理には注意をすること。一時期サーモパイアルが行方不明になっていたようであるが、サーモパイアルがなければ正しく放射強度の設定を行うことができず試験にならないため要注意。また、松永研所有の機器であるため、使用許可を必ずとること。使用報告の徹底が行き届いておらず、松永先生に注意されたことがあった。

3.2 通信系(衛星) (大本)

3.2.1 通信機、アンテナ概要

本衛星に搭載する通信機としては、以下の3つがある。

- 1 地上局からのアップリンクを受信する VHF 系
- 2 地上局へ CW 信号、FM 信号をダウンリンクする UHF 系
- 3 地上局へ大容量データをダウンリンクする 5.8GHz 系

衛星と地上局の通信の概略図を図 3.14 に示す。本衛星の回線設計は本衛星の軌道情報、東工大松永研究室地上局設備の性能を加味し、図 3.15 のようになされた。それぞれに要求される性能を記述する。

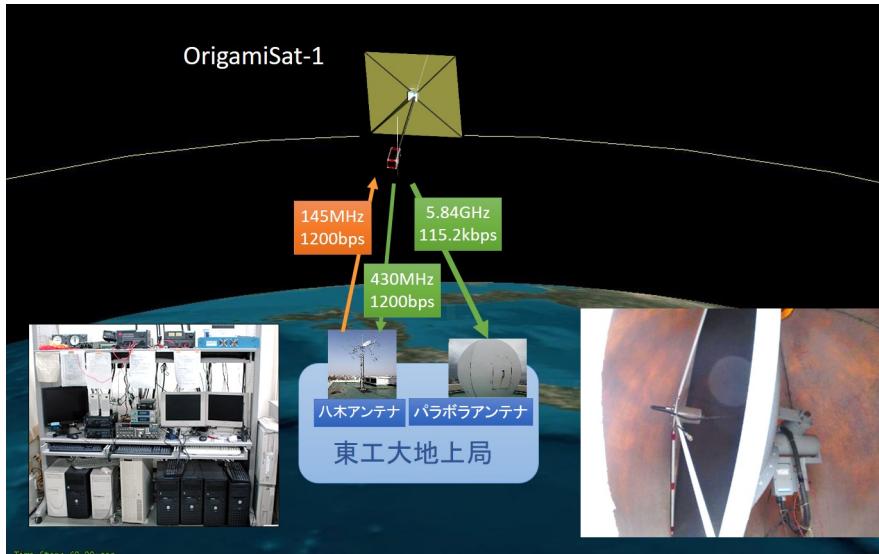


図 3.14: 通信系概略図

軌道: 高度 500km、太陽同期軌道
最大通信距離: 2071km
通信仰角: 5° 以上

項目	単位	記号	UP LINK (FM)	DOWN LINK (FM)	DOWN LINK (CW)	DOWN LINK (5.84GHz)
周波数	MHz		145.0	435.0	435.0	5840.0
送信 EIRP	dBW	P_E	20.59	-4.18	-13.21	3.01
送信出力	dBW	P_TX	16.99	-0.97	-10.00	3.01
給電損失	dB	L_FTX	2.70	0.21	0.21	0.00
送信アンテナ利得	dBi	G_ATX	9.30	0.00	0.00	3.00
ポイントティング損失	dB	L_APTX	3.00	3.00	3.00	3.00
自由空間損失	dB	L_d	142.00	151.55	151.55	174.10
偏波損失	dB	L_P	3.00	3.00	3.00	0.00
電離層吸収損失	dB	L_Ion	0.00	0.00	0.00	0.00
大気吸収損失	dB	L_A	0.00	0.00	0.00	0.00
降雨損失	dB	L_RA	0.00	0.00	0.00	0.01
受信 G/T			-34.07	-14.61	-14.61	9.39
ポイントティング損失	dB	L_APRX	0.83	3.00	3.00	3.00
受信アンテナ利得	dBi	G_ARX	-5.00	19.00	19.00	38.62
給電損失	dB	L_FRX	0.45	4.30	4.30	0.00
システム雑音	dBK	T_S	27.79	26.31	26.31	26.23
受信 C/N0	dBHz		70.12	55.26	46.23	66.89
要求 C/N0	dBHz		49.79	45.79	44.03	65.61
ビットレート	dBHz	BR	30.79	30.79	29.03	50.61
要求 Eb/N0	dB		10.50	9.50	9.50	9.50
変調方式			AFSK (1200bps)	AFSK (1200bps) (80wbm)	CW 2 値	FSK
変調損失	dB	L_m	6.00	6.00	6.00	6.00
ハードウェア劣化量	dB	L_DM	2.50	2.50	2.50	2.50
符号化利得	dBi	Q_c	0.00	3.00	3.00	3.00
回線マージン	dB		20.32	9.47	2.20	1.27

図 3.15: 回線設計

3.2.2 VHF 系

VHF 帯 (Very High Frequency) の通信機では地上局からのアップリンクを受信するため用いる。通信機は西無線研究所の 301A 型 (図 3.16) を用いた。アンテナにはコンベックス加工を行ったリン青銅製のモノポールアンテナ (幅 5mm, 厚さ 0.1mm) のものを用い、長さはインピーダンスマッチング試験を通じて決定した。以下に設計スペックおよび系統図 (3.17) を示す。

- 周波数 : 145.980MHz
- 送信出力 : 100mW(CW), 800mW(CW)
- 寸法 : 60x50x10.5mm
- 重量 : 38g
- アンテナ利得 : 0dBi
- 周波数帯域幅 : 500Hz(CW), 20kHz(FM)

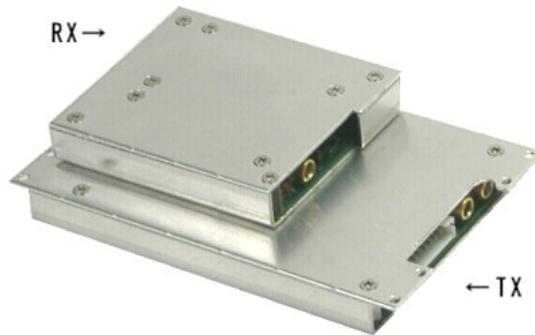


図 3.16: TXE430MFMCW-301A, RXE145M-301A

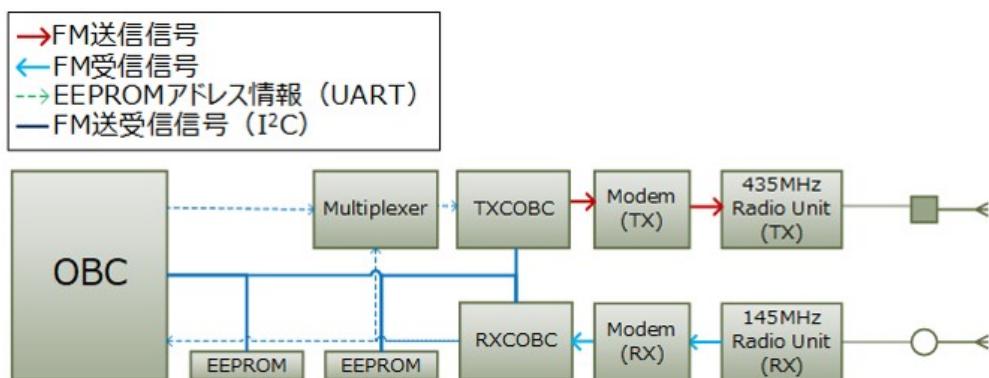


図 3.17: UHF/VHF 系通信系統図

購入した無線機内部にはモデム回路が組み込まれておらず、そのため本衛星では CIB 上にモデム回路が搭載された。モデム IC は CML Microcircuits 社の FX614 を購入した(購入先は誠大電機)。初期は Texas Instruments 社の TCM3105NL を用いて開発を行っていたが、調整必要なパラメータが大きくそれぞれの感度が高く送受信困難であったため、CubeSat 仕様実績のある FX614 に変更した。モデム回路図を図 3.18 に示す。

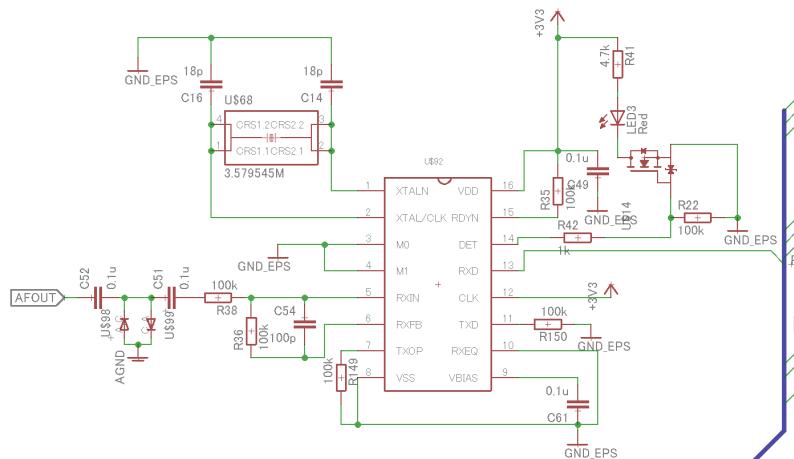


図 3.18: RX Modem Circuit Schematic

3.2.3 UHF系

UHF帯(Ultra High Frequency)の通信機では地上局へCW信号, FM信号をダウンリンクするために用いる。通信機は西無線研究所の301A型を用いた。アンテナにはコンベックス加工を行ったリン青銅のモノポールアンテナ(幅5mm, 厚さ0.1mm)のものを用い、長さはインピーダンスマッチング試験を通じて決定した。以下に設計スペックおよび系統図(3.17)を示す。

- 周波数: 437.505MHz
- 寸法: 100x60x10.5mm
- 重量: 60g
- アンテナ利得: 0dBi

こちらもモデム回路はCIB上に新たに搭載された(図3.19)。無線機のFMMOD端子には約0.5Vp-pのAFSK信号入力を推奨されていたため、この回路図のR155とR156の抵抗値は変更されるべきである。実験によってこの値でも問題なく通信できることは確認済であった。

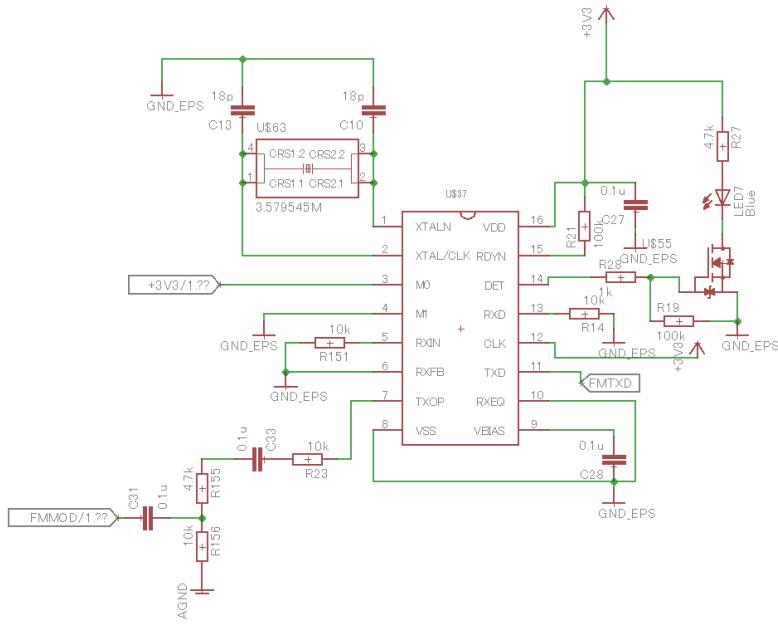


図3.19: TX Modem Circuit Schematic

3.2.4 5.8GHz系

5.8GHz系の通信機では画像などの大容量データをダウンリンクするために用いる。通信機はロジカルプロダクト社製 LPTX5840-1を用いた。アンテナには円偏波パッチアンテナ(30x30x1.6mm)を用いた。以下に設計スペックおよび系統図(3.20)を示す。

- 周波数: 5840MHz
- 送信出力: 2W
- 寸法: 76x70x16mm

- 重量 : 220g
- アンテナ利得 : 3dBi
- 周波数帯域幅 : 210kHz

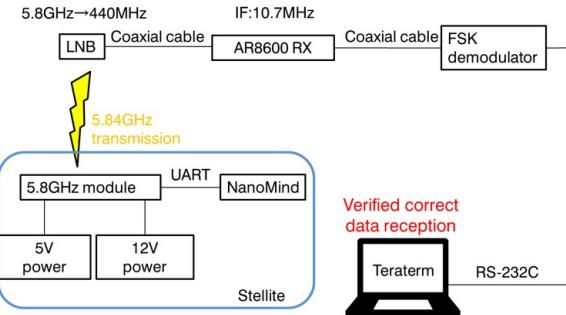


図 3.20: 5.84GHz 系通信系統図

3.3 地上局（加藤・飯島）

3.4 C&DH 系 (OBC 岩崎・小出・林・井手, COBC 黒崎・中塚・大本, Rpi 飯島)

3.4.1 CIB

(1) 基本設計思想

CIB(Communication and Inhibit Board) は、イプシロンロケット搭載のためのシステム安全要求(電源のインヒビット機能)を満たすこと、および消費電力の高い5.8GHz送信機の電源系統を別とすることを目的として新規開発を行った基板であり、バッテリと EPS の間に挿入されている。また、VHF/UHF の受信機(RX)/送信機(TX)(西無線 301A 型)のためのマイコンである RXPIC(PIC 16F877A), TXPIC(PIC 16F886) およびモデム回路も CIB 上に搭載されている。RXPIC はメイン OBC より上位にあるものと考え、メイン OBC を監視する。RXPIC 及び TXPIC は WDT(Watch Dog Timer) を用いて異常時には自身ヘリセットをかける。

(2) プログラム概要

RXPIC 役割 RXPIC の持つ主要機能は大きく分けて以下のものがある。RXPIC の各機能詳細は (3) 参照。

- 初期運用
- EPS リセット
- 無線機の周波数設定
- バッテリ電圧測定及び衛星モード切替
- アップリンクコマンド処理

TXPIC 役割 TXPIC の持つ主要機能は大きく分けて以下のものがある。 TXPIC の各機能詳細は (4) 参照。

- 初期運用
- ADC の値を取得
- レシーブコマンドダウンリンク
- CW ダウンリンク (HK データ / 指定データ)
- FM ダウンリンク (HK データ / 指定データ)
- スイッチ操作

(3) RXPIC 詳細

RXPIC のフローチャートを図 3.21 に示す。

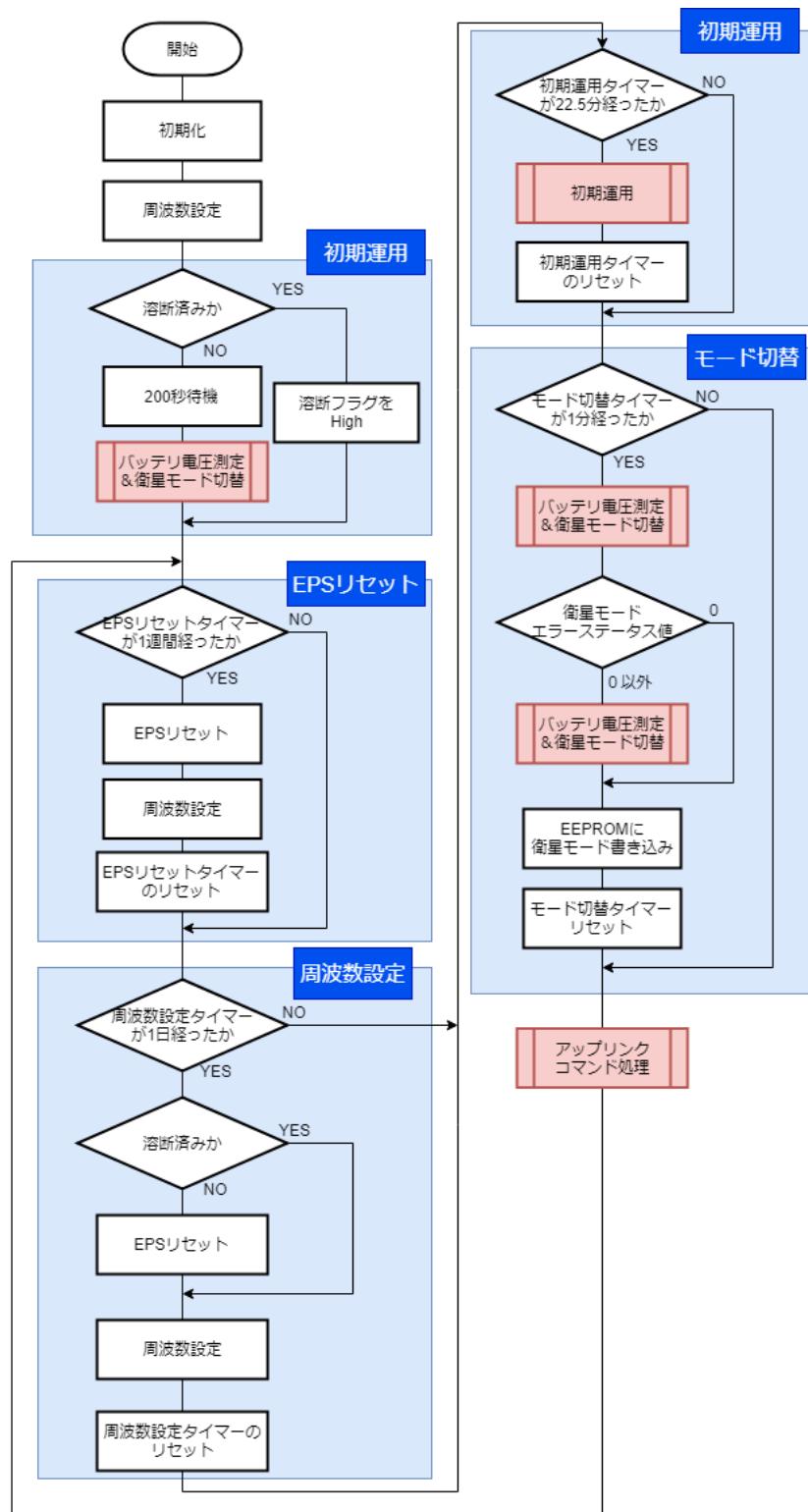


図 3.21: RXPIC 全体フローチャート

以下で RXPIC の各機能について説明する。

初期運用 詳細については初期運用項(統合時ラベル付けして参照)を参照。

EPS リセット RXPIC では 1 週間毎に EPS リセットのタイマー割込みが発生する。これは RXPIC 及び TXPIC 以外の、EPS から電源供給されているコンポーネントの不具合が生じ、実装しているエラー処理で対応しきれないケースに備え、1 週間毎にリセットをかけることを目的として実装した機能である。なお初期運用中は、これに加えて 1 日毎の EPS リセットも行われる。

無線機の周波数設定 RXPIC では 1 日毎に無線機の周波数設定のタイマー割込みが発生する。無線機の周波数設定でエラーが生じ通信できなくなるケースに備え、通常の無線機の電源 ON/OFF に伴う周波数設定とは別に実装した機能である。

バッテリ電圧測定及び衛星モード切替 RXPIC では 1 分毎にバッテリ電圧測定及び衛星モード切替のためのタイマー割込みが発生する。バッテリ電圧に応じて衛星モードは Nominal, Saving, Survival に切り替わり、モードに応じてアクティブなコンポーネントが変化する。モード切替の概念を図 3.22 に示す。モード切替の閾値電圧の初期値はそれぞれ図 3.22 に示す値であり、これらの閾値はコマンドにより変更することができる。電圧降下時と上昇時の初期閾値電圧に差があるのは、電圧上昇によるモード切替に伴いアクティブなコンポーネントが増えることで一時的に電圧が低下し、直後に再びモード切替が起こることを防ぐためである。

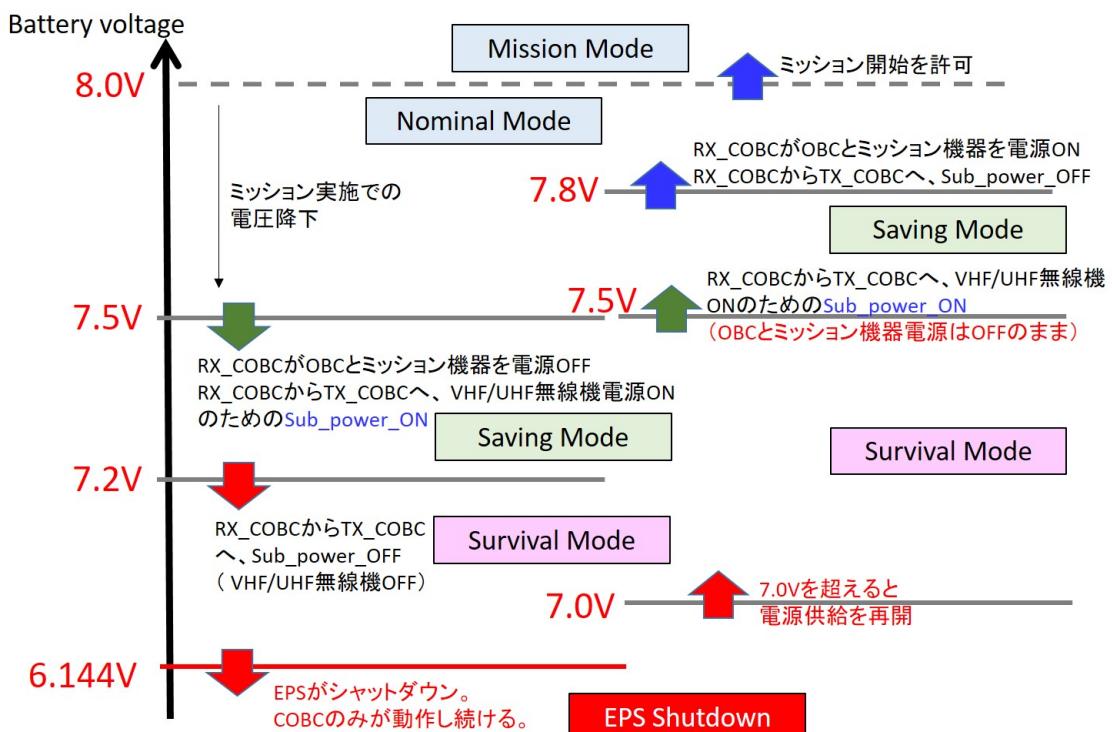


図 3.22: モード切替の概念図

バッテリ電圧測定及び衛星モード切替のフローチャートを図 3.23 に示す。衛星モード切替では、バッテリー電圧、閾値電圧、及び前の衛星モードを取得し、それを元に切替処理を行っている。閾値電圧はメイン/サブ EEPROM を、前の衛星モードはメイン/サブ EEPROM 及びグローバル変数を利用して、取得できないリスクを低減させている。また衛星モード切替

中にエラーが生じ、正常に処理が完了できない場合には基本的に Saving モードに切り替える。バッテリ電圧測定及び衛星モード切替処理では返り値として 1byte のエラーステータスを用意しており、異なる 2bit ずつを異なるエラーに割り当てることで、同時に生じる複数のエラーを検知できるように実装している。1bit ずつの割り当てでないのは、放射線等による bit 反転の影響を小さくするためである。エラー値の詳細については OP-S1-0109 「CW 通信フォーマット」の衛星モードエラーステータスを参照。また衛星モード切替の詳細については、OP-S1-0104 「OrigamiSat-1 モード切替について」を参照。

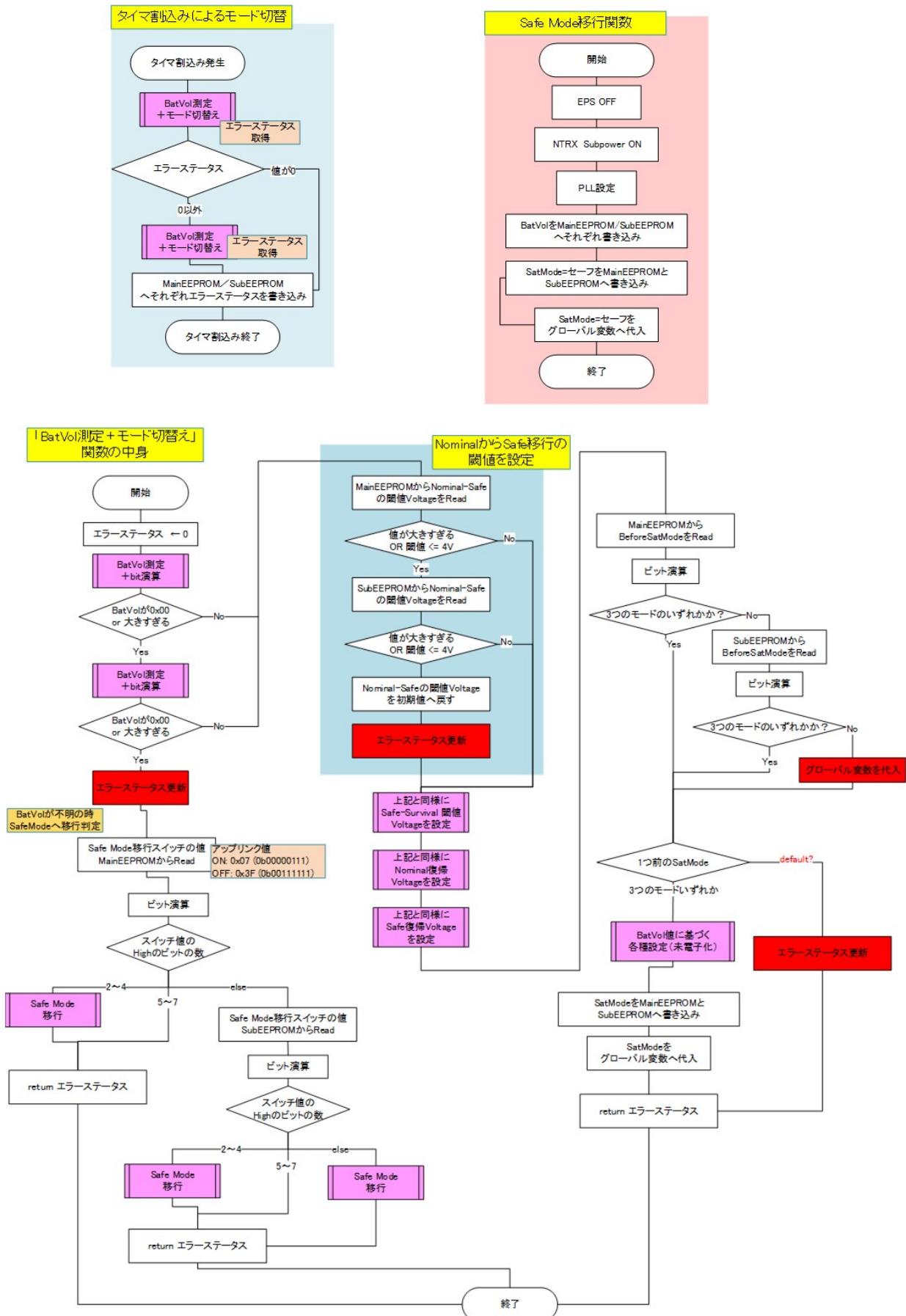


図 3.23: モード切替フローチャート

アップリンクコマンド処理 RXPIC のアップリンクコマンド処理時のフローチャートを図 3.24 に示す。地上局からのアップリンクコマンドを受信後コマンド ID の確認を行い、最終実行コマンド ID と同じであればコマンドの実行は行わない。これは地上局から誤って同じコマンドを 2 回送った時、衛星がそれを実行しないようにするためにある。コマンド ID のチェックが終わった後は EEPROM にコマンドを書き込み、コマンドターゲットに応じて処理を行う。コマンドターゲットが RXPIC であった場合のコマンド実行関数内では、コマンドタイプに応じて switch 文で分岐し、それぞれの処理を行っている。

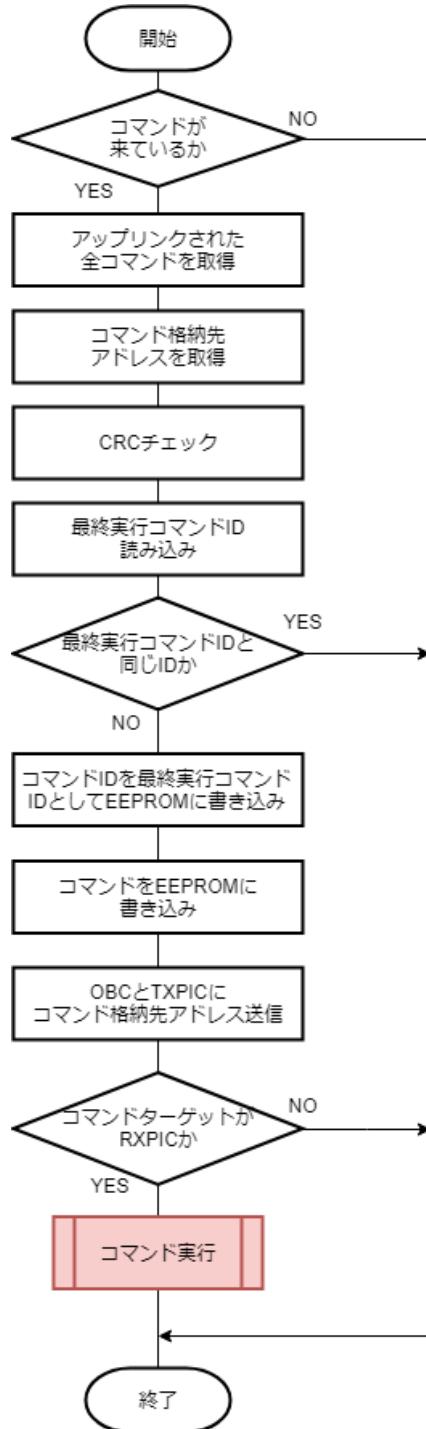


図 3.24: アップリンクコマンド処理フローチャート

(4) TXPIC 詳細

TXPIC のフローチャートを図 3.25 に示す。図 3.25 のフローチャートとは別に割込み関数として、コマンドが来た際に (2) の主要機能のうち、レシーブコマンドダウンリンク、CW ダウンリンク (データ), FM ダウンリンク (HK/データ), スイッチ切替は、図 3.25 中のコマンド実行関数内で行われる。

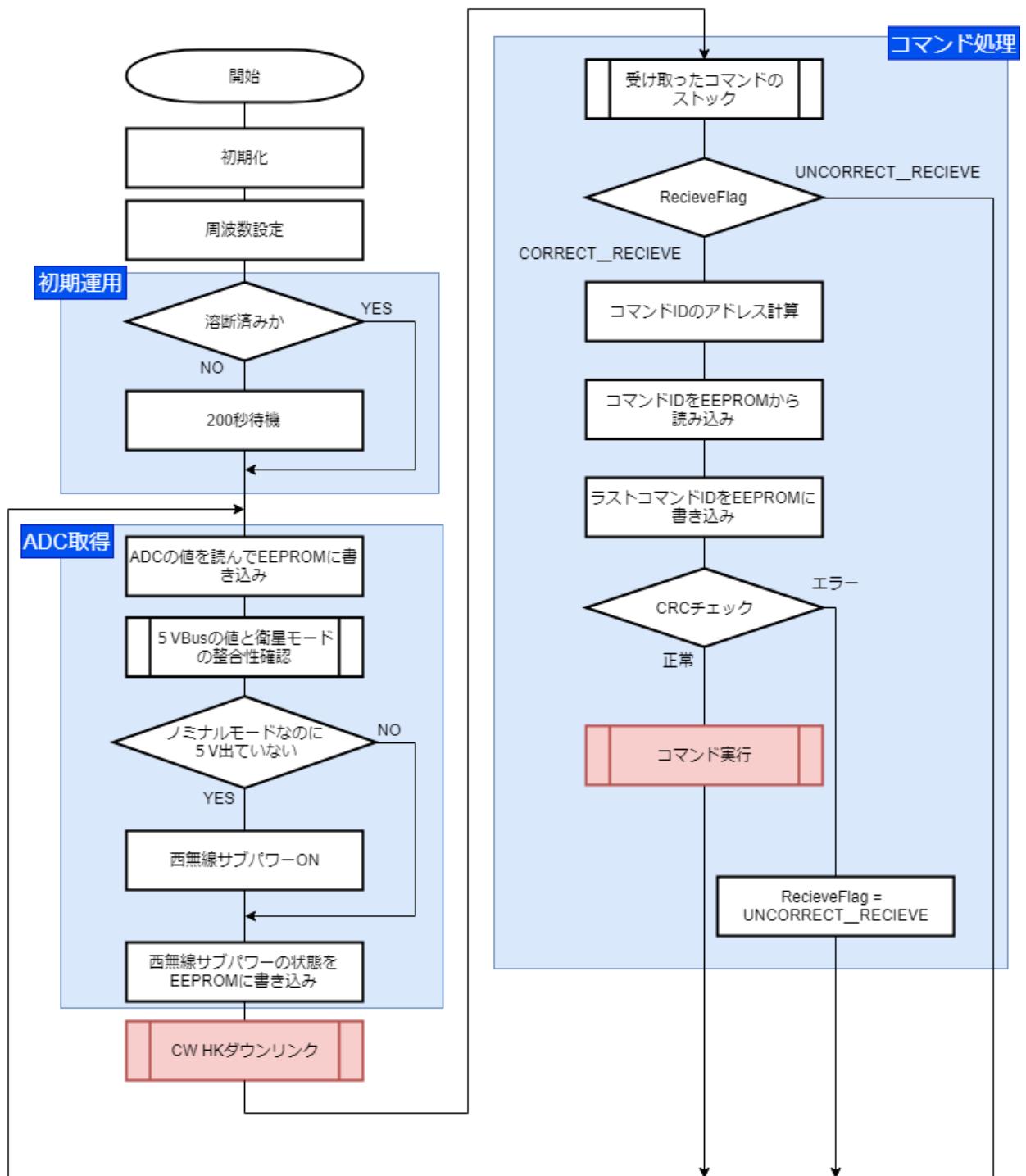


図 3.25: TXPIC 全体フローチャート

以下で TXPIC の各機能について説明する。

初期運用 詳細については初期運用項 (統合時ラベル付けして参照) を参照。

ADC の値を取得 ADC の CH1-4 の値を取得し, EEPROM に保存する。なお, CH1-4 はそれぞれバッテリ温度, EPS5V ライン電圧, EPS3.3V ライン電圧, 5V ライン電圧電圧の値

を示す。ADC の値を取得後、EEPROM から衛星モードの読み込みを行い整合性を確認する。整合性がとれない、すなわちノミナルモードにもかかわらず EPS 5 V ラインの電圧が低かった場合、西無線のサブパワーを ON にする。これは、ノミナル時にエラー等により西無線の電源が遮断され、地上局との通信ができなくなるリスクの低減のために実装を行った。

レシーブコマンドダウンリンク 地上局からアップリンクされたコマンドを受信した後、RXPIC からの指示を受けて TXPIC はアップリンクされたコマンドを地上局に返す。これはコマンドアップリンク時、衛星側がコマンドを受け取ったかどうか判断するために実装を行った。

CW ダウンリンク CW ダウンリンクは、HK ダウンリンクとコマンドによる指定データのダウンリンクの 2 種類がある。CWHK ダウンリンクフォーマットの詳細については、OP-S1-0109 「CW 通信フォーマット」 を参照。コマンドによる指定データのダウンリンクでは、コマンドによって指定された EEPROM アドレスのデータを指定回数ダウンリンクする。CW によるデータダウンリンク機能は、FM 及び 5.8GHz データ送信機能が共に失われた場合に備え実装を行った。

FM ダウンリンク FM ダウンリンクは、HK ダウンリンクとコマンドによる指定データのダウンリンクの 2 種類がある。FM ダウンリンクフォーマットの詳細については、OP-S1-0108 「FM ダウンリンクフォーマット」 を参照。

スイッチ切替 コマンドに応じてヒーター、送受信機、5.8GHz 送信機予備電源、溶断回路、WDT, FMPTT, CWKEY の ON/OFF を切り替える。コマンドで時間を指定することにより、指定時間 ON/OFF を切り替えた後、元の状態に戻す機能が実装されている。

(5) コメントや次回への改善点

- システム設計を早い時期にしっかりと行い、優先順位の高いものからプログラムを作っていくべきだった。複数箇所で使う重要な機能の開発が後半に残っていたことがあった。また、機能を実装したもののは結局使わないものや、ほぼ同じ機能を持つ関数が複数存在する事態が開発途中で発生した。また OrigamiSat-1 の CIB では開発の遅れからエラー処理を実装しきれないところが多くあった。システム設計を早期にしっかりと行い、エラーについても体系的に処理を行い HK データ等でダウンリンクすることで、エラー箇所の切り分けを行うことができれば故障解析もしやすくなつたのではないかと思う。
- EPS リセットの 1 週間という頻度には根拠がないため、次回の衛星開発においてはリセット頻度を検討する必要がある。また、OrigamiSat-1 では RX/TXPIC は自身で定期的にリセットをすることはなかったが、これらについても定期的なリセット機能をつけた方がよかつた可能性もある。
- CW HK データに衛星モード切替のエラーステータスを含めたのは良かった。当初の予定では含まれておらず、衛星引き渡し直前に CW HK データのうち TX/RX コマンドエラーステータス機能にバグを発見し FM 機への実装を断念したことを受け、CIB 開発メンバーで相談し急遽 HK データに入れたものであるが、結果的に衛星の状況を確認し故障解析に必要なデータとして役立った。

- CW HK ダウンリンクでは、データ 1 つずつ EEPROM を読みにいく処理を行っていたが、結果的に EEPROM を読みにいく頻度が高くなり、I2C エラーの一因となっていた可能性がある。複数データをまとめて読みにいく処理に変えるという案も開発途中出ていたが、開発期が間に合わなかった。また、他のコンポーネントが EEPROM を読んでいる時は待機するような機能を実装した方がよかった。
- 複数の同一基板を用意しておいた方がよかった。FM 機搭載基板と全く同じ基板が試験用に存在しなかったため、環境が異なっていたことにより、打ち上げ前に発見できなかったバグが存在した。特に周波数設定に関しては、EM では西無線のテストボードを使用していたため FM 機体の試験環境とは大きく異なっていた。

3.4.2 OBC

(1) 概要および設計思想 (林)

- OBC は地上局から送信したコマンドを指定された時間に本衛星の各コンポーネントに送る（実行する）役割と、HK の生成などを行っている。OBC のプログラムでは、リアルタイム OS を用いており、様々なタスクを切り替えて処理を行うようになっている。

(2) OBC の内部処理

OBC 内部処理の全体像 (林)

- OBC の内部処理では、衛星放出後のテグスの溶断確認などを行う初期運用、HK データ生成、地上局からアップリンクしたコマンドの実行に関わるコマンド受信を行っている。
- OBC の内部処理では、HK データを地上局から
- コマンド受信と HK 受信などの詳細は書かずに全体像のみをここではじめに書く

初期運用 (小出)

衛星が放出後、地上局との通信のためにアンテナを出すために、アンテナを固定しているテグスを溶断する。OBC 起動時にはこのタスクのみが動いており、初期運用の終了を認識すると、そのほかのタスクが解放される流れになっている。詳細は、初期運用の項を参考にする。

HK 生成 (小出)

衛星内における各モジュールの電圧、電流、温度、加速度等を計測して衛星内の状態を取得して保存することを行っている。CW, FMHK データのフォーマットは、OP-S1-0109_CW ダウンリンク通信フォーマットと OP-S1-0108_FM ダウンリンク通信フォーマットを参照とする。

- HK データの中に SAP の太陽光発電量があるが、うまく計測できなかつたため電流値の測定を加えた。後に、発電量計測に必要な部分の配線がしていない設計だったためハード的に測定が不可能だった
- SAP の電流値は、Z 面の測定がうまくいっていない。認識していたコネクタとは別の部分のコネクタ部分につながっているためである。

- SAP の太陽光パネル電流値の配置が離れているが、バッテリーとの I2C 通信が故障のために不通になりその部分に後から電流値を入れたためである。

コマンド受信 (林)

コマンド受信では、地上局からアップリンクされたコマンドの内容を指定された時間に各コンポーネントに送信することを行っている。地上局からアップリンクされたコマンドは CIB によって EEPROM の所定の場所 (以下、アップリンクコマンド保存アドレス) に保存されている。OBC はアップリンクコマンド保存アドレスから、RAM であるタイムテーブルにコマンド実行時間とコマンドの保存アドレスを記録し、コマンドの実行を管理している。

1. アップリンクコマンドのタイムテーブルへの書き込み

OBC は 30 秒おきにアップリンクコマンド保存アドレスにアクセスし、新しいアップリンクコマンドがないかを確認している。確認方法はアップリンクコマンド保存アドレスに保存されたアップリンクコマンド各々の CRCcheck と呼ばれる部分を確認することである。CRCcheck には、コマンドがどのようなステータスを持っているかをビットで表現しており、表 3.5 のようになっている。7bit 目の CRC のチェックが ok, 3bit 目のタイムテーブル格納が no, 0bit 目の消去済みコマンドが no であればタイムテーブルに加えるという仕様になっている。タイムテーブルに載せられる情報は、タスクステータ、コマンド保存アドレス、コマンド実行時間である。タスクステータスには、コマンド未格納、コマンド格納済、コマンド未実行、コマンド実行済がある。タスクステータスがコマンド未格納かコマンド実行済であるタスクテーブルにコマンドを追加する仕様になっている。また、コマンドが加えられたタスクテーブルのタスクステータスにはコマンド格納済のステータスが入れられる。

表 3.5: CRCcheck の内容

bit 番号	内容	判定
7	GS-RXC OBC uplink CRCcheck	0: error 1:ok
6	RXC OBC-TXCOBC UART CRCcheck	0: error 1:ok
5	mainEEPROM-TXCOBC I2C CRCcheck	0: error 1:ok
4	subEEPROM-TXCOBC I2C CRCcheck	0: error 1:ok
3	task added to commandtable	0: no 1: yes
2	task started	0: no 1: yes
1	task finished	0: no 1: yes
0	task discarded	0: no 1: yes

2. コマンド実行

タスクテーブルに加えられたコマンドが指定された時間にコマンドが実行されるよう、コマンド実行では 1 秒おきにタスクテーブル内すべてのコマンドの実行時間（タスクタイミング）を確認している。まず、実行時間を確認する前に、タスクテーブル内コマンドのタスクステータスの確認を行う。タスクステータスが、コマンド未格納、コマンド実行済でなくて、コマンド格納済であれば、そのコマンドのタスクタイミングと現時刻を比較し、現時刻がタスクタイミングより進んでおり、1 分いないであればコマンド実行に移る。

タスクタイミングの条件を満たしたものはまず最初に CRC の確認を行う。そのコマンドのアップリンクコマンドアドレスにアクセスし、CRC の確認をして問題がなければ、二重コマンドの確認を行う。(二重コマンドの説明は後で述べる。) CRC に問題があれば、OBC の再起動を行いアップリンクコマンド保存アドレスの CRCcheck の 0bit 目の消去済みコマンドを yes にし、タスクテーブル全部のタスクステータスをコマンド未格納にする。二重コマンドでなければ、各コンポーネントに送信するときの構造体にコマンドの内容を入れ、そのコマンドのタスクステータスをコマンド実行済にする。そのあとは、アップリンクコマンド内のタスクターゲットを確認し、指定されたコンポーネントにコマンドのパラメータを送信している。また、コマンドを実行する際は、HK 生成タスクを一時停止させ、コマンド実行では、タスクテーブルに加えられたコマンドが実行時間になったら、コマンドを実行するコンポーネントに送信する。

送信した後は、コマンドを実行した結果が返り値として帰ってくるようになっている。正常にコマンドが実行されれば返り値が 0、ミッションに深刻な影響を与えない異常が出た場合は返り値が正の値、ミッションに深刻な影響を与える異常が出た場合は返り値が負の値になっている。返り値が負の値であった場合、OBC の再起動を行いアップリンクコマンド保存アドレスの CRCcheck の 0bit 目の消去済みコマンドを yes にし、タスクテーブル全部のタスクステータスをコマンド未格納にする。また、実行したコマンドのコマンド識別 ID とコマンドを実行したとき返り値は EEPROM の所定のアドレスに保存され、履歴として残される。最後に実行したコマンドのコマンド識別 ID とコマンド返り値の情報があるアドレスもまた、EEPROM の所定のアドレスに保存される。

※二重コマンドについて

二重コマンドとは、実行されてしまうと衛星に重大な問題を引き起こすコマンドを、ヒューマンエラーにより誤ってアップリンクされても実行されないための仕組みである。

二重コマンドを実行するためには、2 回アップリンクを行う必要がある。最初にアップリンクするのは EEPROM の所定のアドレスにある二重コマンド格納アドレスである。次にアップリンクするのは、アップリンク保存アドレスである。2 回目にアップリンクしたコマンドは通常のコマンドと同様にタスクテーブルに入れられ、コマンド実行時間になったら、実行する手順に入る。また、二つのコマンドは、コマンド内容は全く同じにする必要がある。上でも述べたように、二重コマンドか否かを判断するのは CRC の確認を行った後である。コマンドのタスクターゲットが OBC の時に、二重コマンド確認に入る。この時、二重コマンド格納アドレスのアップリンクコマンドの CRC を確認して問題がなければ、実行手順に入っているコマンドと二重コマンド格納アドレスのコマンド内容を比較し、まったく同じであれば、アップリンクコマンドのコマンド内容の各 byte をそれぞれ 2byte ずらして新たにコマンドを生成する。その手順を経て、タスクターゲットが地上局から生成できない二重コマンド用のものに切り替わり、二重コマンドを実行することができるようになっている。

(3) 開発中における不具合およびトラブル (小出・林)

- SD カードのマウントの変更が OBC の起動中に行えると考えていたが、起動時にしかマウントの変更ができないことが発覚。GOMSPACE にも問い合わせたが、物理的に

は可能だが、推奨していないと言われた。

(4) 次回への改善点 (小出・林)

- 全体的にプログラムの開発が遅かった。バス部なので本番でもきちんと動くものを早い段階で完成させておくべきだった。コマンド実行のプロセスも早いうちに完成させておくべきだったと思う。

3.4.3 初期運用

(1) 初期運用概要 (黒崎)

初期運用では、放出直後に地上との通信を行うため、アンテナの展開を試みるフェーズである。アンテナを収納する際に巻かれたテグスを溶断することでアンテナの展開を行う。以下に初期運用の簡単な流れを示す。

- 1 OBC または COBC が溶断する
- 2 溶断が完了しアンテナが展開し、CW HK ダウンリンクが開始する
- 3 CW HK ダウンリンクが地上局で確認されたら、溶断停止コマンドを東工大地上局からアップリンクを行う
- 4 衛星が溶断停止コマンドを受信したら、溶断を停止し、初期運用モードから定常運用モードに移行する
- 5 CW HK ダウンリンクの溶断ステータスが溶断前から溶断済みに更新されていることを確認することで、衛星が定常運用モードに移行したことを地上局が認識する

(2) 基本設計思想 (黒崎・小出)

- OBC がメインで溶断を行う。OBC が溶断に失敗している場合に CIB が溶断を行う。本来であれば、Saving モードで OBC の電源が切られてしまうため、CIB がメインで溶断を行う方がシンプルな設計に出来た。しかし、CIB は初期運用以外の開発がかなり遅れていたため、初期運用のデバックに割ける時間が限られていること、また CIB に機能の集中を避けること、溶断の電源の供給の 1 つが OBC しか出来ないことなどを考慮し、OBC をメインにしたという背景がある。
- 溶断頻度は 22.5 分間隔。これは地球 1 周を 90 分かける OrigamiSat-1 の軌道において、地球 1 周の間に 4 回溶断をトライする設計になっている。地球 1 周分を基準に考えているのは、日向、日陰条件で宇宙環境温度が異なり、溶断の成功確率に影響が出ることを考慮している。
- 1 日の間で 8 回（地球 2 周分）溶断をトライした後は、溶断を行わず待機。これはバッテリーを温存するためである。

(3) 開発の流れ (黒崎)

開発の流れは以下の通りである。

- 3-A 不具合想定表作成
- 3-B ソフトフローチャート作成
- 3-C ソフト作成
- 3-D デバック
- 3-E フローチャートとソフトが対応しているか確認
- 3-F OBC/CIB 統合
- 3-G 恒温槽試験で溶断時間の確認
- 3-H FM 最終確認

各工程の詳細を以下に示す。

3-A 不具合想定表作成：不具合想定表は、「A）不具合原因表」と「B）不具合対応表」からなる。

A) 不具合原因表は、電源系、通信系、その他の 3 種類に分けて作成した。実際に作成した表を表 3.6、表 3.7、表 3.8 に示す。表 3.6 に関しては、機器のトラブルによる再起動/電源オフだけでなく、モード切替による意図的な再起動/電源オフも想定している。

B) 不具合対応表は、各シーケンスにおいて、表 3.6、表 3.7、表 3.8 で想定された不具合が発生した場合の、1. 対処法（どのように冗長系を組むか）、2. デバックの際の検証方法を示している。OBC、RXPIC、TXPIC それぞれにおいて対応表を作成した。実際に作成した表を表 3.9、表 3.10、表 3.11 に示す。

項目	再起動	可能性 (1:低～5:高)
1	OBCのみ再起動	3
2	OBCオフ	1
3	EPS再起動(OBC再起動、西無線再起動)	1
4	EPSオフ(OBCオフ、西無線オフ)	1
5	RX再起動	1
6	TX再起動	1
7	西無線再起動	2
8	西無線オフ	1
9	EPSオフ(OBCオフ、西無線オン)	3

表 3.6: 不具合原因表（電源系）

項目	通信系	可能性 (1:低～5:高)
A	OBC→EPS I2Cerror	2
B	OBC→EEPROM I2Cerror	4
C	OBC→TX UARTerror	2
D	RX→TX UARTerror	2
E	TX→EEPROM I2Cerror	2
F	RX→EEPROM I2Cerror	2
G	西無線→RXPIC	1
H	西無線→TXPIC	1

表 3.7: 不具合原因表（通信系）

項目	その他不具合	可能性 (1:低～5:高)
あ	ioピン不良	3
い	TXのWDT	1
う	RXのWDT	1
え	ビット反転	2
お	EPS 溶断SW	2
か	TX 溶断SW	2
き	マルチプレクサ	3
く	マルチプレクサhigh状態	1
け	西無線 CW TX	2
こ	西無線 FM TX	2
さ	西無線 FM RX	2
し	OBC 故障	2
す	バッテリー電圧測定用ADCの故障	2

表 3.8: 不具合原因表（その他）

該当シーケンス	エラー項目	該当エラー	それに対する例外処理	検証方法
OBC起動しない	さ	OBC 故障	CIBが溶断シーケンス どちらも溶断が始まってしまう可能性あり →時間差でうまく調整する? →EEPROMに溶断中かどうか書き込む? ありだと思う。溶断ステータスを未溶断、溶断中、溶断済みでわかるのはいいと思う。井手	
IO.PIN_50セット	あ	ioピン不良 OBC出力の不良は経験ない CIB側の入力の不良が心配 井手	エラーが起きたらEPSキルをRXに送信? →出来ないったらそのままでもいい?一応スイッチのリミットタイマーを打ち上げ前につけておく(30秒) リミットタイマーは初期運用後に停止できるよね? 毎回30秒で止まつてしまわないか心配。岩崎	保留
EPSスイッチ全オフ	A	OBC→EPS I2Cerror	リミットタイマー開数デバック済みのため、特にに行わない リミットタイマーはSW10のみの実装予定	
溶断ステータス読み込み (溶断前に必ず読み込み)	B	OBC→EEPROMI2Cerror	SPIに溶断ステータス書き込み さくじゅうせん→RXに書き込み→シード→無限ループに入る可能性 F2Hセレクトコマンドをやめたとしてどうするか? →読み込みが遅い限りCIB溶断にはならない どちらも失敗する可能性を考慮する必要あり →一度失敗したら終わる処理ではなく、ループで何度もUARTを送る処理になってなかつたつけ? 井手	I2Cエラーがでたと想定してiopinを切ってタスクを停止 →CIBが溶断シーケンスに入れるかを確認する
通常溶断SW	A	OBC→EPS I2Cerror	エラーが起きたら通常溶断終了、冗長溶断へ →通常ができないれば冗長予定だがUART割り込みも失敗したらどうするのか? →ioピンをきらない限りCIB溶断にはならない どちらも失敗する可能性を考慮する必要あり →一度失敗したら終わる処理ではなく、ループで何度もUARTを送る処理になってなかつたつけ? 井手	I2Cエラーが出てそのままプログラムが流れるので特に検証を行わない
通常溶断SW	お	EPS 溶断SW	通常溶断不可→冗長溶断へ	I2Cエラーが出てそのままプログラムが流れるので特に検証を行わない
OBCが通常溶断中	1	OBCのみ再起動	OBGのイニシャライズでEPS全スイッチオフ EPSがOBCの起動確認でEPSオフ →スイッチのままのタスクへける(30秒) →CIB側の操作されるのが確定で回数で変わるのが溶断時間だけなら →OBCがオフになると可能性が低いため考慮しない	溶断中にOBCを再起動させEPSの溶断SWをオフに出来るかを確認
OBCが通常溶断中	2	OBCオフ		溶断中にOBCを再起動させEPSの溶断SWをオフに出来るかを確認 特に対策はしないことにやった
アップリンク待ち	1	OBCのみ再起動	何回溶断したかをEEPROMに保存、再起動その値を読んで再開	OBCを途中で再起動させ再度読み込みを行うかを検証
溶断回数読み込み	B	OBC→EEPROMI2Cerror	エラーが出るのからスタートして通常溶断になれる →溶断ステータスと同様にタスク停止でCIBに頼む? ・溶断するのが確定で回数で変わるのが溶断時間だけなら →OBCで溶断してもいい気がする 岩崎	溶断回数読み込み時にエラーを起こして0から始まるかを確認する
OBC冗長系コマンド送信中	1	OBCのみ再起動	TXがコマンド破棄 CRCではじけるはず	あえて途中で途切れたUARTを送信後OBCを再起動
OBC冗長系コマンド送信中	さ	マルチブレクサ	冗長系溶断使用できない通常溶断へ	
OBC冗長系コマンド送信中	C	OBC→TX UARTerror	今のでuartの関数って返り値ないから成功の判断をどうするかが問題だね 岩崎 IO.PINのHigh, Lowの組み合わせでチェックできない? 井手	

表 3.9: 不具合対応表 (OBC)

該当シーケンス	エラー項目	該当エラー	それに対する例外処理	検証方法
アップリンク待ち	3 EPS再起動 (OBC再起動、西無線再起動)	西無線の周波数設定をタイマー割り込みで定期的に行う。周波数設定の頻度が未定。	西無線周波数設定をタイマー割り込みの中で定期的にputCmndで周波数設定を行っていることを確認。※1	
アップリンク待ち	4 EPSオフ (OBCオフ、西無線オフ)	•原因: 周波数設定を行った場合は、溶断しないが問題ない。電源が落ちたら、CIBがモード切替なし、EPSオフとなる。 •原因: 明確なオフ→西無線がCIB切り替えにならない。TXCOBCがEPSオフに気付かず、RXPICがEPSをリセットする。どうやつてTXがRXに指示しよう。	①パネル→saving サブパワーに切り替わる ②TXPICがEPSViausを定期的に監視。mainの中では、電圧異常でEPSリセットコマンドがTXからRXに送られる。RXがEPSをリセット。それでどちらもsub power供給にする。 RXPICはリセットする前に、OBC取得の電圧値を確認する必要あるか? ダブルチェックが必要か要検討。※2	
アップリンク待ち	7 西無線再起動	周波数設定必要。RXPICがタイマー割り込みで定期的に行なう。	※1と同様	
アップリンク待ち	8 西無線オフ	•原因: エラー→電源供給の切り替え •EPSが生きている。EPSをリセットさせて、周波数設定を行って生き返らせる。? 初期運用中は、EPS定期リセットの頻度を上げることで、解法? 定期リセットのタイミングで、エラーと勘違いしないか注意。 •西無線がついているか、消えているかはRXPICはつかない。TXPICで判断。どうやつてTXからRXに指示するか。	①定期的な周波数設定(※1と同様) ②EPSリセット頻度を通常週1回、初期は1日1回※3 ③※2と同様	
アップリンク待ち	9 西無線 FM RX	西無線再起動。EPSの定期リセットで解決。	※1と同様	
アップリンク受信中	10 RXWDT	WDTとは別にカウンターを用意し、立ち往生し続けたらいbreak処理。	要検討	
OBCの生死チェック中	1 OBCのみ再起動			
OBCの生死チェック中	2 OBCオフ	OBCとCIBが同時に溶断してしまうとバッテリーがリセットしてしまうかもしれないので要注意	②delay追加 ③WDTとdelayの中でたたく OBCが長時間delayをしてしまうので、ここでdelayを抑える必要はぐくみつけ	
	3 EPS再起動、 (OBC再起動、西無線再起動)	delay中にWDTがようすにすればいいんじゃないでしょうか?(大本)		
	4 EPSオフ(OBCオフ、西無線オフ)	•読み込み途中に止まる。WDTがRXPICがリセット。main->subが続かないまま永遠にリセットを繰り返す。WDTが壊れていたら永遠に止まってしまう。 WDTはタイマー割り込みなので、リセットは起きない。止まつてしまいます。 •読み込み途中に止まる。初期運用のI2cリードだけ、一定時間読み込めなかったら、0x00をreturnするほうがいいのです? 読み込み途中に止まる。I2c部分はUARTと同じように全部タイミングで時間ぎだつたら抜けた方がいいと思う(大本) •ピット反转とかで誤った値を読みだす閾値の値をうまく調整。main->subのEEPROMでダブルチェック。	①存在しない slave address or high/low address:read→0x00がくる→mainで0x00が来てしまった。subepromを読みに行こうにすると。 ②read/writeの型数のI2CMasterWaitの中でdelayを何度も繰り返した。WDTのパルスを打ち続けるためセッティングが起きない。 ③I2CはUARTと違う。待機しているわけではないから、止まることはない。by 井手。→タイマー処理はとりあえず保留※4	
溶断ステータス読み込み	F	RX→EEPROM I2Cerror	止まつてしまふ。WDTも死んだら、定期的なEPSリセットを待つ。	※3と同様
溶断ステータス読み込み	9	RXのWDT		
電圧測定	半	バッテリー電圧測定用ADCの値	•読み込み途中に止まる。初期運用の「データ」書き込みで止まらないまま永遠に止まってしまう。 •読み込み途中に止まる。データの書き込みではなく、読み込みで止まらない。バッテリー電圧測定の記録は、データtrapのタイミング割り込み(モード切替)で行なう。	
電圧測定	F	RX→EEPROM I2Cerror	①mainの3タイマー以外の変な衛星動作モードを読みだら、subを読みに行く。それでもだめなら、エラーだす ②読み込み途中に止まる。WDTがRXPICをリセット。 ③subのEEPROMが読めないと永遠にリセットを繰り返す。WDTが壊れていたら永遠に止まつてしまうので、I2Cにタイマー追加。読み込み途中に止まる。初期運用のI2cリードだけ、一定時間読み込めなかったら、0x00をreturnするほうがいいのです? 溶断ステータス読み込みと同一意見です(大本) ④カウンターが72以上の場合は、subを読みに行く。それでもだめなら、0x00に戻す	電圧測定は中止→衛星動作モードを読んでEPSがついているかついていないかを判断
衛星動作モードを読み込み	F	RX→EEPROM I2Cerror	①変な衛星モードをepromに保存 ②途中でdelayを入れる ③※3と同様 ④大きいカウンターの数字を入れる	
溶断カウンター読み込み	F	RX→EEPROM I2Cerror	•200待機中もWDTにパルスを送り続ける必要あり。 •タイマー割り込みで割り込んでくれればいいが、割り込んでくれない場合は、ここの200秒待機の中でもパルスを途中で送る必要があります。 •WDTが壊れた時の対処法未定	•存在しない slave address or high/low address:read→0x00がくる→mainで0x00が来てしまった。subepromを読みに行くようにする。
200s待機	う	RXのWDT	コマンドを送れない。RXPICは送っていないことを気づくべし。TXPICルート2論議。 OBCの通常溶断と冗長溶断に期待付かず。	•delay時間中にもパルスを送っており、リセットがかかるないことを確認済み。
RXPICからTXPICへコマンド送信中	D	RX→TX UARTerror	TXPICからRXPICにコマンドを送ったら、RXPICがちゃんと受け取ったよ。と返事するまで、複数回送る? 要検討	
溶断ステータス書き換え	F	RX→EEPROM I2Cerror	WDTとは別にカウンターを用意し、立ち往生し続けたらいbreak処理。	※4ほぼ同様。readバージョン

表 3.10: 不具合対応表 (RXPIC)

該当シーケンス	エラー項目	該当エラー	それに対する例外処理	検証方法
CWダウンリンク	け	西無線 CW TX	周波数設定?	RXPIC※①と同様
OBCからの割り込み				
OBCからのコマンド	C (1,2,3,4,6)	OBC→TX UARTerror	基本、次のトライに期待。 •1byte来ない、割り込み後、中でコマンド受信を待機し続ける→TXのmain文のWDTがリセットを受けた。 •1byte受け取ったが、ノイズが乗りおかしい •Cから誤ったメッセージが送られてくる •switch文のdefaultに入る	※6 •0t/g以外の文字で割り込みを発生させ模擬的に停止。②1文字目は/であったが後半途中で停止。③バッテリーFT232xPCから割り込み、WDTリセットがかかるかチェック。 →ちゃんとリセットかかる。確認終了。 •他の数字を教えて必要なものにする •存在しないコマンドを送信
OBCからのコマンド	い	TXのWDT	•WDTの電源がonになっていて、立ち往生時 にリセットがかかるない→WDT POWER HIGHを定期的に行う。 •WDTの電源はonだが、パルスpin不規によ りリセットがかかるり続ける	井手さんのnew割り込み閑数で、立ち往生時 は、すぐbreakできる※5
OBCからのコマンド	え	ピット反転	CRCチェックではじかれるとOBC通常溶断のみ	CRC機能チェック
OBCからのコマンド	き	マルチブレクサ	•OBCが生きていって、OBCからTXPICへのコ マンドが、通らなかった場合、通常溶断のみ になってしまひど、大丈夫? (要検討)	OBCは意図的に、RXPICのioピンを切るん だけ? →i2cエラーが出たら、CIBの冗長ルート溶 断を意図的に行うために、ioピンを切る。
OBCからのコマンド	4	EPSオフ(OBCオフ、西無線オフ)	EPSが切れていたら、溶断の電源が入らない →諦める? 1日1回のEPSリセットで復活を 期待	①EPSの生死判断、RXPIC※2と同様 ②EPS定期リセット、RXPIC※3と同様
溶断中	か	TX 溶断SW	1日1回のEPSリセットで復活することを期待	RXPIC※3と同様
溶断中	6	TX再起動	TXが落ちれば溶断PINもlowになる? (要確 認)次のトライに期待※6	ピンをhighにした状態で、電源を切り、溶断ビ ンがlowになら、確認。 →CIBリセットかあるとTX冗長溶断用の溶 断ピンはlowになった。TXPICが再起動してし まつも、HIGHにかわばなしにはならない から大丈夫。
RXからの割り込み				
RXからのコマンド1byte受信	い	TXのWDT	上と同様	※5と同様
RXからのコマンド1byte受信	D	RX→TX UARTerror	上と同様	※6と同様
RXからのコマンド1byte受信	6	TX再起動	コマンド破棄される。残りのbyteも1byteチェック ではひかれ。	コマンド送信中に再起動。はじかれた。確認 済み。
RXからのコマンド1byte受信	5	RX再起動	10byte送れず、割り込み閑数内で立ち往生す るが、WDTでリセットかかしループ抜け出 す	抜け出した。確認すみ。
溶断ステータス読み込み	6	TX再起動	次のトライに期待	-----
溶断ステータス読み込み	E	TX→EEPROM I2Cerror	•Main eepromエラーでI2Cが帰ってきた場 合は、sub eepromを読みに行く、立ち往生し たWDTでリセット。次のトライに期待	RXPICと同じ。プログラム更新まだ。
溶断ステータス読み込み	い	TXのWDT	上と同様	RXPIC※4と同じ。
溶断中	か	TX 溶断SW	上と同様	RXPIC※3と同じ
溶断中	6	TX再起動	※6と同じ	※6と同じ
ダウンリンク				
データダウンリンク開始	7	西無線再起動	RXが周波数設定を定期的に行っている EPS/SVBUSの電圧を常に監視。EPS offと判断 したら、西無線pinをpowerに切り替え、周波 数設定を再実行し、CWダウンリンク再開	RXPIC※1と同じ
データダウンリンク開始	8	西無線オフ	-----	RXPIC※2と同じ
データダウンリンク開始	6	TX再起動	問題なし	-----
データダウンリンク開始	け	西無線 CW TX	EPSリセット、RXPIC周波数設定を定期的 に行っているので、復活を待つ。	-----
データダウンリンク開始	こ	西無線 FM TX	EPSリセット、RXPIC周波数設定を定期的 に行っているので、復活を待つ。	-----
データダウンリンク開始	さ	西無線 FM RX	EPSリセット、RXPIC周波数設定を定期的 に行っているので、復活を待つ。	RXPIC※1と同じ

表 3.11: 不具合対応表 (TXPIC)

3-B ソフトフローチャート作成: 3-A で作成した不具合想定表を元に、初期運用時の OBC, TXPIC, RXPIC のフローチャートを作成した。作成したフローチャートは、他のコンポーネント担当者等とも検討した。

3-C ソフト作成: 3-B で作成されたフローチャートを元に、ソフトを書いた。

3-D デバック : 3-C と同時並行で書いたソフトをその都度デバックする。いつ、どの部分をデバックし、結果はどうであったかを必ず記録する。後に確認した際にどの部分までデバックしたか分からなくなってしまうため。

3-E フローチャートとソフトが対応しているか確認

3-F OBC/CIB 統合. 初期運用は OBC と CIB が連携して行うため、統合作業が必要である。冗長系を含むフローチャートの全てのルートにおいてバグが無いかを、単体では 3-D で確認済みだが、OBC と CIB のプログラムを同時に動かして確認した。

3-G 恒温槽試験で溶断時間の確認: 恒温槽において、宇宙環境の想定最大温度 50 °C と想定

最低温度-30 °C を再現し、それぞれの温度環境下で溶断することができるか、溶断時間は適切であるか検証した。

3-H FM 最終確認: FM 本体を JAXA に引き渡す直前、最終プログラム書き込み後、eprom 初期パラメータ書き込み前に、初期運用プログラムで溶断できるか確認を行った。FM 本体を溶断することはできないので、ダミーの糸を溶断した。

(4) OBC 正常時初期運用モードソフト詳細（小出）

OBC 正常時のフローチャートを以下に示す。

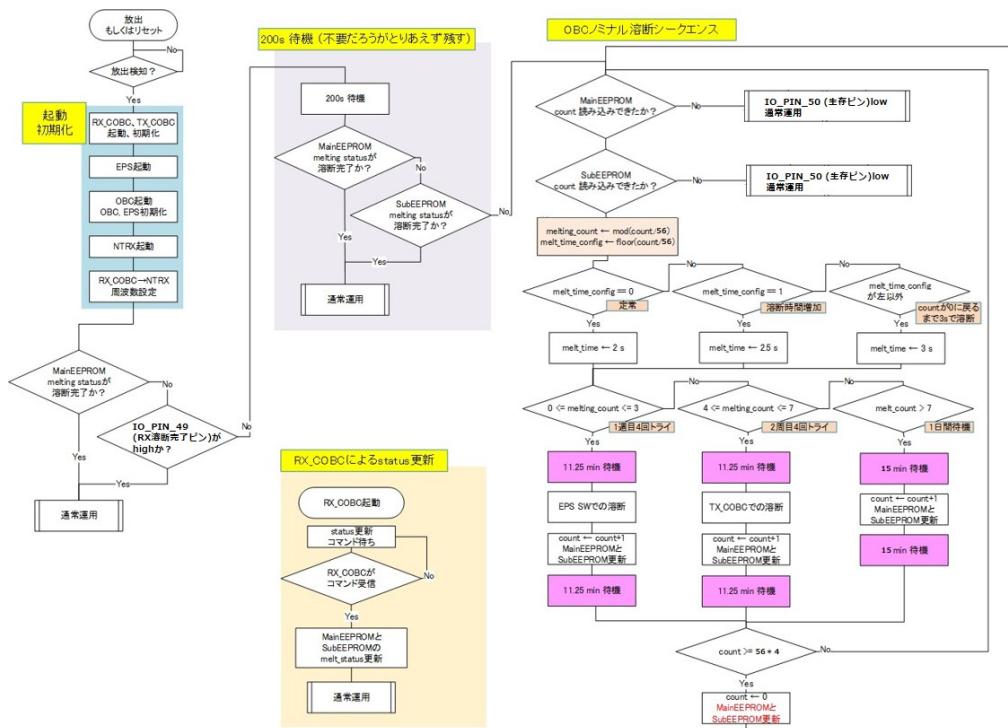


図 3.26: OBC 正常時のフローチャート

- OBC は RTOS を使い複数のタスクを持っているが起動時に動くのは初期運用のタスクのみである。OBC は起動後必ず OBC 生存ピンである 50 番の IO ピンを high にする。
- EEPROM に書き込まれた溶断ステータスの計算式については 1byte を 1bit ずつ加算その値が 4 以上だと溶断判断。これは放射線などの影響で bit 反転の可能性を防ぐためである。
- count で溶断回数又は待機を判断しているが、これは待機中に OBC の電源を落ちることを考慮し、定期的に EEPROM に書き込みを行う。
- OBC は EPS の WDT を管理しているので、初期運用時では初期運用のタスク内のループで叩きに行く構造(通常は OBC のコマンド確認で行っている詳細は OBC の章)

(5) OBC 異常時初期運用モードソフト詳細（黒崎）

OBC 異常時のフローチャートを図 3.27 に示す。

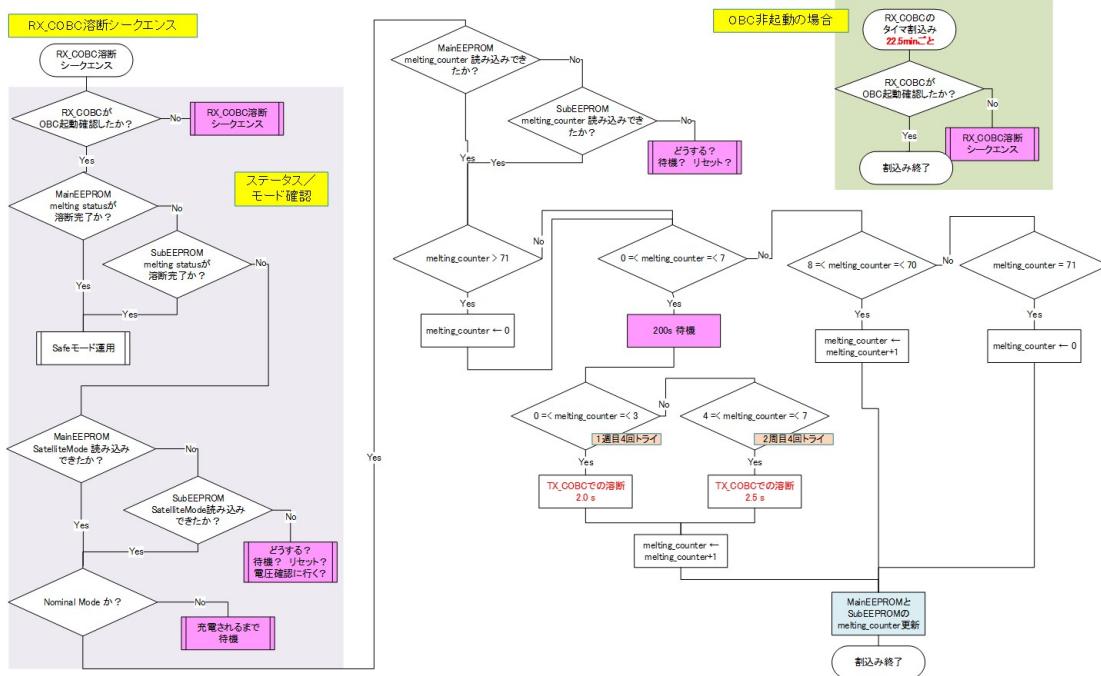


図 3.27: OBC 異常時のフローチャート

- RXPIC で 22.5 分毎に行われるタイマー割込み処理内で、OBC の起動が確認できない場合、RXPIC での溶断シーケンスに入る。
- 溶断ステータス及び衛星モードを確認し、未溶断かつ Nominal モードの時に溶断処理に入る。
- EEPROM の溶断カウンターの値を読み込み、値に応じて溶断を行った後、溶断カウンターを更新する。

(6) 初期運用 運用結果（黒崎）

アマチュア無線家からの CW HK データ受信報告を受け、東工大地上局にて溶断停止コマンドをアップリンク。CW HK データで溶断ステータスが溶断前から溶断済みに書き換わっていることを確認した。

(7) コメントや次回の改善点

OBC / CIB 共通（黒崎・小出）

- 溶断済みフラグを CW HK データのフリースペースの 1byte に入れたのは神采配だったと思う。OrigamiSat-1 の場合、アップリンクで EEPROM の指定アドレスを読んでダウンリンクする機能が使えなくなってしまっていたため、CW HK データ以外に溶断済みを確認する術が無かった。
- OBC と CIB が同時に溶断を行ってしまった場合、バッテリーがどの程度減少するかの検証をできていなかった。
- OBC と CIB のどちらが、何回目の溶断で溶断を成功し、ダウンリンクを開始したかを分かるようにした方がいいのかもしれない。

- 「(3) 開発の流れ」3-FにおけるOBC/CIBの統合は、初期運用のプログラムしか動かしていなかったので、モード切替やダウンリンクなども動かし、本番の運用を想定したデバックが必要であった。
- 溶断系統としてEPSのSWでの溶断、冗長系としてTXPICによる溶断があったが、EPSのSWにおける溶断はOBCのみしか使用できぬ仕組みになっていた。どちらでも溶断できるように

OBC（小出）

- 初期運用を必ず成功させるために複雑なシークエンスにしてしまったが、もう少し簡潔なシークエンスのほうがよかつたと思う。溶断時間の変化をなくして、プログラムを優しくする方法も考えられる。

CIB（黒崎）

- FMに書き込んだプログラムでは、溶断ステータスは毎回、EEPROMを読み込んで判断していたが、一度、溶断停止コマンドがアップリンクされて溶断ステータスが書き換わったら、PIC内のグローバル変数も書き換わるようなプログラムの方が良かったかもしれない。

というのも、RXPICがEEPROMの読み込みができず、溶断ステータスを判断できない場合は全て「未溶断」判定にしていた。実際、OrigamiSat-1はEEPROMを読み込めないといい事象が起きてしまい、RXPICは毎回、初期運用モードに入り、200秒待機や溶断などをしてしまっていたと思われるため。

3.5 姿勢制御系（恒光・中西）

3.6 構体系（奥山・大野）重量管理も含む

本稿では、私が携わったEMの設計の修正からFMの組立までについて、各開発フェーズごとに記載する。なお、詳細な不具合は「OP-S1-0065_OrigamiSat-1不具合・A/I管理表_20190124」に記載している。また、設計についてEMからFMで修正する際の修正項目(EMでの不具合項目)は「FM発注リスト.xlsx」に記載している。

3.6.1 3DCAD設計

3DCAD設計でミスが起こると開発が進んだときの出戻りが大きいので気をつける。

(1) 干渉の確認

構体の部品同士の干渉を確認する必要がある。ここで注意したいことが、加工公差である。CAD上では公差は指定していないため、公差を含めて干渉がないかを考慮する必要がある。EMでは、展開アンテナとそれを通す溝の幅が同じであったため、CAD上では干渉はないが、実際にはアンテナがはまって展開できなかった。(追加工で対応)

(2) ハーネス・コネクタ等の電子部品の考慮

CADでハーネス、コネクタを入れることをお勧めする。ハーネスがどこを通るか、通る場所には通れるだけの隙間があるか、コネクタは干渉しないかを確認する必要がある。また、ハーネスは曲率の限界があるので注意する。

(3) ハーネスの通り道に突起物を置かない

特に注意するのが、構造部品の角である。振動等でハーネスの皮膜が破れる恐れがあるため、Rをつける。また、さらに補強としてハーネスにガラスクロステープを巻いた。

(4) 組立を考慮した設計

組み立てについては、工具の大きさと、組み立てのしやすさを考慮する必要がある。工具の大きさについては、組み立て時に工具と部品に干渉なく組み立てられるかを注意する。底面パネルに対するパッチアンテナ土台の取り付けは、取り付けるねじに対して工具を同軸で取り付けるべきであるが、底面パネルと工具が干渉するので、工具を斜めにして取り付けていた。組み立てのしやすさについては、D-subの取り付け等無理な体勢での組み立てがあつたので、良くない。何度かワッシャを構体内に落としたこともあったので注意して欲しい。

(5) ばか穴による組み立てのズレの考慮

ばか穴にしている箇所は、ねじの径との差の範囲で部品間が相対的にずれる。0.1mmオーダーの差があり、レール精度は±0.1mmであるので、十分影響がある。要求精度以外にも、ディプロイメントスイッチの接触不良があった。スイッチの位置によってディプロイメントピンとの相対的位置関係が変わり、スイッチ起動の要求、インターフェイスを満たせない場合があった。今回はスイッチ取り付け後のピンを取り付ける際に位置を調整することで対処した。

3.6.2 図面作成

図面作成は寸法を全て書き込めば良いだけでなく、加工する際に必要な寸法を書くことが重要である。自ら加工することも少なくなかったので、そのような経験があるとよりうまく書けると思う。

(1) 加工順序の考慮

自分で加工するとき、前日までに加工順序を確認しておくことをお勧めする。当日朝から工場に行ってから工程を考えると進捗が得られない。

(2) 加工者との早めの相談

公差等わからないことがあつたら専門家に聞くほうが良い。考えるより細かい部分は話しながら決めたほうが早く進む。

3.6.3 発注

発注は相手に誤解されないように伝えることが重要である。

(1) 業者と工場の違い

基本的には工場の発注が良い。工場のメリットは大学内に併設しているので直接コンタクトがとりやすい。外部業者であるとメールのみのやり取りで伝えきれないことがあったりする。外部業者は、工場が立て込んでいて納期が遅かったり、休業のときに利用する。工場は大学内の様々な案件を行っているので、時期によっては納期がだいぶ先になる。また、外部業者で工場が海外であると日本と休日が異なるため、助かることがある。(特にGW)

3.6.4 組み立て

(1) 手順の決め方

基本的には底面パネルから膜展開部に向かって組み立てる。それに加え、左記の流れであると組めない部分は順序を適宜変えた。また、レール精度が求められている部品(底面パネル、側面パネル×4、膜展開部)に関してはトルクはかけずに仮締めを行い、その後精度出しを行った。最終的な手順は「組み立て手順書」に記載する。

(2) 手順書の作り方

誰でも組み立てができるることを目標とした。組み立て時に考えることはないようにする。また、ソフトを書く人にはバス系の組立ができるようにしてもらうことを薦める。ソフトを書き込むために分解が必要なときもあるので、そのたびに構体系の担当がいないと開発が進まない事態になったことが何度もあった。

(3) 精度出しの方法

精度出しの方法は「組み立て手順書」に記載している。

(4) 基板保持の治具

基板保持とCIBの取り付け誤差により、基板がずれて側面パネルが固定できないことが何度かあった。それにより、基板保持とCIBの相対位置を固定する治具を作成した。

(5) 基板の組み立て誤差

上記の対応で精度は良くなつたが、その先の基板を取り付けた際に再現性がなく、側面パネルと干渉することがあった。この原因はわかっていない。

(6) サーミスタの貼付方法

サーミスタを貼り付ける際は貼り付ける部品にカプトンテープを貼り、その上にサーミスタを置き、上からカプトンテープを貼る。このとき、どちらのカプトンテープも多数の穴を開けた。これは、真空中でカプトンと部品との間の気泡が膨張し、カプトンがはがれることを防ぐためである。

(7) 配線

ハーネスの経路は、構体部品との干渉を避けることとハーネスの可動域を考慮してどのように動いても部品間でハーネスをはさまないよう取り回すことを考慮する。後者についてはFMの1回目の振動試験でハーネスを構体部品ではさんでしまっていたので、はさんでしまったハーネスを別のハーネスをくぐらせて動いたとしても挟まれないようにした。

(8) ディプロイメントスイッチの不具合

ディプロイメントピンの公差の指定を誤り、底面パネルにピンが固着してしまった。対策としては、底面パネルの穴を削り、微調整した。また、ピンには二硫化モリブデン処理を施し、摩擦係数を減らした。

(9) 工具の管理

工具は作業が終わっていなくてもその日中には片付けることを徹底する。放置したり、他の人が使ったりした後、翌日に探すことが多々あった。構体系のみならず開発者全員の認識が必要である。

3.7 熱系（中村）

3.8 VHF/UHF 展開アンテナ（仁尾・坂本）

3.9 ミッション系

3.9.1 5.8GHz 通信ミッション（井手）

ここでは 5.84GHz 帯高速通信を担うモジュール（以下 5.8）について述べる。

(1) ミッション内容

衛星内部で膜展開前後の写真・動画を地上局に送る。モジュールは福岡にあるロジカルプロダクト社から購入しており、これは福岡工業大学の衛星プロジェクトで用いたものと同じである。

(2) ハードの概要

5.8にはMicrochip Technology社のPIC16F886(以下PIC)を用いており、写真保存用のフラッシュメモリ(以下FROM)はMicron Technology社のM25P32を用いている。ここに回路図の写真。

(3) ソフトの概要

PICのプログラムにはC言語を用いている。衛星にはブランチ名master-debugger, コミット番号51237d7e783d32032fe3db0332d3c69a6ab9e13eを書き込んだ。ソフトは1つのメイン文が繰り返し実行されるが、主に2つの部分に分かれている。1つはコマンドをOBCから受け取る部分、もう1つは受け取ったコマンドを実行する部分である。

まずコマンドの受け取り方法について記述する。コマンドはいつOBCから送られてくるかわからないため常に待機状態にあり、CRC16を用いたコマンドのチェックを通過したコマンドのみ実行する。OBCとの通信にはUARTを用いた。通信速度はモジュールの振動子から14400, 57600, 115200[bps]と設定できるが、デフォルトは115200に設定してある。OBCとの通信時には常に115200を用い、地上局との通信時には通信速度を変更することができる。

3.9.2 伸展カメラ

(1) システム開発(ウェル・坂本)

(2) 三次元計測（飯島・黒崎）

三次元計測システムの処理は大きく分けて以下のような3つの工程に分けられる。

工程 A. カメラキャリブレーション（処理 1, 処理 2）

工程 B. 測定対象の撮影（処理 3）

工程 C. 画像処理（処理 4～処理 8）

三次元計測システムのフローチャートを図 3.28 に示す。図 3.28 中では、黒色の四角マークが「処理」、青色のデータマークが「各処理によって作成されたデータ」を示している。

三次元計測システムは処理 1 から処理 9 までの計 9 処理で行われる。（工程 A）カメラのキャリブレーションが処理 1, 処理 2, （工程 B）撮影対象の撮影が処理 3, （工程 C）画像処理が処理 4 から処理 8 に対応している。

工程 A で作成されるデータ（レンズパラメータ、ステレオパラメータ）はカメラの設計値に依存する固有値である。すなわち、2 度目以降の測定では、工程 A は省略でき、工程 B（処理 3. 計測対象撮影）以降のみを行えばよい。ただし、カメラ位置や鏡筒長さを変更してしまった場合はもう一度、工程 A からやり直す必要がある。

三次元計測時に使用するアプリケーション

- (1) GaZooCapture：図 3.28 の「処理 1. チェッカーボード撮影」および「処理 3. 計測対象撮影」で使用する。ステレオカメラは 2 台同時に撮影する必要があるので、PC を 2 台用意し、各 PC にこのアプリケーションを入れておく必要がある。
- (2) MATLAB：図 3.28 の「処理 2. ステレオキャリブレーション」および「処理 4. レンズ歪み補正」以降の処理で使用。

GaZooCapture 使用時に関するコメント

- デバイスが認識されないトラブル多々あった。それは接続不良かカメラ自身の故障が原因。接続不良は接続部分がちゃんと接続されているか確認したり、一度外してもう一度繋げば解決する。カメラ自身の故障はケーブルに張力がかかることが原因。撮影試験の時は、カプトンテープでカメラ本体とケーブルを軽く固定し、ケーブルに張力がかかるないように気を付ける。
- 撮影前にはフォーマット（画像サイズ）と画像の保存形式が間違っていないか確認した方がいい。何度も設定をし忘れ、撮影試験をやり直した。
- クロスラインを表示することができるので必要に応じて適宜使う。クロスラインを使用することで、カメラの取り付けの際に、2 台のカメラの光軸がずれていないかを確かめることができる。

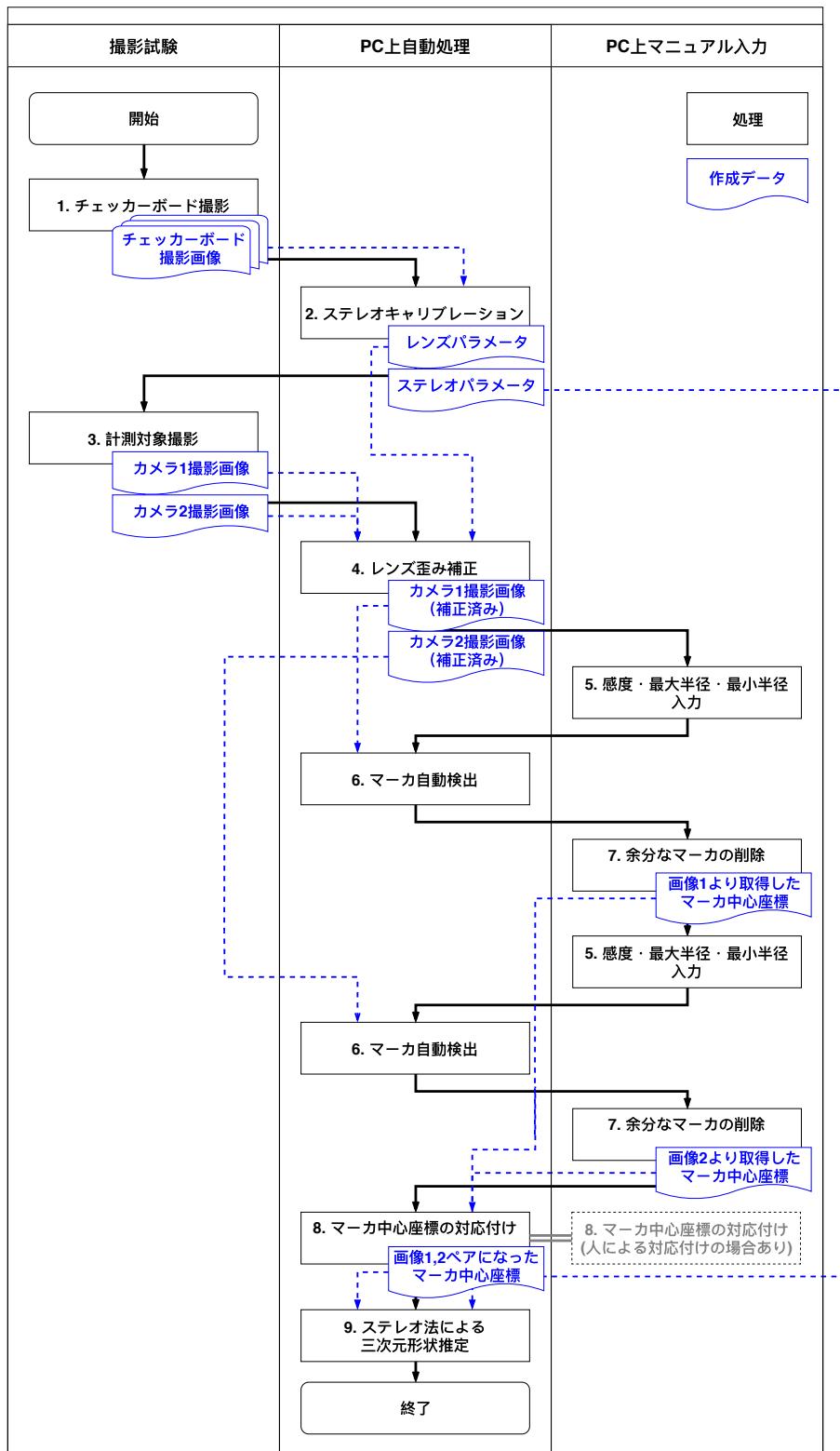


図 3.28: 3次元計測システムフローチャート

以下では各処理の詳細について述べる。

1. チェッカーボード撮影

FMカメラのキャリブレーションは、モニターに13マス×19マスのチェッカーボードを映し出し、様々な角度から撮影。チェッカーボードの画像データは、<https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html#resources>からAdobe Lens Profile Creatorをダウンロードし、「Adobe_lensprofile_creator_1_0_4_win.lensprofile_creator_p4_win_072312」Adobe Lens Profile Creator 1.0.4 calibration charts」というフォルダに入っているデータを使用。撮影枚数は10枚以上あれば何とかなるが、普段は15~20アングルぐらい、最終キャリブレーションは80アングル撮影した。

コメント

- モニターは解像度の問題があるので、モニターではなく紙に印刷したチェッカーボードを撮影すべきだったかもしれない。紙を使用する場合は、紙がたるまないように注意。モニターと紙のどちらが正解かは分からぬ。
- 13マス×19マスの100%表示は周りに余白ができていて、スペースがもったいないので、余白が無いようにマス目の多いチェッカーボードを100%以上で表示させてもいいかもしれない。
- 撮影時、カメラ平面に対してチェッカーボードが45度を超えないように注意。45度を超えた画像が含まれると、キャリブレーション結果が悪くなるらしい。撮影時の注意点は、<https://jp.mathworks.com/help/vision/ug/stereo-camera-calibrator-app.html>の「キャリブレーションの改善」に載っている。

2. ステレオキャリブレーション

MATLABアプリケーション「ステレオカメラキャリブレーター」を使用。オプションは「半径方向歪み:3つの係数」「計算:せん断・円周方向歪み」を選択。各設定の詳細は、<https://jp.mathworks.com/help/vision/ug/stereo-camera-calibrator-app.html>の「キャリブレーションの改善」を参考に。

3. 計測対象撮影

地上暗室実験では、室内のライトを消し暗室で撮影。アルミフレームむき出しだとLEDの明かりによって反射してしまうので、黒い布で隠して撮影を行った。

4. レンズ歪み補正

MATLAB関数「undistortImage」に、「2. ステレオキャリブレーション」で作成されたレンズパラメータと画像データを入力し、画像の歪み補正を行う。

コメント

- MATLABではなく、「Adobe Lens Profile Creator」および「Adobe Photoshop」を使用する方法もあったが、Adobe Lens Profile Creatorの設定がよく分からず、誤差が大きくなってしまうことからMATLABのみを使用していた。ただ、まだ完璧に歪みを補正できている訳ではなさそうなので、専門家に確認した方がいいかもしれない。

5. 感度・最大半径・最小半径を入力

処理6「マーカ自動検知」において、MATLAB関数「imfindcircles」を使用する場合は事前に、感度、最大半径、最小半径を入力する必要がある。

コメント

- 感度：0.85としていた。1つのマーカに対して多重検知してしまう場合は、感度の値を小さくする（0.7ぐらい）ことによって、解決することができた。
- 最大半径・最小半径：被写体距離によって変わる。画像上においてマーカ直径が何ピクセルかを事前に確認しておき、 $\pm 1\sim 5$ ピクセルぐらいに設定していた。
- 感度、最大半径・最小半径によってマーカの中心座標検知精度が変わりそうな気がするので、三次元形状計測精度に関する研究を行う場合は、この3つの数値を気を付ける必要あり。

6. マーカ自動検出

MATLAB関数「imfindcircles」を使用。

7. 余分なマーカの削除

格子状配置マーカ対応付けプログラム、旧ランダム配置マーカ対応付けプログラムの場合は、余分なマーカを削除して、画像1と画像2のマーカ数と配置を揃えなければならない。新マーカランダム配置対応付けプログラムの場合は、マーカ以外の変なところを誤検知している場合は削除する必要があるが、マーカ数と配置を完全に一致させる必要はない。

8. マーカ中心の対応付け

(a) 格子状配置マーカ対応付けプログラムと (b) ランダム配置マーカ対応付けプログラムの2種類がある。

9. ステレオ法による三次元形状計測

MATLAB関数「triangulate」を使用。

(3) 動画計測（飯島）

3.9.3 膜展開部

(1) 展開膜開発（古谷・坂本）

(2) MDC（大本）

- 基本設計思想

MDC(Membrane Device Contoroller) は膜上に取り付けられた SMA アンテナの利得計測、ひずみ値計測、薄膜太陽電池の IV 特性計測、膜の温度計測、伸展マスト先端の IMU 情報の計測、膜展開を行うテグス溶断の冗長系を担うことを目的として新規開発を行った基板であり、伸展マスト先端の膜上デバイス制御部に取り付けられている。

- プログラム概要

プログラムの機能としては以下の 3 つがある。

1. OBC からのコマンドに従い、各データを取得し、EEPROM に保存
2. OBC からのコマンドに従い、指定された EEPROM のアドレスから指定されたデータ数を OBC に送信
3. OBC からのコマンドに従い、膜展開を行うテグスを溶断

この中で、SMA アンテナの利得、ひずみ値計測は開発の遅れから断念した。

- コメントや次回への改善点

MDC 開発はバス部開発の遅れからあまり力を入れることができず、SMA アンテナミッションを諦めたり、その他の機能についても最低限の機能しか搭載することができなかった。

(3) 薄膜太陽電池ミッション（大野）

薄膜太陽電池ミッションは、多機能膜展開ミッションの一つであり、展開膜上に配置された薄膜太陽電池の発電量を評価することを目的とする。要求としては、

- 多機能膜展開後、I-V 特性を測定する
- 薄膜太陽電池の温度を測定する

ということがあげられる。本稿では、FM での設計・制作方法を記する。

薄膜太陽電池の設計

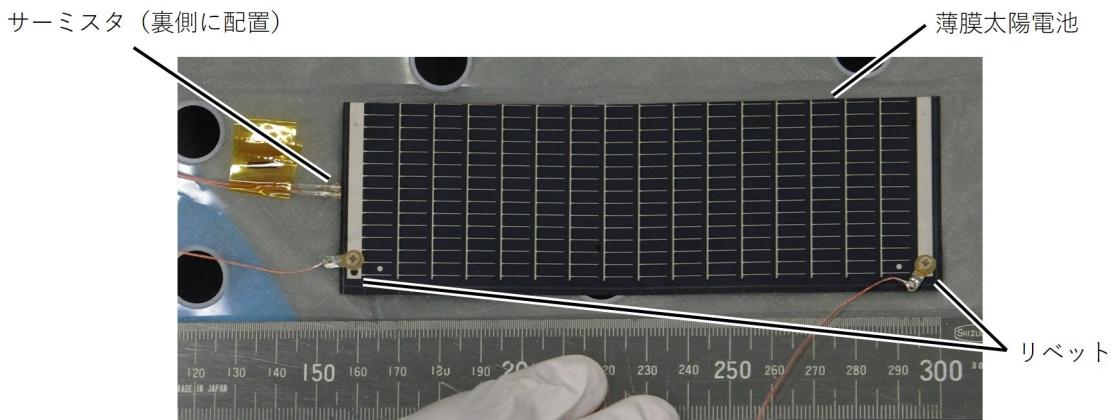


図 3.29: FM 展開膜の薄膜太陽電池

FM の薄膜太陽電池の配置図を図 3.29 に示す。薄膜太陽電池は両端に電極があり、そこにフレキシブル導電糸をリベットで固定し、MDC へと接続している。サーミスタ (103JT-025, SEMITEC) は、薄膜太陽電池の裏側に配置している。設計の方針として、接着成分を膜上に載せないことがあげられる。これは、サカセさんからの要求であり、展開に影響がある可能性があるからである。

各要素の選定過程

私は途中から担当となったので、私が行ったものについてのみの記載です。

サーミスタの配置 サーミスタ自体はもともと本衛星の別の箇所で使用していたものを使用した。したがって、ここでは配置についてのみ記述する。要求する値は、発電する表温度である。しかし、薄膜太陽電池とサーミスタの接着方法はホットメルト接着剤を考えており、表側であると発電部に貼付することとなるので、発電量が減少する恐れもある。以上のことから、裏側の貼付が望ましいと考え、サーミスタを表側に貼付した場合と、裏側に貼付した場合について実験を行い、比較した。結果としては、双方間の発電特性の差は、誤差の範囲内であったため、サーミスタを裏側に貼付しても発電面の温度と同等な値が得られるので、裏側に貼付することとした。

フレキシブル導電糸と薄膜太陽電池の接続方法 当初は半田付けを予定していたが、半田付けをすると薄膜太陽電池の電極部の皮膜がはがれる事態となった。それにより、導電性接着剤 (CHO-BOND 1030-55, 太陽金網株式会社) を使用した。しかしながら、粘着成分を膜上に搭載することになるので、サカセさんより、リベットによる固定方法を提案していただいた。これは、薄膜太陽電池に穴を開け、フレキシブル導電糸を電極に半田付けし、ねじで固定する方法である。イメージ図を図 3.30 に示す。

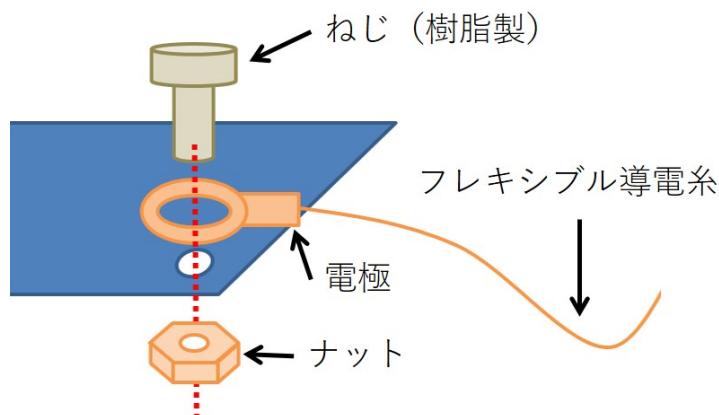


図 3.30: 薄膜太陽電池とフレキシブル導電糸の接続方法

この設計で FM を製作したが、薄膜太陽電池に穴を開けるとき、ポンチであけていたが、薄膜太陽電池が裂ける可能性があるため、注意が必要である。(不要となった薄膜太陽電池を用いて何度も練習してから製作するのが望ましい。)

配線 配線で気をつけた点は 2 点ある。1 つ目は電極付近をたるませることである。ねじで固定後の初めての展開実験で、展開衝撃により、フレキシブル導電糸に張力が加わり、薄膜太陽電池のねじ固定部が裂ける事態となった。これにより、フレキシブル導電糸のねじ固定部付近をたるませて配線することとした。2 つ目は展開膜の折り目に沿って配線することである。折り目に沿わせることで、展開時に阻害しないようになる。

薄膜太陽電池の制作方法

ここでは、FM 展開膜の最終組立工程を記述する。
用意するもの: 薄膜太陽電池 × 2, サーミスタ × 2, フレキシブル導電糸 × 8 (薄膜太陽電池用 × 4, サーミスタ用 × 4: それぞれの長さは、展開膜上に配置し決定する), ねじ固定用具 (PEEK ねじ M2 × 4, 電極, M2 ナット) × 4

1. 薄膜太陽電池にねじ留め用の穴を開ける ポンチを用いて薄膜太陽電池の両端に穴をける。
ポンチのサイズはねじサイズのばか穴のサイズより決定される。

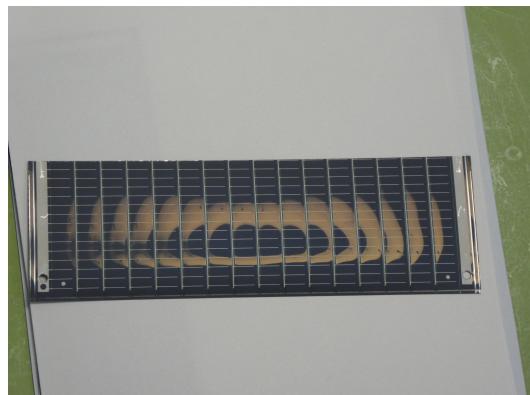


図 3.31: ねじ留め用の穴を開けた薄膜太陽電池

2. 半田付けをする サーミスタと電極にそれぞれフレキシブル導電糸を半田付けする。サーミスタは半田部分に熱収縮チューブを取り付ける。また、サーミスタははんだ耐熱性が決まっている（ 260°C , 5秒）ので、注意する。電極は薄膜太陽電池の両端でそれぞれ向きが異なるので注意する。

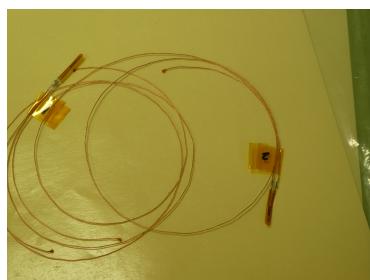


図 3.32: はんだ付けしたサーミスタ

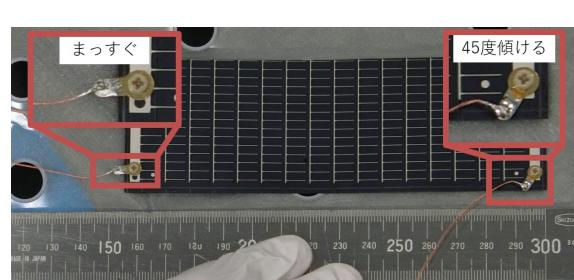


図 3.33: はんだ付けした電極

3. フレキシブル導電糸を薄膜太陽電池に固定する 電極を、PEEK ねじで固定する。トルク値は $0.03\text{N}\cdot\text{m}$ （推奨締め付けトルク）。基板側の導電糸の先端にどの太陽電池の導電糸かわかるようにナンバリング等を行うことに気をつける。展開膜収納後、たくさんあるハーネスの中で区別がつくようにならないと基板側との接続ができなくなる。

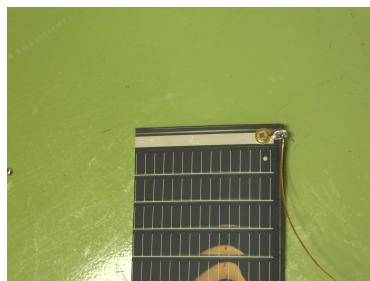


図 3.34: ねじ留めした薄膜太陽電池（外側）

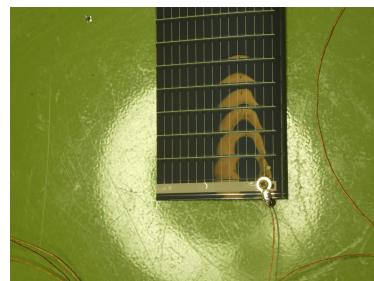


図 3.35: ねじ留めした薄膜太陽電池（内側）

4. サーミスタを接着する サーミスタにホットメルト接着剤を貼付し、アイロンで熱癒着させる（ 100°C , 10秒）。その後、薄膜太陽電池に熱癒着させる（ 100°C , 10秒）。基

板側の導電糸の先端にどちらの太陽電池のサーミスタかわかるようにナンバリング等を行うことに気をつける。

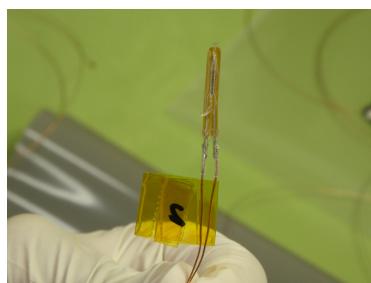


図 3.36: ホットメルト接着剤を貼付した
サーミスタ

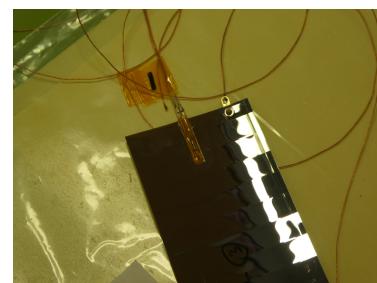


図 3.37: サーミスタを貼付した薄膜太陽
電池

5. 薄膜太陽電池を展開膜に接着する 図 3.38 に表せられたようにホットメルト接着剤 (1cm 角) を貼付し、アイロンで熱癒着させる (100 °C, 10 秒)。接着後、展開膜に同様に接着する。

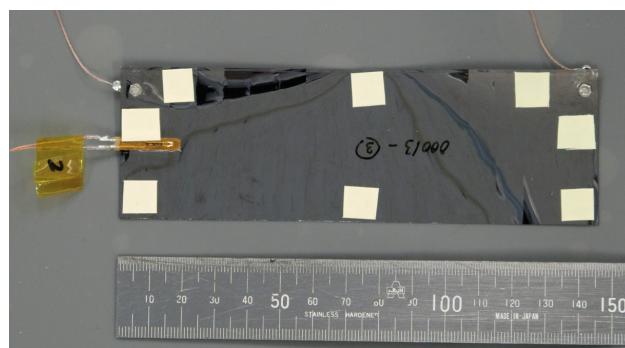


図 3.38: ホットメルト接着剤を貼付した薄膜太陽電池

6. フレキシブル導電糸を展開膜に配線する 図 3.39 のとおりに配線する。

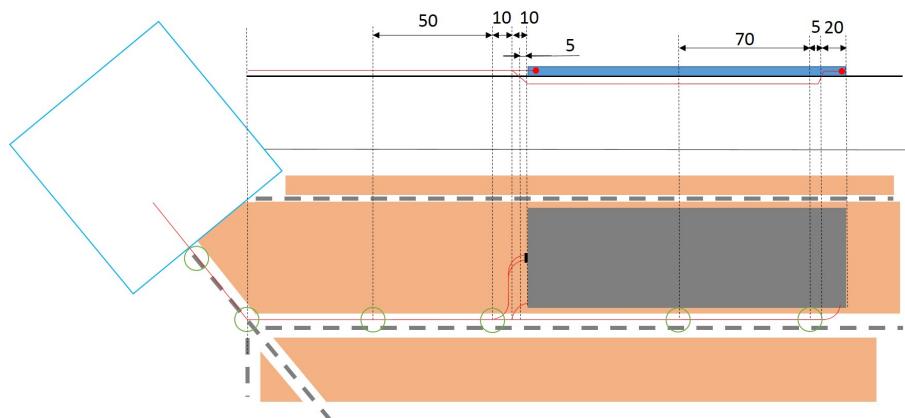


図 3.39: 配線方法

完成

薄膜太陽電池の管理方法

ナンバリング等できちんと管理する。発電特性の実験をしたらどの薄膜太陽電池のものかわかるように管理する。

- (4) SMA アンテナミッション（鳥阪）
- (5) 球状太陽電池ミッション（サカセ・坂本）

第4章 統合試験

4.1 放射線試験（寺田（報告書）・池谷・黒崎）

4.1.1 目的

本試験では、多量の放射線が入射することに起因する電離効果のうち、トータルイオンドーズ効果が機器に与える恒久的損傷を調べた。これにより、新規開発基盤である通信&インヒビット（CI）基板および膜上デバイス制御（MDC）基板に関して、ミッション期間中に受ける損傷具合を試験した。

4.1.2 試験概要

(1) 試験日時

第1回

2015年10月20日

第2回

2018年5月28日14時から18時（計4時間。準備と撤収時間も含む。 γ 線の照射時間は3時間。）

コメント

- 実験室を予約する場合は、照射時間だけでなく、前後の準備撤収時間を考慮し最低1時間は余分に予約する。
- 第2回試験では1名のみで当日、準備から実験まで行ったが、照射室とPC等を置く場所は離れているので、2名いた方が準備しやすいと思う。

(2) 試験場所

東京工業大学 大岡山キャンパス 大岡山北実験棟1 コバルト60 照射室

コメント

- 予約はメールでやり取りを行う。

4.1.3 第1回放射線試験

(1) 試験供試体

CI 基板, MDC 基板上の IC. 供試体一覧を表 4.1 に示す。

		種類	照射時間	照射量	安全率	宇宙実証
CI	PIC16F887	マイコン	3	231	5.4	
	PIC16F886	マイコン				○
	TPS55330	DCDCコンバータ	0.5	39	0.9	
	TC74HC4066	マルチプレクサ				
	MPU-9250	加速度, ジャイロ				
	FX614	モデム				○
	MAX11605	ADコンバータ				
	MTM232230	MOSFET				
	MTM231232	MOSFET				
	BSC030P03NS3G	MOSFET				
	B540-13-F	ダイオード	0.5	39	0.9	
MDC	PIC18F25K80	マイコン	3	231	16.2	
	MAX3051	CAN トランシーバ	3	231	16.2	
	AD8657ARMZ					
MA	ADL5513ACPZ		3	16830	5.1	
共通	TA78033AF	レギュレータ	0.5	39	0.9	
共通	24LC256	EEPROM				○
共通	SK8603140L	MOSFET				
共通	2SK2009	MOSFET				
共通	RB080L-30	ダイオード				

表 4.1: 第1回放射線試験 試験供試体一覧

(2) 検証方法

図 4.1 の通りに、デバイスを配置し、データロガー及び PC でデータをモニタリングした。

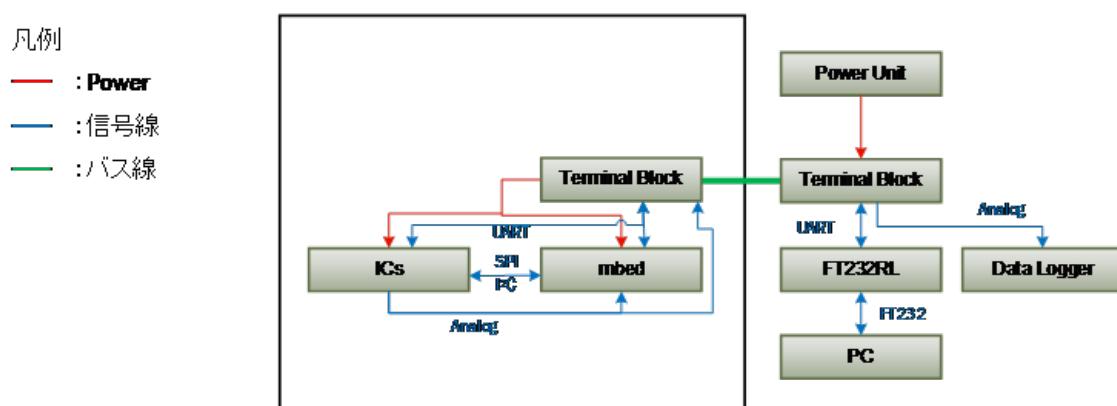


図 4.1: デバイスの位置関係。長方形内が放射線試験室を示している。

コメント

- 放射線照射室とPC等を置くう照射室外を繋ぐ図4.1の緑ハーネス部分は、コバルト60照射室の設備としてDサブハーネスが既にある。ただ、Dサブハーネスと接続するケーブルは両側、事前に作成しておく必要がある。事前にコバルト60照射室を見学しておくと、どのようなハーネスを作成しなければならないかイメージがつきやすいと思う。
- ハーネス作成時には、グラウンドを全て共有することを忘れずに。

(3) 照射量

OrigamiSat-1のCI基板周り、およびMDC基板周りのアルミニウム構体板厚は2 mmである。文献[相互参照使おうね]の厚さ1.85 mm、1年あたりトータルドーズ量4.28E+03 radであるため使用期間をCI基板は1年、MDC基板は4か月として、この値から安全率を計算した。表4.2に示す。

11月の線源からの距離60 cmの値74 Gy/hを用いた。また両基板ともに両面にICが搭載されているため0.5 hごとに基板の表裏をひっくり返した。線源に対して裏面にあるICの被ばく量は表面にあるICの被ばく量に対して微小であると仮定した。

	使用期間 [months]	最大想定 被ばく量 [Gy]	片面照射時間 [h]	照射量 [Gy]	安全率
CI基板	12	42.8	3	222	5.2
MDC基板	4	14.3	1	74	5.2

表4.2: 照射量

(4) 配置

線源から60 cm。実験の様子を図4.2、図4.2に示す。



図4.2: 配置の様子

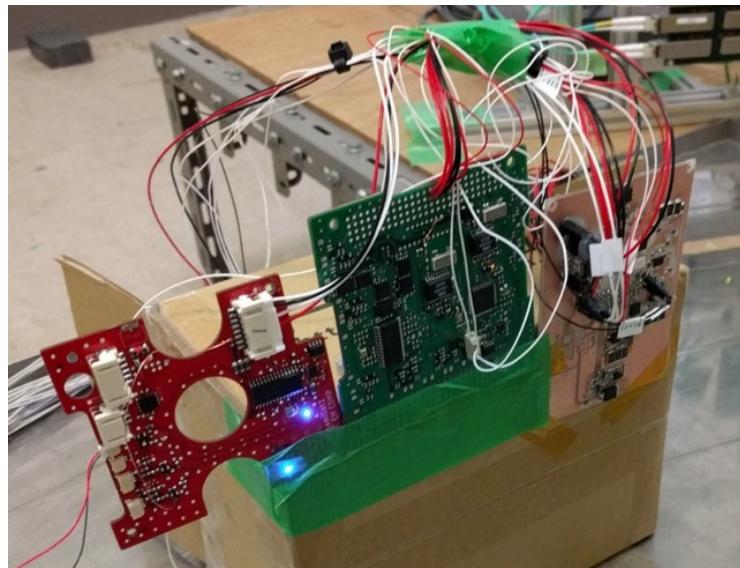


図 4.3: 試験供試体拡大図

(5) 試験手順

1. 各コンポーネントを接続する
2. 順番に電源を投入する
3. 照射前に各 IC が適切に動作していることを確認する
4. 照射：照射中はログを取る
5. 撤収する
6. データの解析を行う

コメント

- 試験前日までに、放射線を照射しない状態で予定試験時間分 IC が動作することを確認しておく。

(6) 試験結果

結果： RXCOBC が 1.5 年分の照射後一時動作不良を引き起こした。

原因： UART もしくは I^2C ラインに不具合が発生したことが原因と思われる。

対策： PIC16F887 を CubeSat での使用実績のある PIC16LF877A に変更。

4.1.4 第2回放射線試験

第1回試験で CI 基板上の PIC において不具合が生じたことを受け、搭載 IC の型番を決定するために、3種類の PIC における追加試験が行われた。また、WDT 機能に使用される SA555 タイマーの放射線損傷具合も試験した。

(1) 試験供試体

CI 基板上に搭載される PIC およびタイマー

- PIC : 16F886
- PIC : 16F887
- PIC : 16LF877A
- タイマー : SA555

(2) 検証方法

後で図を追加 !!!

(3) 照射量

- 線源から IC までの距離 : 100cm
- 1 時間あたりの線量 : 28.2 Gy/h (参考文献 [??] の 2017 年 12 月 100cm の数値)
- 照射時間 : 3 時間
- 総照射量 : 84.6 Gy

コメント

- 第 1 回試験と異なる試験条件（線源までの距離、照射時間）で試験を行ってしまったが、第 1 回と試験条件を揃えないと、適切に比較はできなかったかもしれない。

(4) 配置

線源から 100 cm.



図 4.4: 配置の様子

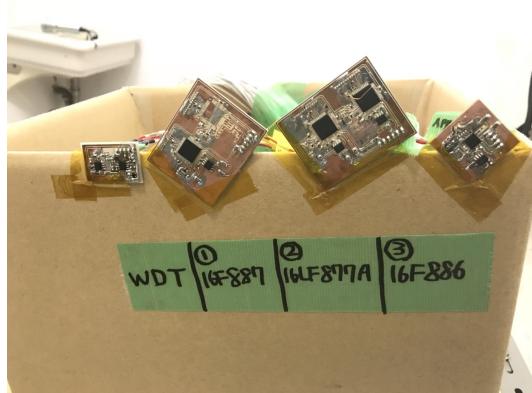


図 4.5: 試験供試体拡大図



図 4.6: 照射室外の様子。mbed 等が搭載されたブレッドボード、外部電源、PC などがある。

(5) 試験手順

4.1.3 第1回放射線試験 (5) 試験手順と同様

(6) 試験結果

結果：不具合発生せず。RXCOBC は 16LF877A、TXCOBC は 16F886、タイマーは SA555 を採用することに決定。

4.2 形状計測試験（大野・奥山）

CubeSat は E-SSOD と呼ばれるポッド内に収納された状態でロケットに搭載される。そのため、E-SSOD に収まり、軌道上で問題なく E-SSOD から放出されるために、CubeSat の形状には制約がある。本衛星の形状に関する要求は、インターフェース管理文書(以後 ICD と記載)に定義されている。ICD に記載されている形状に関する要求には以下のものがある。

1. 外形寸法に関する要求

2. レールに関する要求
3. エンベロープに関する要求
4. 質量特性に関する要求
5. セパレーションスプリング/ディプロイメントスイッチ
6. 強度要求
7. アクセス窓

これらの要求に関する試験結果については OrigamiSat-1 検査成績書 (OP-S1-0009) に記載されている。本章では、これらの要求の詳細と、要求を満たしているか確認するために行った試験について説明する。

4.2.1 外形寸法に関する要求

本衛星は 3U の CubeSat であり、ICD において寸法は以下のように規定されている

1. 縦横ともに 100 ± 0.1 mm の幅とすること
2. 高さは 340.5 ± 0.3 mm とすること

この要求が満たされているか確認するために、まず三次元測定機を用いた測定を行なった。

(1) 三次元測定機を用いた測定

東工大の工場内には図 4.7 に示すような三次元測定機がある。三次元測定機とは、3 次元で物体の各点の座標を測定することができる装置である。



図 4.7: 3 次元測定機

三次元測定機は、工場特殊セルフ利用にあたり、通常の工場利用の際に受ける講習だけではなく、三次元測定機の利用講習を受ける必要がある。三次元測定機の利用講習は、業務依頼書に講習希望の旨を記入しメールで提出する。講習を受けたのち、工場に利用予約のメールをし、予約が空いていれば教員立ち会いのもと使用することができる。工場特殊セルフ利用は通常の工場利用よりも時間単価が高く、利用には注意が必要である。

本衛星の測定には、衛星のレールに沿って座標軸を設定し、そのレールに対し対面のレールが 100 ± 0.1 mm の幅で収まっているか確認するという方法を用いた。測定結果を入力すると、正しい位置からの誤差を拡大して表示し、ずれている方向をわかりやすく示す Excel シートを作成した。結果は以下の図 4.8 のように表示される。

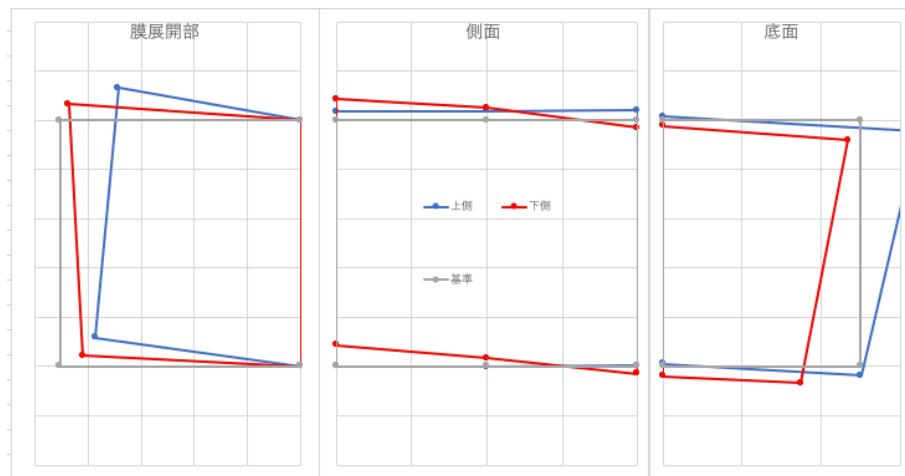


図 4.8: 3 次元測定結果図示

測定結果が要求を満たしていない場合には、一旦ネジを緩め再度精度出しを行った。精度出しをやり直す際には、Excel で図示した結果をもとにみ出している箇所と治具のレール部の間にシムテープを挟み誤差の修正を行った。シムテープを挟み込むことで誤差を調整することはできるが、EM, FM ともに完全に要求を満たすことはできなかった。

三次元測定は JAXA や IHI Aerospace(以後 IA と記載) から指定された測定手法ではなく、外形寸法の要求を満たしているか確認するために、東工大側で選択した確認方法である。開発スケジュールに遅れが出ていたこともあり、要求を満たしているか確認する方法を変更することにした。

(2) フィットチェックとノギスによる確認

フィットチェックとは E-SSOD に衛星が収まるかどうかを、フィットチェック用 POD に衛星を収納することで確認する作業である。E-SSOD のレール幅は 100.5 ± 0.2 mm であるが、フィットチェック用 POD のレール幅は 100.2 ± 0.1 mm となっており、フィットチェック用 POD に引っかかりなく収納されれば E-SSOD に問題なく収めることができる。フィットチェックの様子を以下の図 4.9 に示す。

本衛星の外形寸法の要求確認は、フィットチェックで POD に問題なく収まることを確認したのちに、ノギスで各部のレール幅を測るという方法で行うこととした。フィットチェックは引っかかりなく収まることを確認するために、動画で記録している。

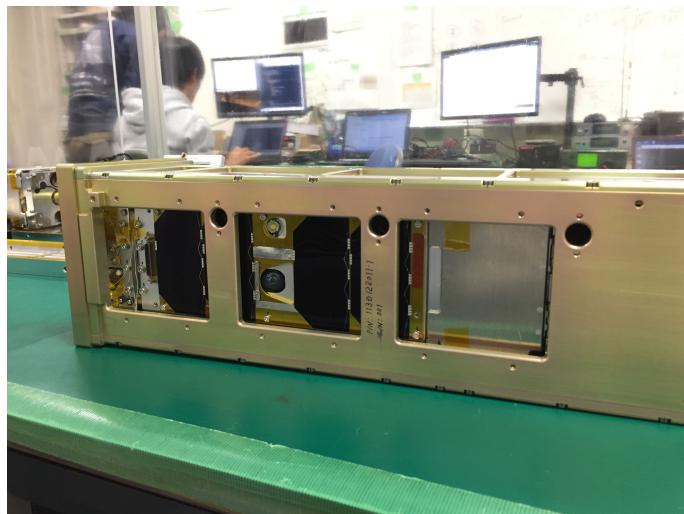


図 4.9: フィットチェックの様子

この検査方法では精度出しをやり直すことなく1回でフィットチェック用ポッドに収まり、ノギスでの測定でも問題は生じなかった。より詳細な検査結果は検査成績書を参照のこと。

4.2.2 レールに関する要求

レールはE-SSODと衛星が接する部分であり、打ち上げ時に衛星を支え、放出時にはガイドとなるため、とても重要度が高くICDでは8つの項目が規定されている。その中で本衛星にとって問題となった要求が以下の2つである。

1. レールの表面は $R_a 1.6 \mu\text{m}$ 以下とすること
2. 各レールの $\pm Z$ を除く側面について、E-SSODのガイドレールと少なくとも 75%以上接触面を持つこと

レール表面粗さについてはFM側面パネル発注時に、図面上で表面粗さの指定を間違えていたため要求が満たされておらず、別途表面粗さ計測試験を行った。詳細は第4.9章を参照のこと。またレール長さについては、設計上長さの規定を満たしていなかった。本衛星には膜展開部や、側面パネルと底面パネルの間などレールではない部分が多くある。この長さの分は設計時に考慮できていたが、側面パネル固定のためのネジ穴の座繰り分を計算に入れておらずレール長さが規定より短くなってしまった。そのため、規定より短い長さのレールでも問題なくE-SSODから放出できるか確かめるために放出試験を行った。詳細は第4.10章を参照のこと。その他の要求についての検査は検査成績書に記載されている。

4.2.3 エンベロープに関する要求

エンベロープに関する要求とは、衛星のレール面より内部の突起物に関する要求である。突起物のレール面からの距離、突起部の長さが規定されている。また、展開構造についても誤展開した際の安全性に関して要求がなされている。

本衛星は突起物に関しては設計上問題はないが、展開構造に関しては展開アンテナの厚さが要求を満たしておらず、冗長系のテグスを巻くことで安全性を担保している。詳しい検査結果は検査成績書に記載されている。

4.2.4 質量特性に関する要求

質量特性に対する要求は以下の2つであった。

1. 質量が1Uあたり0.13kg以上、1.5kg以下であること
2. 質量中心が4本のレールで構成される直方体の幾何中心を中心とする半径20mmの球体内に位置すること

質量については、本衛星は3Uであるため質量が0.39kg以上、4.5kg以下であれば良い。実際の質量はCADで確認したのちに、組み立て前にコンポーネントごとに質量計測し、組み立て後に衛星全体の質量を測定した。

質量中心はCAD上で計算している。

4.2.5 セパレーションスプリング/ディプロイメントスイッチに関する要求

衛星がE-SSODから放出されたことを確認する衛星側のスイッチに関する要求である。本衛星は設計段階からこの要求を満たしている。放出検知スイッチの電気的な要求の確認方法については組立手順書を参照のこと。

4.2.6 強度要求

衛星が地上、試験、運搬、打ち上げ、運用の過程において破損や永久変形しないことを求める要求である。強度要求は衝撃試験、振動試験で確認を行った。

4.2.7 アクセス窓

アクセス窓はE-SSODに収納後に衛星にアクセスする必要がある際のアクセスポート設置位置に関する要求である。E-SSODは引き渡し時に蓋を閉めたのちに開けることはないため、ソフトの書き換え、ライトピンなど衛星にアクセスする必要に備えてアクセスポートを設置しておく。

本衛星はバス部のソフト書き換え用にD-subコネクタを備えており、E-SSODのアクセス窓からアクセスが可能である。また、このアクセスポートは振動試験の際にも以下の図4.10のように、衛星内部の機器と接続するために必要となる。振動試験の際に衛星の収納方向を入れ替えたが、入れ替えた後もD-subコネクタはアクセス窓からアクセス可能であった。なお、MDCボックスに設けられているmicroD-subのコネクタはMDCソフト書き込み用のものである。組立後にMDCにアクセスできなくなるため設けられたもので、アクセス窓に関する要求とは無関係のものである。

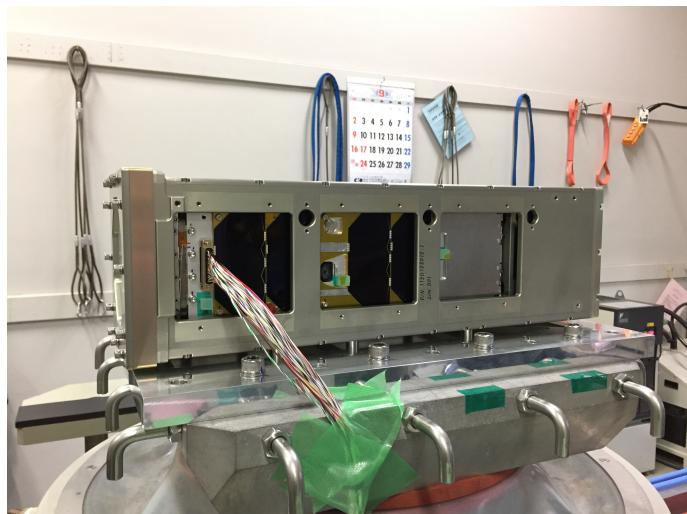


図 4.10: 振動試験時のアクセスポート利用

4.3 振動試験（加藤・飯島）

衛星は、打ち上げ時・軌道上での過酷な環境に耐えうるよう設計され、それが試験により確認される必要がある。CubeSatのようなピギーバック（相乗り）衛星が打ち上げ環境により破壊もしくは爆発を起こしてしまった場合、その影響は主衛星にも及ぶ。打ち上げ時の環境は2つの振動環境と準静的加速（打ち上げの際の加速）環境によりなる。振動試験では打ち上げ時以上の過酷な加振を行い破壊が発生しないことを確認することで、衛星が打ち上げに耐えうることを示す。

本章では振動試験の目的・内容・実施時の注意等をなるべくわかりやすく説明することから、本章が「振動試験初心者マニュアル」となることを期待する。試験実施時の詳細な試験手順及び試験における確認事項は振動試験ハンドブック^[?]ならびに試験の際の計画書・報告書・手順書^{[?][?][?][?][?][?][?][?][?]}を参考にしてほしい。

※ちなみに、僕（加藤）が振動試験場に行って最初に発した言葉は帰り際の「サインバースト試験って何ですか？」である（試験前の下見だったので、僕の知識不足は試験に影響を与えるなかったということは一応書いておく）。衛星開発をやらなければ日常で振動試験などに出会うはずがない。わからないことが多いのは当然であり、試験場の方やJAXAの方もそれは承知してくれているはず。この文書を読んでいる試験担当者には試験前、試験中に多くの質問をすることを期待する。また、この文書を読んでいるのが担当者の先輩、教員であれば分からぬことを率先して質問し、担当者が質問のしやすい空気を作っていただければ幸いである。

4.3.1 振動試験とは

(1) 試験目的

振動試験の目的は以下の4つである。

1. 打ち上げ環境に耐えうることの確認

2. 剛性の確認（ロケットとの振動連成の防止）
3. 組み立てに伴う欠陥（ワークマンシップエラー）がないことの確認
4. 構造数学モデルの確認

打ち上げ時の振動環境以上の加振を行うこと、また固有振動数と伝達関数の値及び試験前後のそれの変化を調べることにより 1,2,3,4 を示す。それに加え電気的な機能試験（チャタリング検知・機能試験）も行い 1 を示す。また 4 に関してはモード形状も含めたモードパラメータに対する精度が要求された場合のみモーダルサーベイ試験が必要となる（OrigamiSat-1 振動試験ではモーダルサーベイ試験も実施している）。

（2）打ち上げ環境

打ち上げ時の環境は準静的加速環境と振動環境に分かれ、さらに打ち上げ時の振動発生要因は多岐にわたる。また液体ロケットと固体ロケットにおいてもその振動環境は異なる。しかし大別すると打ち上げ時の過酷な環境は

- 数 Hz～数十 Hz の低周波過渡振動：リフトオフ時のブースターの推力立ち上がり、大気中飛行時の乱流、1/2段分離時の分離スプリング力等によるもの
- 数百 Hz～数千 Hz の高周波ランダム振動：エンジン排気流から生じる音響、フェアリング壁の液体加振によるもの
- 準静的加速度：ロケット発射時の加速によるもの

の 2 つの振動環境と準静的加速環境の合計 3 種類となる。

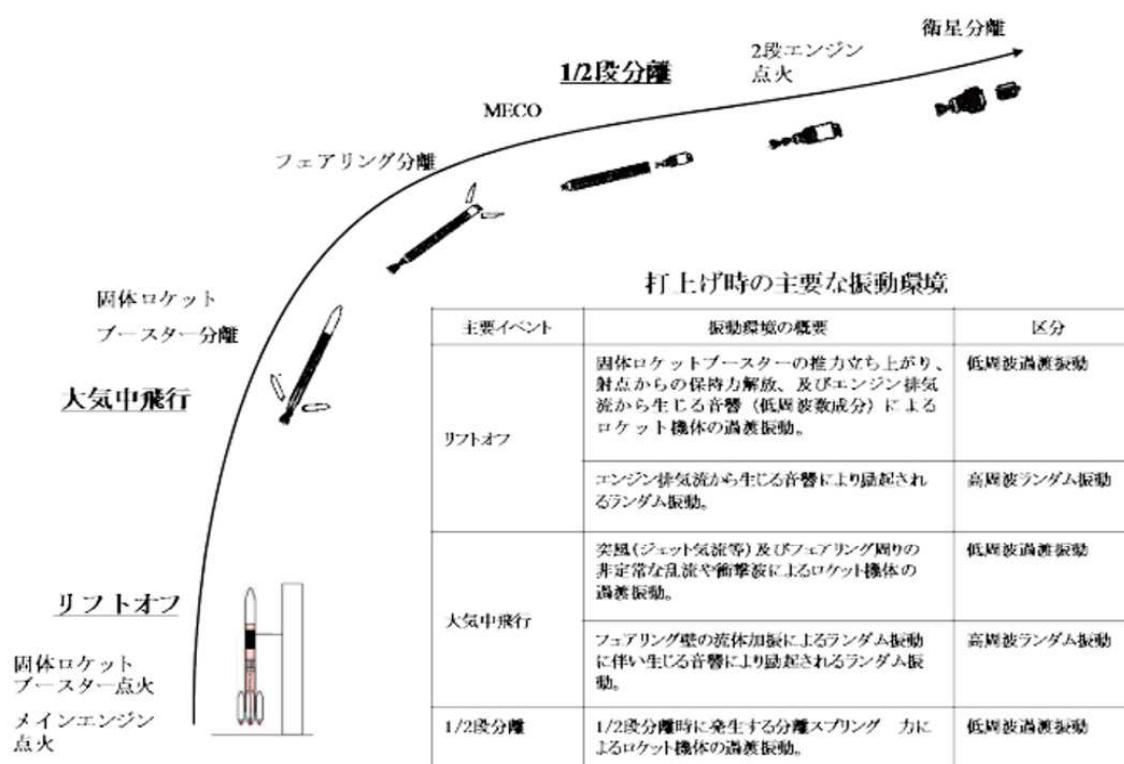


図 4.11: 打ち上げシーケンス及び打ち上げ時の主要な振動環境 [?]

4.3.2 試験内容

OrigamiSat-1 開発における振動試験においては、上記で示した 3 種類の環境を模擬した試験にモーダルサーベイ試験（モード形状・固有振動数測定試験）を加えた以下の 4 種の試験を実施した。

1. 正弦波振動試験：低周波過渡振動に耐えうること
2. ランダム振動試験または音響試験：高周波ランダム振動に耐えうること
3. サインバースト試験（静荷重試験の代替試験）：準静的加速度環境に耐えうること
4. モーダルサーベイ試験：衛星と振動連成を起こさないこと

表 4.3: 振動試験の目的と種類 [?]

	打上げ時の振動環境に対する耐性の確認	剛性の確認	ワークマンシップの確認	構造数学モデルの確認
正弦波振動試験	○	○	○*1)	○*3)
ランダム振動試験	○	○	○*2)	-
サインバースト試験	○	-	○	○*4)
モーダルサーベイ試験	-	-	-	○

*1) 主にシステム・サブシステムレベルのインテグレーションを含むワークマンシップの確認

*2) 主にコンポーネントレベルのワークマンシップの確認

*3) 固有振動数とその周波数における伝達関数の確認

*4) 応力による静的な構造数学モデルの確認

また、試験目的に応じては要求される強さ (AT,Accentance Test) の加振よりも弱い加振 (1/2AT) または強い加振 (QT,Qualification Test) を行い、衛星がどの程度の加振に耐えられるのかを確認することもある。EM 試験においてはそのような試験も実施した。詳細は後述。

(1) モーダルサーベイ試験

各試験の前後にモーダルサーベイ試験を実施し、その前後でのモード形状および固有振動数に変化がないことを確認する。試験においては周波数範囲・加速度密度・実効値・時間が指定されているが、公差は指定されていない。報告書には固有振動数及びモード形状が各試験前後で変化しないことを記載する。変化していた場合は衛星内部で破壊が起ったことが疑われる。

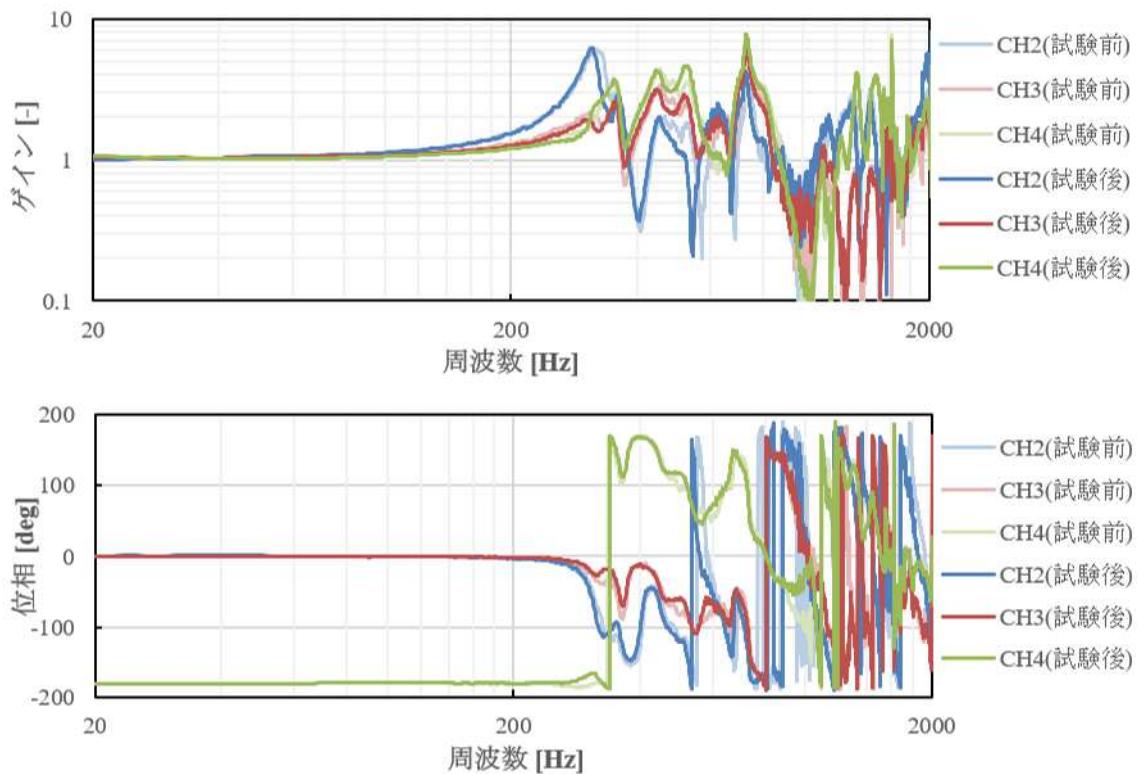


図 4.12: FM 試験におけるモーダルサーベイ試験結果 [?]

(2) 正弦波加振試験

周波数を変えながら加振を行い低周波過渡振動に耐えうることを確認する。試験は2種類の周波数帯(22-36Hz, 43-57Hz)で行った。試験においては加速度・掃引速度(周波数変化速度)・往復数・公差が指定されている。報告書には指定された強さの試験ができていることを記載する。

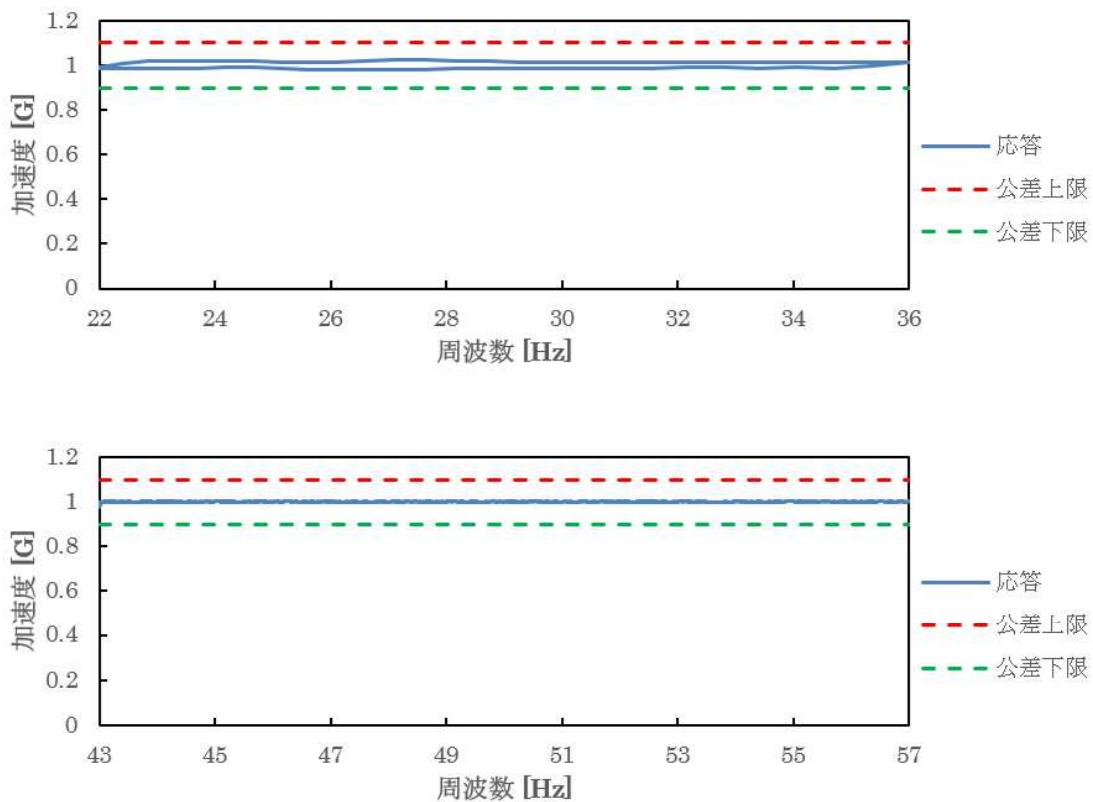


図 4.13: FM 試験における正弦波加振試験結果 [?]

(3) ランダム振動試験

ランダムな振動を加え、高周波ランダム振動に耐えうることを確認する。ランダム振動試験においては周波数範囲・加速度密度・時間・公差が指定されている。時間は既定の公差内の振動になってから測定し始める。公差内の振動になるまでにかなり時間がかかるが気長に待つ。報告書には指定された公差内で試験ができていることを記載する。高周波の範囲(1700Hz 前後)で一部だけ公差を外れることがある。試験場で伝達関数を確認してもらえばわかると思うが、高周波の部分は伝達関数が安定しておらず制御のしにくい部分なのでこうなることがある。固有振動数と大きく外れていることを報告書に記述すれば問題ない。

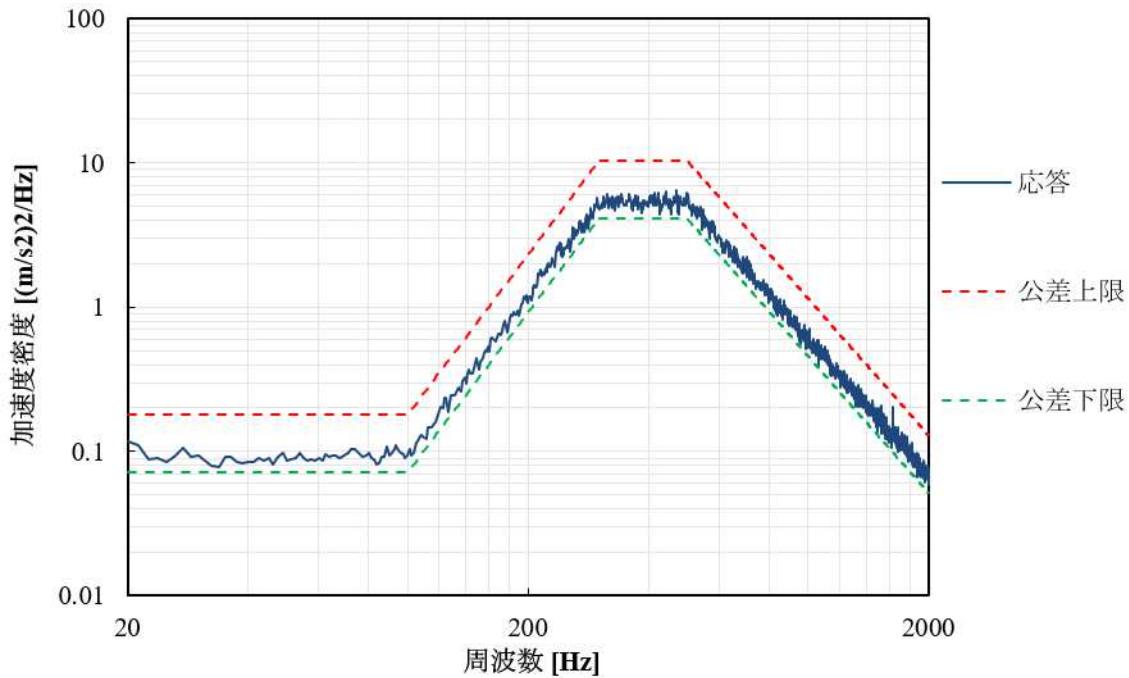


図 4.14: FM 試験におけるランダム振動試験結果 [?]

(4) サインバースト試験

サインバースト加振を行い準静的加速度環境に耐えうることを確認する。サインバースト試験においては周波数・サイクル数(波数)・加速度・公差が指定されている。この試験は5秒程度で終わる。報告書には指定された強さの試験ができている(指定された加速度の波が指定された回数観測できている)ことを記載する。

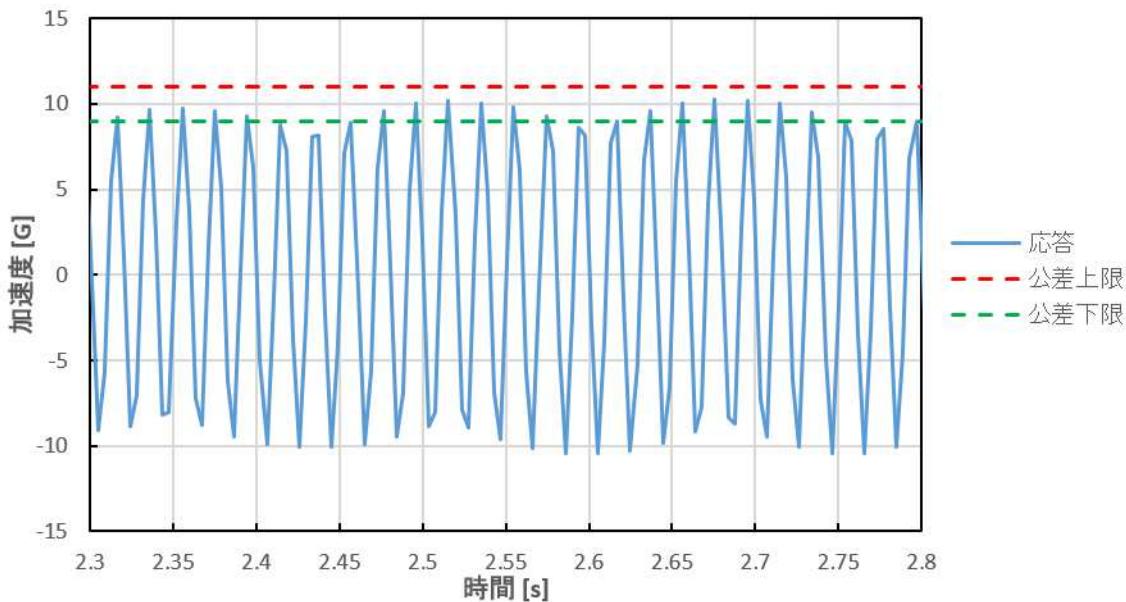


図 4.15: FM 試験におけるサインバースト試験結果 [?]

4.3.3 各試験の概要

(1) EM 振動試験

2017年12月25-27日に福井県工業技術センターにて実施。EMにおける振動耐性を確認した。EM振動試験の目的は次の3点である。(ただし3点目は主要な目的ではない)

1. 打ち上げ環境よりも厳しい振動条件 (QT レベル) に耐えうることの確認
2. FM 振動試験で AT レベルを負荷したときのデータと比較するためのデータを取得
3. FM 振動試験の練習 (起こりうるヒューマンエラーを把握し未然に防ぐ)

各試験は AT レベルと QT レベルで実施し、ランダム振動試験については上記に加えて 1/2AT レベルも実施した。

QT レベルの試験を行うのは目的1のためであり、逆に QT レベルのみが EM 試験の必要条件である。QT レベルは試験条件が厳しいため EM にのみ負荷し、FM には負荷しない。EM 振動試験における AT レベル試験は目的2のためであり、また QT レベルを負荷する前に異常が出ないことを確認する予備試験の役割も担う。つまり、AT で異常が発生した場合、いきなり QT を負荷して異常が発生した場合よりも被害が抑えられる。1/2AT レベル試験は AT レベル試験の予備試験としての役割のみであり、念の為行う試験である。各試験の中で破壊が起こりやすいとされるランダム振動試験のみ 1/2AT レベル試験を行った。

なお、IHI エアロスペース製「CubeSat 振動試験用ケース」(イプシロンロケット CubeSat 放出装置「E-SSOD」を模した振動試験用ケース) は EM 振動試験時には製作中であったた

め、自作（東工大工場にて加工）したものを使用した。EM 振動試験報告書では「E-SSOD 代替治具」と呼称。

(2) FM 振動試験

2019年7月10-12日に宮城県産業技術総合センターにて実施。EMで確認された振動に対する剛性・モード形状とFMモデルが大きく変わらないこと、FMモデルが要求される振動に耐えられることの確認が目的。各試験をATレベルのみで実施した。

(3) FM 再振動試験

2019年9月18-19日に宮城県産業技術総合センターにて実施。FM振動試験後、CIB基板の取り換えを行った関係から安全審査に関するインヒビットの健全性を確かめるための再試験が必要となった。ランダム振動試験(ATレベル)とモーダルサーベイ試験のみ実施。

4.3.4 振動試験実施の流れ

本節では、EM/FM/FM再試験を問わず振動試験における全体の流れ(準備→実施→片付け)について記述する。試験中の細かい確認事項は手順書[?]等を参考にしてほしい。また、試験後に見つかった傷がいつからあるものなのかを明確にするために、試験中は写真をとにかく撮りまくること。

(1) 試験場、宿の手配

(2) 機能試験

試験場に到着後、まずはクリーンブースにて衛星の機能確認を行う。OrigamiSat-1の機能試験では下記のことを確認した。

- 放出検知スイッチが正しく機能しており、放出検知スイッチにより電源が遮断されていること(インヒビット健全性の確認)。
- 各モジュールとOBCの通信の確認

振動試験後にも同様の機能確認が必要である。

(3) 衛星のPODへの挿入

機能確認終了後、衛星をPODへ挿入する。

(4) 加振試験の実施

試験機の機能確認を行ったのち、衛星を POD ごと試験機に固定し、試験を開始する。試験機の機能確認は衛星を POD に挿入する作業中に実施しておくとスムーズに試験が進む。

加振試験中は以下のことを確認する。

- 公差内の加振ができていること
- 加振試験前後で固有振動数・モード形状に変化が見られないこと
- 外部に有意な破損が見られないこと
- チャタリング(放出検知スイッチ誤作動)が起きないこと

(5) 書類作成

振動試験前後で以下の書類を作成する必要がある。

- 計画書：試験実施 2 週間前程度
- 報告書：試験実施 2 週間後程度
- 手順書：計画書と同じくらいの時期

振動試験では、作業は単純だが確認項目が多くまた時間がかかり精神が疲弊しやすい。そのため、手順書（兼チェックリスト）は綿密に作成しヒューマンエラーを未然に防ぐことが重要である。

4.3.5 OrigamiSat-1 の振動試験において発生した不具合及びトラブル

本章では、OrigamiSat-1 の振動試験において発生した不具合及びトラブルとその対処をまとめると、

(1) EM 試験

側面カメラのレンズ：ランダム振動試験中に側面カメラのレンズが外れた。組み立て時にトルク管理をし忘れ、試験前から緩んだ状態だったためであった。レンズを外した状態で直前のモーダルサーベイ試験からやりなおした。

(2) FM 試験

放出検知ピン固着：

FM 試験の後、放出検知ピンが固着しており放出が検知できない状態になっていたことが分かった。その後の放出検知ピン改修の経緯についてはサブシステム開発における構体系の節に詳細をまとめると、

POD の挿入方向を変更：POD 内挿入口付近に一部にレールがない部分があった。OrigamiSat-1 の幕展開部にもレールがない部分があるため、OrigamiSat-1 の 1/3 程度がレールのない部分になってしまうため挿入方向を逆にすることが必要になった。

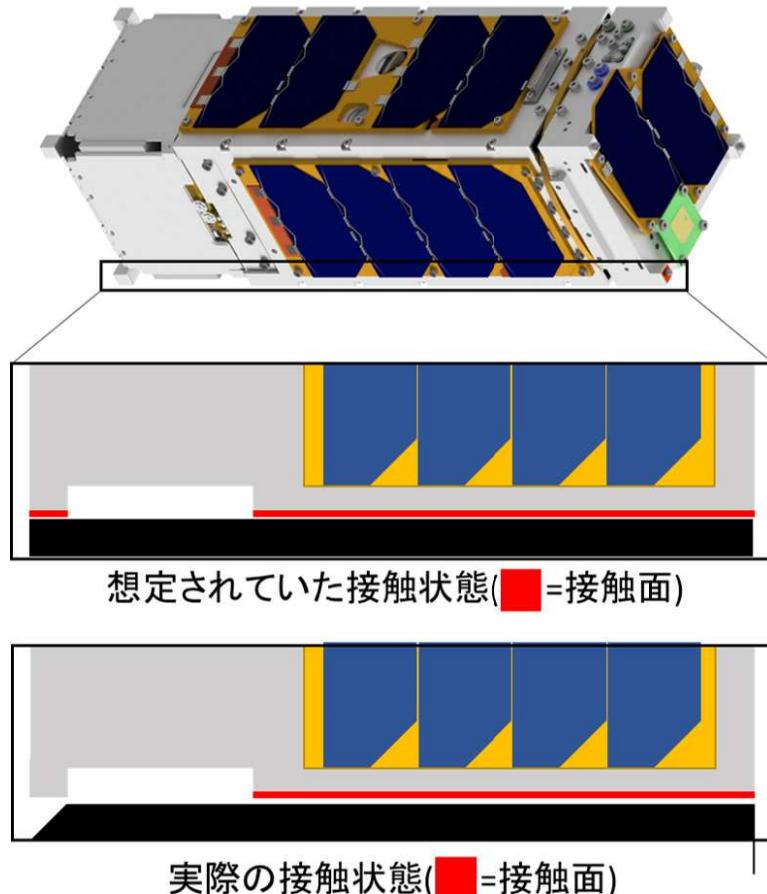


図 4.16: OrigamiSat-1 と POD の接触面

衛星の電源の消し忘れ：1日目作業終了後、衛星の電源を落とさずに帰ったため2日目の衛星の電圧が下がった状態で試験を実施した。バッテリの充放電特性も同時に計測しているため、主にそちらに影響が及んだ。

(3) FM 再試験

チャタリング検知基板に不具合が生じた。現場にいるメンバーでは対応ができず、池谷さんに東京からわざわざ来てもらい対応していただいた。池谷さんありがとうございました。

4.4 衝撃試験（大野）

衝撃試験は、ロケットのフェアリング分離の際に衛星本体に衝撃が加わるために環境試験として行うことを JAXA から決められている。詳細は「衝撃試験ハンドブック」を参照。

試験で求められていることは、

- AT レベル+3dB の衝撃を、「3 軸各方向に 2 回ずつ」加える

ことによってハザード確認項目を満たし、衛星本体が壊れないことである。AT レベルに関する「インターフェイス管理文書」、ハザード確認項目は「ハザードレポート」に記載されている。また、どちらについても「OP-S1-0013 EM 衝撃試験計画書」にまとめてある。なお、本試験は EM についてのみ行う。

4.4.1 使用装置

本試験で使用した装置を図 4.17 に示す。衝撃試験の手法は多数あるが、私たちは熊本大学の波多先生が開発した「簡易式衝撃試験装置」を使用した。この装置は 1 回の打撃子の衝突により、XYZ の全 3 軸同時に衝撃を印加することができる。

詳細は「衝撃応答スペクトルにおける材料特性の影響評価」、第 59 回宇宙科学技術連合講演会講演集、No. P49, 2015. を参照。

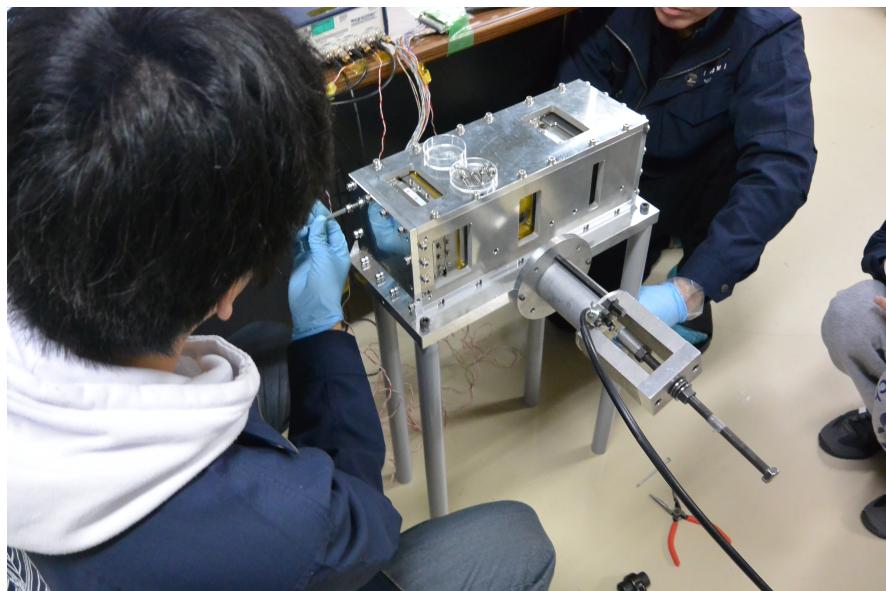


図 4.17: 熊本大の簡易式衝撃試験装置

4.4.2 準備（私がやったこと）

この装置を用いて試験を行うにあたり、私が行ったことは

- 試験計画書の作成
- ベース板の設計・加工
- 試験時の取りまとめ
- 報告書の作成

である。

(1) ベース板の設計・加工

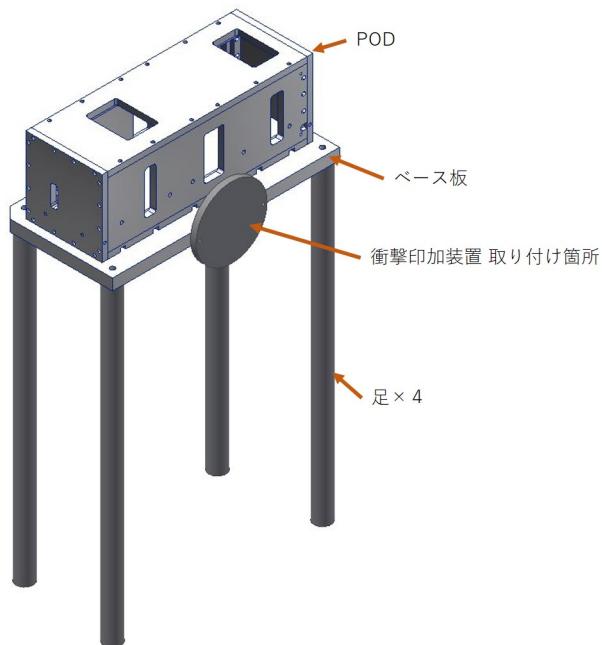


図 4.18: 衝撃試験で使用するベース板

ベース板は、POD と接続される板であり、この板に衝撃印加装置と加速度計を取り付けて試験・測定を行う（図 4.18）。測定物（今回では衛星）によってベース板のサイズ等が変わるために、自作する必要があった。必要な加工項目は

- 板厚 20mm の板を用意する
- 2箇所の C20 の面取り（加速度計取り付け用）
- 足×4, 加速度計×3, 衝撃印加装置, POD をつけるための穴

であった。なお、当初の予定では面取りと POD の取り付け穴のみ加工をこちらで行い、他の加工はやっていただけたことになっていたが、こちらの開発の遅れで波多先生側で時間が取れなくなり、全て加工することになった。

加工自体はそれほど複雑ではなかった。また、構体系でも記載はあると思うが、工場の方が親身に手伝ってくれるので、不安があってもそれほど心配ない。ただし、人が多いときであると工場の方も手が回りきれないこともあるので、注意する必要がある。また、加工は時間がかかるので、図面の作成を丁寧に行う（加工するときに寸法の計算をする必要のないように書く）ことと、前日までに加工順序をまとめておくことをお勧めする。

本加工でのミスは

- 発注時の面取りのし忘れ
- 加速度計のねじ切りのピッチ

である。発注時の面取りは、ミスミであると無料でやってくれるのでやってもらう予定であった。これを忘れたことにより加工工程が増えてしまった。面取りは複雑な作業ではないが、面取りの大きさが大きかったので時間がかかった。加速度計のねじきりのピッチは「細目」で指定されていたが、「並目」で加工してしまった。これにより、面取り部をさらに削る

だけでなく、予備試験の際に気づいたので予備試験をもう1回やることになった。些細なミスで開発の貴重な時間を失うので、当たり前ではあるが、必ずチェックしましょう。

4.4.3 試験

当初の予定では、

1. ベース板の面取り加工を行う
2. ベース板を熊大へ発送、追加工と衝撃印加方法の選定を行ってもらう
3. 東工大にてEM衝撃試験を実施

という流れであったが、開発の遅れと、加工のミスにより、下記行程に変更した。

(1) 予備試験@日大



図 4.19: 衝撃試験@日大

開発の遅れから、熊大での加工・試験をあきらめ、日大で行われる衝撃試験に行き、日大の試験終了後に事前試験をやらせてもらうことになった（図??）。事前試験は池谷、山崎が参加した。前述にあったとおり、加速度センサの取り付けねじのピッチに誤りがあったため、再度実施することとなった。

(2) 予備試験@熊大

日大での予備試験での不具合から、ベース板を追加工し、熊本大にベース板を送り、再度衝撃印加方法の選定を行ってもらった。無事試験ができることになった。

(3) 本試験@東工大

当日はほとんどを波多先生にやっていただいたので、問題は特になかった。

4.4.4 キャリーケースの損傷

衝撃試験装置を東工大まで持ってきていただいたが、装置を入れていたキャリーケースが輸送中に破損してしまった。大きさによって最大重量が会社ごと決まっているので環境試験で荷物をつめる際には気をつけて欲しい。

4.4.5 付録：全体スケジュール

	月	11月	12月				1月		2月	
	週	2	3	4	1	2	3	4	1	2
ベース板の設計について協議		11/13						12/29		
計画書作成			11/16			初版提出 12/11			最終版提出 1/9	
ベース板発注～加工						12/11	12/19			
予備試験@日大							12/20			
追加工							12/26-29			
ベース板 発送							12/31			
予備試験@熊大								1/4		
ベース板 到着									1/9	
本試験@東工大									1/10	
キャリーケース									1/10	2/22

図 4.20: 衝撃試験スケジュール

最後に本試験までのスケジュールを図 4.20 に示す。これは、波多先生とのメールのやり取りから日付をまとめたものである。この日程でマージンはないのでこの日程で行うことはお勧めしない。余裕を持って開発を進めてもらいたい。

4.5 連続動作試験 EMver (?)

4.6 姿勢制御試験（恒光）

4.7 通信系 機能試験（大本）

通信系の機能試験として行ったのは、以下の 4 つがある。それについて記述していく。なお、1, 2, 3 の試験については東京工業大学電気電子系広川研究室の戸村崇助教のご厚意のもと、広川研究室所有の電波暗室をお借りして行った。

- モノポールアンテナのインピーダンスマッチング試験
- モノポールアンテナの放射特性試験
- パッチアンテナの利得・放射特性試験
- 長距離通信模擬試験

4.7.1 通信系設計、機能試験を行うにあたって

私たち機械系の人間が通信系を担当するのには、かなり大きな専門知識の壁がある。恐らく利得とは何か、指向性とは何か、偏波とは何か、反射とは何か、周波数が違うと何が変わるのかなど、全く考えたことも無い状態でプロジェクトの通信系を担当することになるだろう。(私もそうだった) 本衛星の開発では、スケジュールの都合などもあり、アンテナ工学などの分野を体系的に学習する時間が取れず、知識の曖昧な状態で機能試験を行い、ほとんど意味のない試験を行ってしまったこともあった。できるのであれば、簡単な図解の本などでいいからアンテナ工学について体系的な学習を行ってから通信系の開発に臨んでほしい。「アンテナがわかる本(なるほどナットク!)」、後藤尚久著、2005年出版」をとりあえず読むことをお勧めする。東工大図書館で借りられる。

4.7.2 モノポールアンテナ

モノポールアンテナには幅5mm、厚さ0.1mmのリン青銅のものを用いた。長さについては後述するインピーダンスマッチング試験から決定した。リン青銅は錆びる性質があったので、錆びによる性能悪化を防ぐために市販の金メッキキットを用いて金メッキを行った。「マリイ鍍金工業 めっき工房」というものを購入して利用したが、非常に簡単で使いやすかつたのでおすすめ。図4.21にエンジニアリングモデルのモノポールアンテナを示す。



図4.21: モノポールアンテナ(EM)

4.7.3 パッチアンテナ

パッチアンテナは学生で素子設計を行い、基板製作業者に発注して作成した。設計に用いた解析ソフトはANSYSのHFSSという電磁界解析ソフト。専門書などにアンテナ特性の計算ができる式も乗っているが解析ベースで設計しないとまずいいアンテナはできない。計算式から大まかな寸法の決定→解析によって詳細な寸法の決定という流れ。特に円偏波で用いる場合、素子寸法は0.1mmのズレで大きく軸比が変化する。どことは言わないが手加工で円偏波パッチアンテナを作成しているような業者には発注せず、エッティング加工などで製造してくれる業者に発注しよう。パッチアンテナもモノポールアンテナと同様に錆防止のために金メッキを行った。図4.22にエンジニアリングモデルのパッチアンテナを示す。



図 4.22: パッチアンテナ (EM)

4.7.4 モノポールアンテナ インピーダンスマッチング試験

本試験はモノポールアンテナのリターンロスを監視しながらモノポールアンテナの長さを調節することによって、モノポールアンテナの長さを決定するために行った。インピーダンスマッチング試験の意味については適宜書籍やインターネットなどで調べて理解していただきたい。試験手順は以下に示す通り。

1. モノポールアンテナを取り付けた衛星を電波暗室計測治具に固定
電波の放射方向への金属材料などは電波を反射しリターンロスとして計測結果に表れてしまうので、絶縁体を使用する。アクリルプレートや3Dプリンターなどで作成。
2. VNA を校正し、モノポールアンテナに接続
VNA はネットワークアナライザのこと。ネットワークアナライザは計測するたびに校正が必要であり、また非常に高価な機材のため、宇宙研などどこかの機関に借りる必要あり。本衛星の計測では東工大電気電子系広川研究室の設備をお借りした。
3. モノポールアンテナをニッパーなどで短く切断していく、長さ対リターンロスの関係を計測
ここで切断するモノポールアンテナはFMとして用いるものではないので、どんどん短くしていく。モノポールアンテナを短くしていくとリターンロスが最小となる周波数は大きくなっていくはずなので、その関係を得ることが目的。図4.23, 図4.24に本衛星の計測結果を示す。

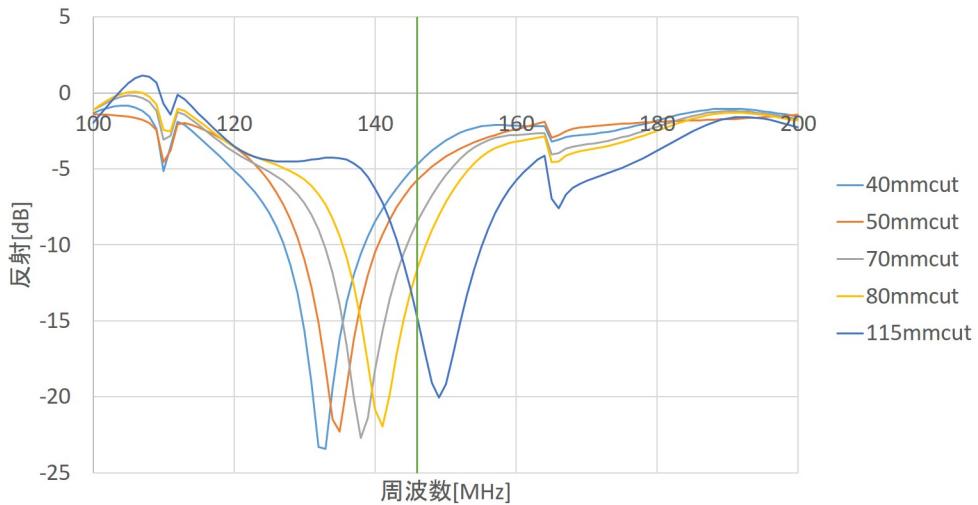


図 4.23: 反射対周波数 (VHF)

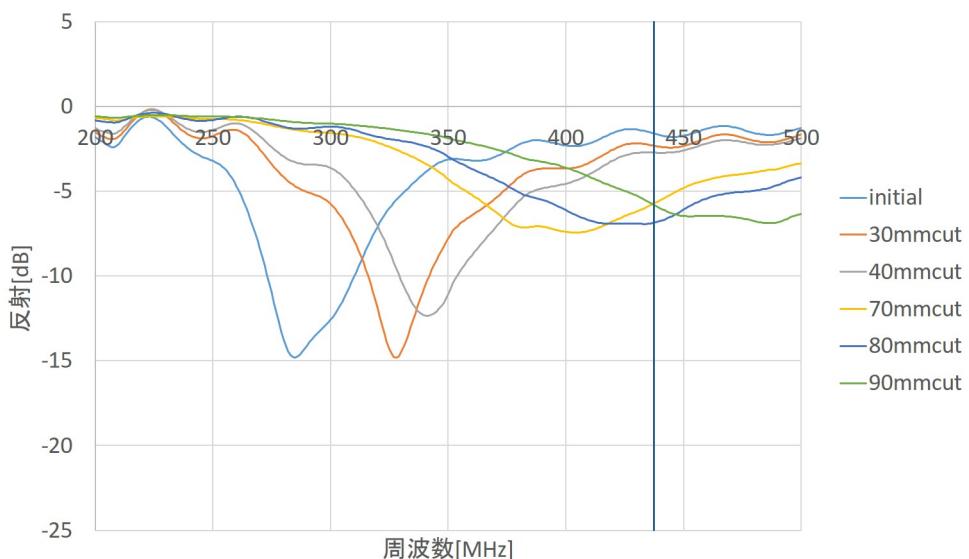


図 4.24: 反射対周波数 (UHF)

4. 線形近似などを用いて、リターンロスが目標周波数で最小となるようなモノポールアンテナの長さを計算

得られたりターンロスが最小となる周波数とモノポールアンテナの長さの関係から適當な近似で目標周波数で最小となるモノポールアンテナの長さを決定する。同じ材料で同じように取り付けられたモノポールアンテナは少なくとも MHz 帯程度の周波数では同じような特性が得られる。図

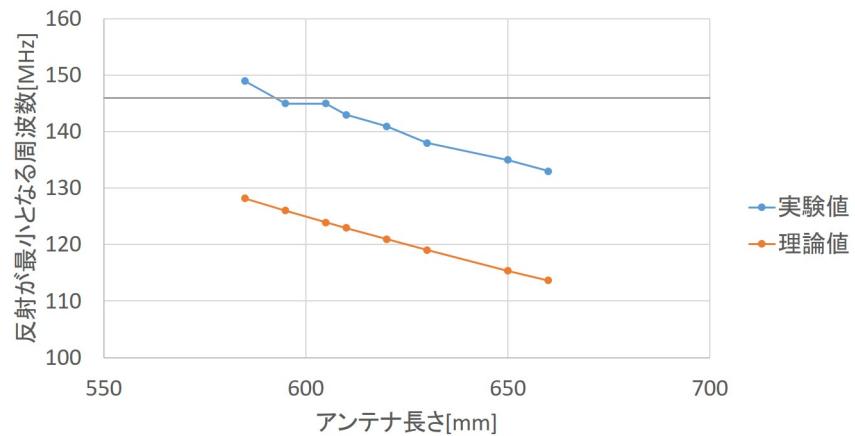


図 4.25: アンテナ長さとリターンロスが最小となる周波数の関係 (VHF)

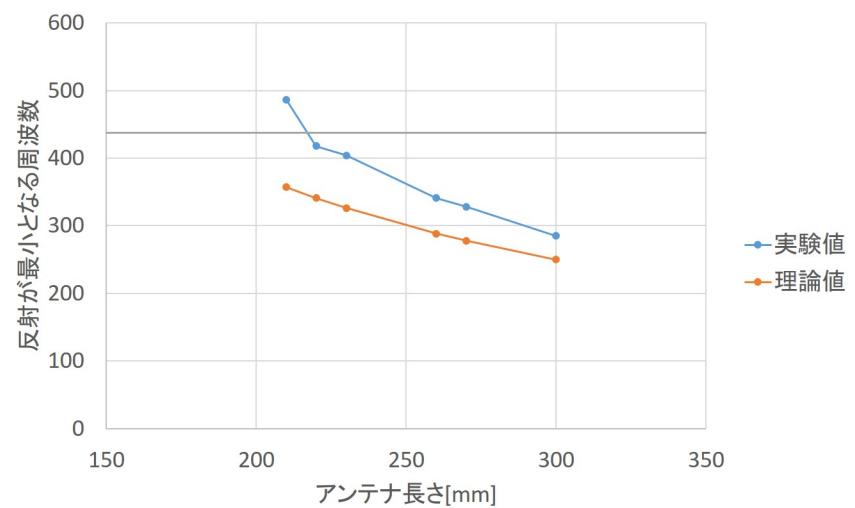


図 4.26: アンテナ長さとリターンロスが最小となる周波数の関係 (UHF)

5. 計算した長さのモノポールアンテナを作成し、再度電波暗室でリターンロスを計測
FMとして用いるアンテナの反射特性を計測。図 4.27-4.28 に計測結果を示す。

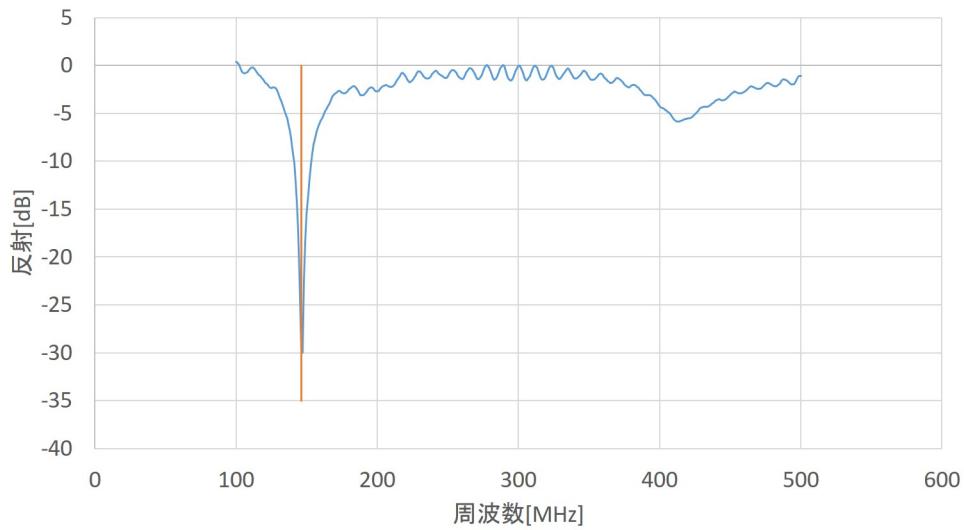


図 4.27: FM モノポールアンテナ反射計測結果 (VHF)

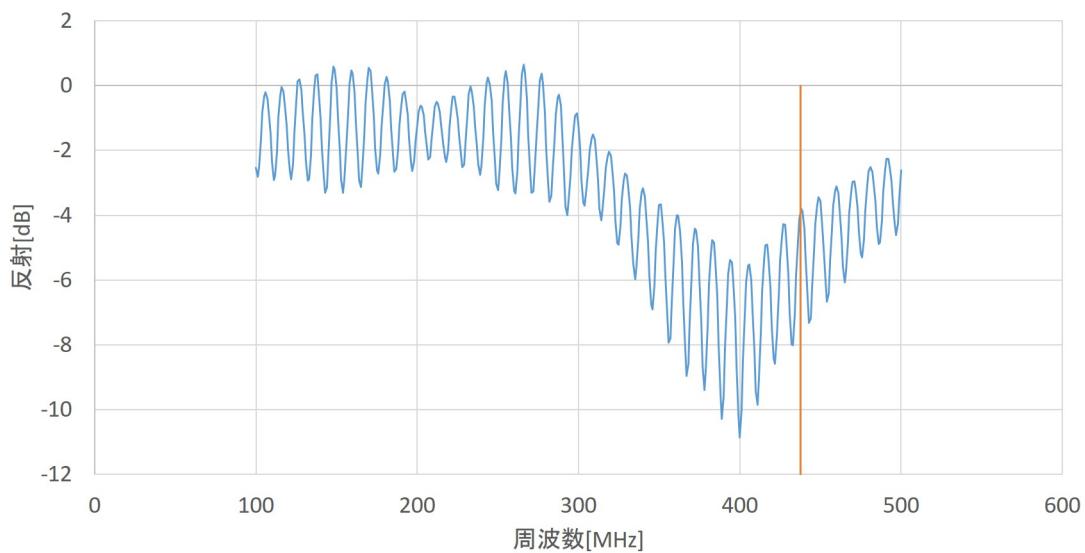


図 4.28: FM モノポールアンテナ反射計測結果 (VHF)

4.7.5 モノポールアンテナ 放射特性試験

本試験ではモノポールアンテナの指向性特性を測定し、健全な指向性を有していることを確認するために行った。計測結果を図 4.29-4.30 に示す。ここでもそもそも水平面、垂直面ともに計測するべきであるが、水平面しか計測していない。このようなことを避けるためにしっかりと勉強しましょう。

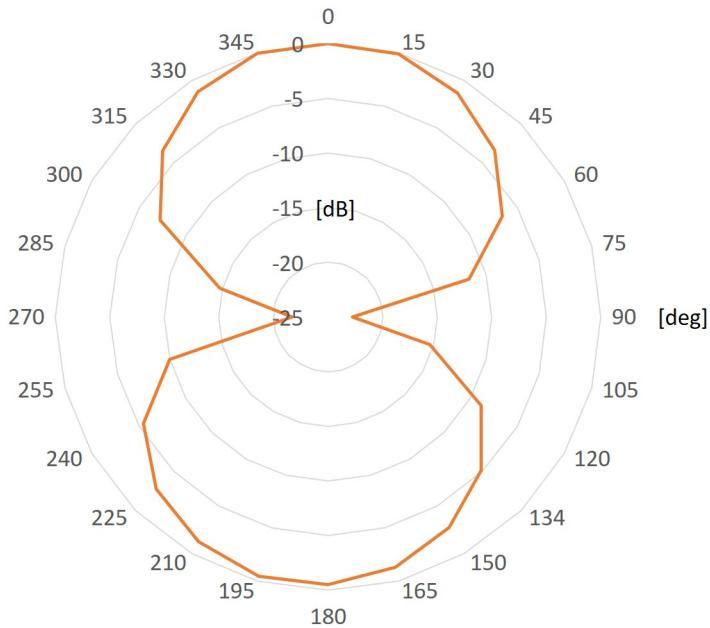


図 4.29: FM モノポールアンテナ H-plane 放射特性 (VHF)

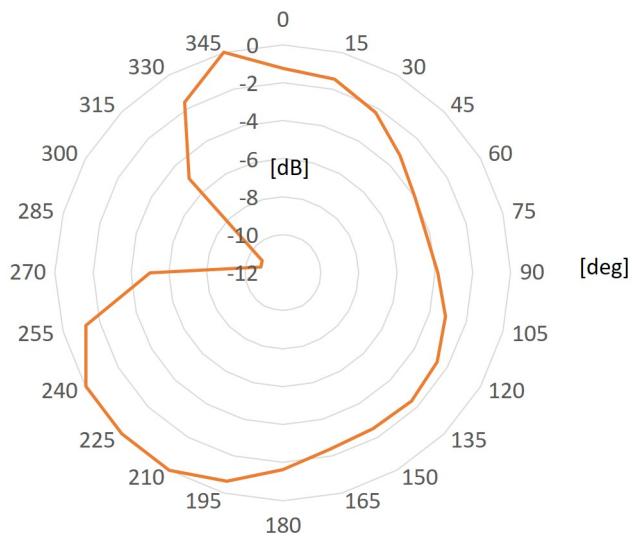


図 4.30: FM モノポールアンテナ H-plane 放射特性 (UHF)

4.7.6 パッチアンテナ 利得・放射特性試験

本試験ではパッチアンテナの利得、軸比、指向性特性を測定し、所望の性能を有していることを確認するために行った。

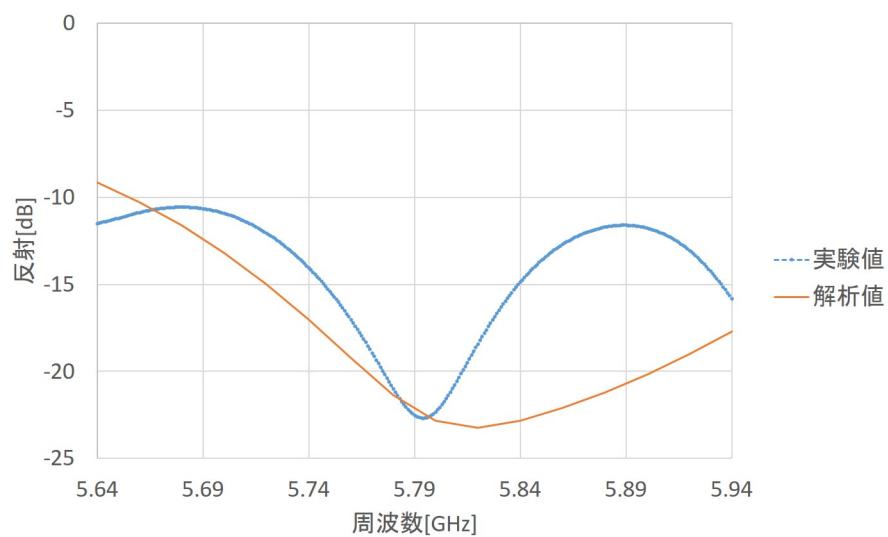


図 4.31: FM パッチアンテナ反射特性

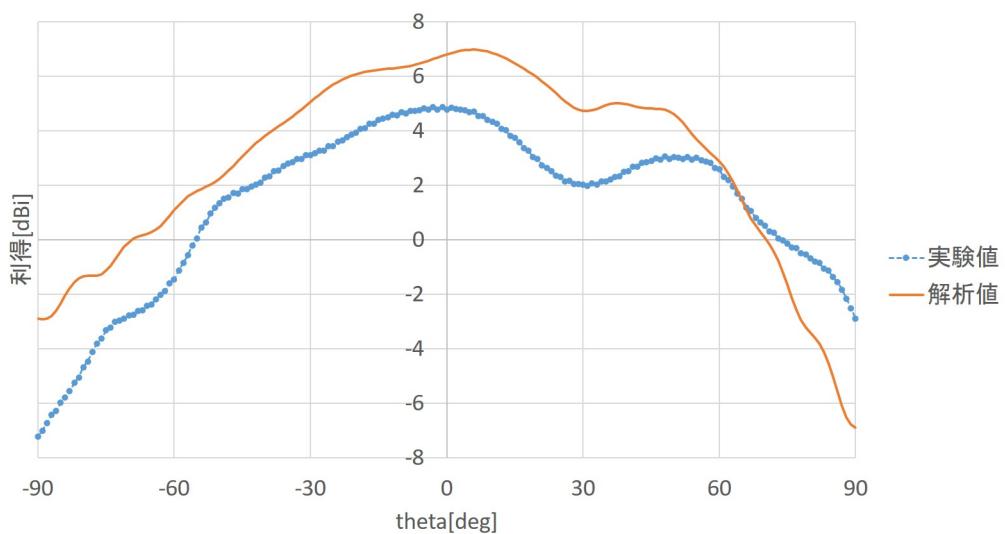


図 4.32: FM パッチアンテナ放射特性

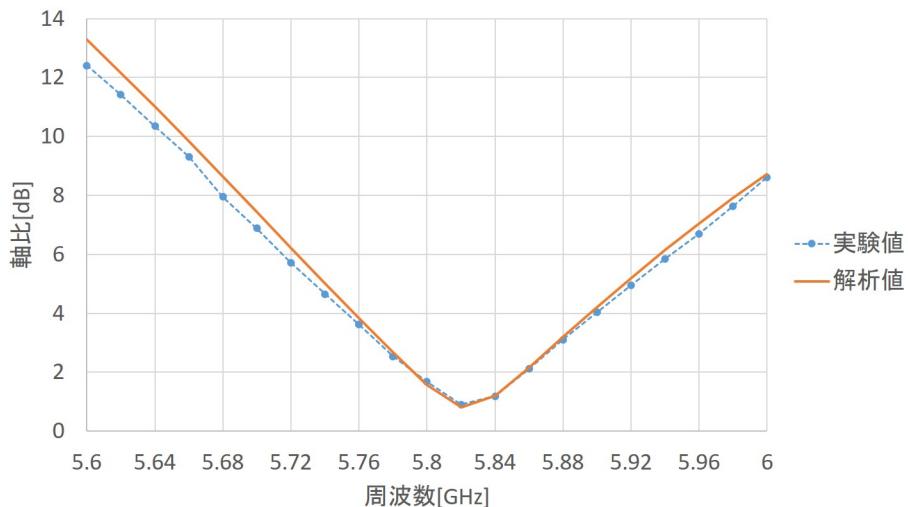


図 4.33: FM パッチアンテナ軸比

4.7.7 長距離通信模擬試験

本試験では、東工大屋上に通信機を設置し、不要電波を漏らさないように適切なアッテネータを取り付けた状態で電波を送信、地上局での受信確認を行うことによって、モノポールアンテナの健全性、東工大地上局設備の健全性を確認することを目的として行った。アンテナの性能は電波暗室試験で計測しており、理屈ではこの試験は必要ないものであるが、気持ちの問題で実施した。

4.7.8 反省点

本衛星の開発でアンテナの特性計測を始めたのは2017年度の12月からであった。衛星の引き渡しは当初2018年度の夏、伸ばしに伸ばして2018年度の11月であったため明らかにアンテナの特性計測を始めるのが遅かった。最初のころは訳も分からず、校正など全くしていないVNAを用いてグラウンドでリターンロスの計測などをしていた。計測に用いる同軸ケーブルも古びたものを用いており、当然ノイズだらけで計測どころではなく、このような試験のために開発メンバーに苦労を掛けてしまったことに申し訳なく感じる。当初市販品を利用する予定であったパッチアンテナについても同じ時期に特性計測を初めて行い、円偏波ではなく直線偏波になっていることが分かった。このため、急遽学生でパッチアンテナの設計を行うことになり通信系は非常にドタバタした開発になってしまった。誰も専門家がないアンテナという分野について、専門家がないという危機感が無さ過ぎたように感じる。後継機の開発などを行う際は設計から開発まで1, ,2人程度通信系に集中する人間を用意するべきだった。

4.8 熱真空試験（中村）：ベーキングについても言及

4.9 表面あらさ計測（大野・奥山）

4.9.1 計測の目的

第4.2章で述べたように、衛星のレールは ICD により表面粗さを $Ra1.6 \mu\text{m}$ 以下とするよう規定されている。しかし、本衛星の側面パネルを発注した際に、誤って図面での表面粗さ指定を $Ra6.3 \mu\text{m}$ としてしまった。そのため、要求を満たしているか確認するために表面粗さ計測試験を行った。

4.9.2 計測機器

表面粗さ計測には以下の図 4.34 のような東工大工場にある表面粗さ計測機を用いた。



図 4.34: 表面粗さ計測機

表面粗さ計測機も第4.2章で述べた三次元測定機と同様に、工場特殊セルフ利用に該当するため、講習を受けたのちに教員の立会いのもと用いることができる。

4.9.3 1回目の計測

図面では誤った表面粗さ指定をしてしまっていたが、実際の数値を確かめるためにレール各部の表面粗さ計測を行った。膜展開部については各面1点ずつ、側面パネルについては各面5点ずつ、底面パネルについては各面2点ずつ行った。その結果、図面での指定を間違えていたものの多くの点で要求を満たしていた。しかし、以下の図 4.35 に示すように膜展開部、側面パネルのレールの一部に傷がついており、傷の部分で要求を満たしていなかった。詳しい試験結果は「表面粗さ測定結果」を参照のこと。

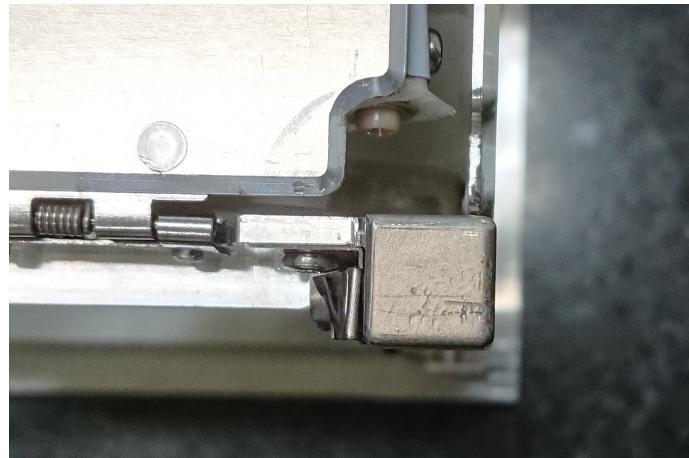


図 4.35: 幕展開部レールの傷



図 4.36: 側面パネルレールの傷

4.9.4 レール傷の処理

レールに傷がつくと表面粗さに影響するため、組み立て時に傷がつくことを防ぐ必要がある。そのため、組み立て時に用いた治具のレール部に精度出しを行う時以外にはカプトンテープを貼って保護する、膜展開部のレールは、精度出し以外の時にカプトンテープを貼つて保護するという対策を行った。側面パネル X-については、表面粗さが規定を超えていた部分を削り表面を滑らかにした。しかし、以下の図 4.37 のようにハードアノダイズド処理された部分まで削ってしまった。そのため、再度ハードアノダイズド処理を行った。

4.9.5 2回目の計測

再ハードアノダイズド処理を施した X-側面パネルレールの表面粗さを計測すると、要求を満たしていた。詳しい試験結果は「表面粗さ測定結果(再ハードアノダイズド処理後)」を参照のこと。



図 4.37: 側面パネルレールのハードアノダイズド処理の欠損

4.10 放出試験（大野・奥山）

4.10.1 計測の目的

第4.2章で述べたように、衛星のレールは $\pm Z$ を除く側面について、E-SSODのガイドレールと少なくとも75%以上接触面を持つことがICDにより定められている。3Uである本衛星の場合は255.4mm以上のレールが必要ということになる。しかし、本衛星のレールには以下の図4.38のような固定用ネジのための座繰りが設けられている。

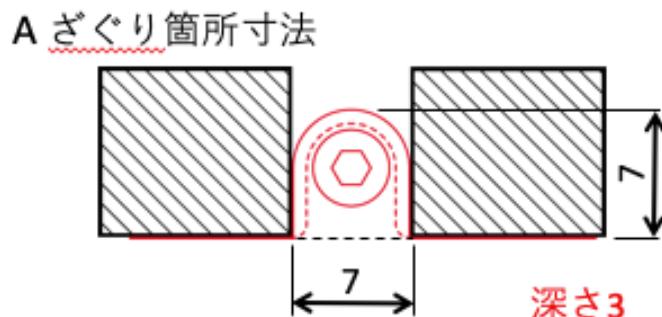


図 4.38: ネジ穴の座繰り

この座繰りがなければレールの長さは256.5mmと要求を満たすが、座繰りによってレール長さは228.5mmとなり要求を満たさない。そのため、E-SSODから引っかかりなく本衛星がすべり出ることを確認するために、放出試験の実施がJAXA, IAより求められた。具体的な試験項目として、以下の2つが要求された。

1. ポッドから衛星を水平に引出し、引出す際の力を測定することで、動摩擦係数を求める
2. ポッドから衛星を垂直に1m/sの速さで引き抜く

水平引き出し試験は定量的に衛星がすべり出ることができるか評価し、垂直引き出し試験では定性的に衛星が引っかかりなくすべり出ることができるかを評価する。各試験の詳細は、放出試験水平引き出し試験報告書、放出試験垂直引き抜き試験報告書(OP-S1-0099)を参照のこと。

4.10.2 水平引き出し試験

(1) 試験機器

引き出し試験は、引出すためのケブラーケーブルを放出検知ピンの穴から通した EM で行った。この EM は重量を FM と揃えるために鉛製の重りを SAP 土台に取り付け調整を行なっている。ポッドは E-SSOD と同じサイズである振動試験用 POD を用いた。ポッドから引き出す先として、厚さ 2mm のテフロンシートを敷いた台を作成した。これは衛星と POD との動摩擦係数を測定するために、引き出した後のレール部分の摩擦を少なくするためである。以上の試験機器による実験系を以下の図 4.39 に示す。

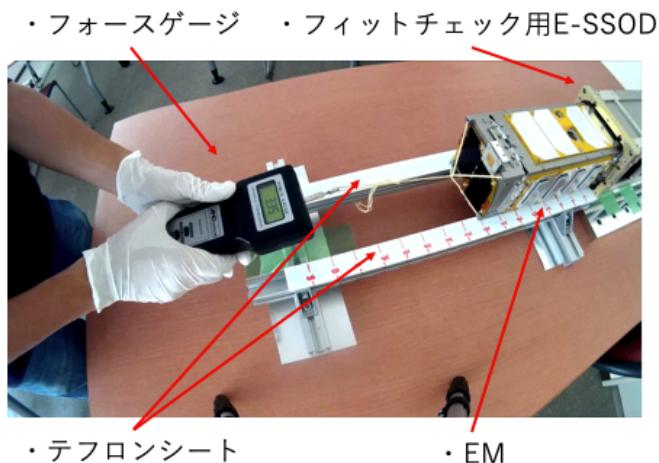


図 4.39: 水平引き出し試験機器

(2) 試験方法

1. ポッドからテフロンシート上に衛星を引き出し、引き出し力をフォースゲージで測定し、動画で撮影する
2. X±, Y± の各面をそれぞれ上面にした 4 通りで測定を行う
3. 試験結果動画から 30mm ごとに引き出し力を記録し、動摩擦力を計算する

(3) 評価方法

IHI から動摩擦係数が 0.1 程度であることが要求されたため、測定値と要求値を比較することで評価する。

(4) 試験結果

まず、1 階の実験室クリーンブース内（温度 23.5°C, 湿度 81%）で行なった。その結果、放出の前半における動摩擦係数が 0.15~0.17、放出後半で 0.12~0.15 程度であった。この結果は、要求値とオーダーがずれておらず問題ないと考え IA に結果を提出したが、動摩擦係

数の値が大きいとの返答であった。また、IA から多湿な環境で実験を行うと動摩擦係数が大きくなるため、低湿度下での実験を求められた。

そこで、5階の実験室（温度 25°C、湿度 65%）で再実験を行なった。その結果、放出の前半における動摩擦係数が 0.10~0.15、放出後半で 0.09~0.13 程度となり、JAXA、IA から承認を得た。

4.10.3 垂直引き出し試験

(1) 試験機器

水平引き出し試験と同様に、引き出し用ケブラー糸を取り付け、鉛重りで重量を調整した EM と振動試験用ポッドを用いて実験を行なった。振動試験用ポッドには誤って衛星が落下した際の衝撃防止としてスタイロフォームを貼り付けた。また、垂直に 1m/s で引き出すために定滑車を用いた。実験系は以下の図のようになつた。

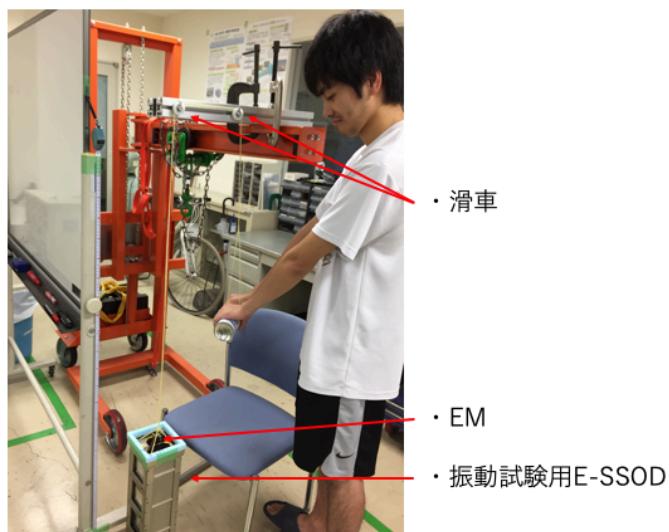


図 4.40: 垂直引き出し試験機器

(2) 試験方法

1. 定滑車を介した紐を引っ張りポッドから衛星を引き抜く様子を動画で撮影する
2. 試験結果動画から引き抜き時に引っかかりがないかを確認する
3. 試験結果動画から引き抜き速さを計算する

(3) 評価方法

衛星が引っかかりなく引き出せているか、引き抜き速さが 1m/s 程度になっているかによって評価する。

(4) 試験結果

衛星は引っかかりなく引き出すことができた。また、衛星長さ 340.5mm の引き出しに 0.3s かかっていたため、引き抜き速さはおよそ 1.1m/s であった。以上の結果から JAXA, IA から承認を得ることができた。

第5章 安全審査（中西・坂本）

5.1 Phase 0/1

5.2 Phase 2

5.3 Phase 3

第6章 引き渡し

6.1 コンプライアンスマトリクス（大野・中西）

6.2 内之浦での引渡し（中西・坂本）

第7章 運用と不具合解析（加藤？）

7.1 運用（坂本・加藤・井手）

7.2 軌道上データ（坂本・井手・岩崎）

7.3 不具合解析（岩崎・大本）

7.3.1 衛星動作モード切替に関する不具合

衛星動作モード切替で saving モードに入る際の動作は RXPIC,TXPIC それぞれ以下である。

RXPIC

EPS の電源を落とす。

TXPIC に西無線のサブ電源を入れるように UART で命令

西無線に初期設定信号を送信

TXPIC

CW 送信の 1 パケットが終了し次第、 RXPIC からの UART 命令を実行

この動作において、 TXPIC に西無線のサブ電源を入れる命令の送信と西無線に初期設定信号を送信の間の delay が適切ではなく、 TXPIC が西無線のサブ電源を入れる前に西無線に初期設定信号を送信してしまう不具合があった。このため、本衛星では動作モードが saving に切り替わると西無線の初期設定が適切に行われず、停波してしまうという不具合が発生した。このミスの原因としては、本衛星に試験用の西無線機が無く、エンジニアリングモデルでのデバッグ作業に西無線が利用できなかったため、モード切替における西無線の初期設定の可否を試験できなかったことにあった。

図挿入あとで

7.3.2 I2C 信号衝突による不具合

本衛星は RXPIC,TXPIC, OBC(nanomind) が同一の I2C ラインを用いて I2C 通信を行う。I2C の衝突対策は行ったつもりであったが、いい感じに I2C が衝突すると（現在調査中）RXPIC,TXPIC,OBC のすべてがリセットを繰り返す状態になってしまうことが分かった。本衛星が軌道上で通信が取れなくなったのはこれが原因だと考えられる。衛星の引渡しまでにこの不具合に気づけなかった原因として、長時間動作試験を行わなかつたことが挙げられる。打ち上げ後の地上試験では 4 日間エンジニアリングモデルを動作させた際にこの現象が確認されたが、衛星引渡しまでの試験では最長でも 6 時間程度の動作試験しか行わなかつた。後継機の開発を行う際は 2 週間程度の長時間動作試験は行った方がいいらしい。

第8章 革新的衛星技術実証プログラムへの参 加（坂本）

本文

第9章 国際周波数調整（中西）

本文

第10章 内閣府宇宙活動法（坂本）

本文

第11章 物体登録（中西）

本文

第12章 プロジェクトマネジメント（池谷・岩崎・大野）

12.1 開発日程

本章では本衛星の開発日程について述べる。

12.1.1 BBM 開発

2015.1-2018.8

本衛星はバス部 BBM 開発に非常に多くの時間が費やされた。衛星を作ること、特にバス部のノウハウが失われた状態で作ることの困難さに対して開発初期は誰もが楽観視していたため

MDR 2016.3

SDR 2016.8

当初 SDR を行うことは想定されておらず同時期に PDR を行う予定であった。しかし開発の遅れから

2016 年秋冬以降統合試験が開始されたが開始されはじめ FM 通信がコンポーネント開発レベルから抜けていないことが明らかになった

安全審査 Phase 0/I

PDR 2017.8 FM 信号送受信を含む基本的なすべての機能確認が行われ、PDR 開催に至った

12.1.2 EM 開発

PDR 後の統合試験

2018 年 9 月から新たに学生プロジェクトマネージャーという立場が設けられた。これは先生の要求にただ答えるという開発体制では学生のモチベーションが上がらず、開発が完了しないことが明らかであったためである。

その後環境試験等のマイルストーンの可視化が行われ

Google Drive に皆がすぐアクセスできるスケジュール表が作られ、毎週のミーティングでスケジュール確認から行うようになった

CDR CDR の日程が後ろ倒しになり続けていたため EM 開発未完了のまま

当時残っていた問題は

安全審査 Phase II

12.1.3 FM 開発

FM 振動試験
FM 再振動試験
FM 热真空試験
安全審査 Phase III
衛星引き渡し

12.2 人員配置・引継ぎ

人員配置について
全ての開発者がある系、あるいは環境試験の責任者とすること
また

第13章 付録

13.1 システム設計

13.2 5.8

13.3 構体系

13.4 VHF/UHF 展開アンテナ

13.5 通信系

13.6 C&DH 系

13.7 電源系

13.7.1 バッテリ充放電特性計測

13.8 振動試験

13.9 熱真空試験

13.10 連続動作試験

13.11 引渡し

13.12 プロジェクトマネジメント

13.13 展開膜

13.14 MDC

13.15 伸展力メラ部

13.16 運用

参考文献

謝辞

謝辞 本文

2019年5月
名前